香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

广合科技

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

廣州廣合科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1989)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列廣州廣合科技股份有限公司(「**本公司**」)在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登了以下公告。茲載列如下，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
廣州廣合科技股份有限公司
董事長
肖紅星

香港，2026年11月20日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事肖紅星先生、曾紅女士及彭鏡輝先生，非執行董事劉錦嬋女士及獨立非執行董事陳麗梅女士、施凌博士及張瑾女士。

证券简称：广合科技　　股票代码：001389

广州广合科技股份有限公司

Delton Technology (Guangzhou) Inc.

（广州保税区保盈南路 22 号）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

（修订稿）

保荐人（主承销商）

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二零二六年十一月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法规规定，公司对申请向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合关于向不特定对象发行可转换公司债券的各项资格和条件。

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保

公司本次发行的可转债未提供担保措施。如果本次可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而存在兑付风险。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2026】第 Z【1418】号 01），公司主体信用等级为“AA+sti”，本次可转债信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，评级机构将对公司主体和本次可转债进行跟踪评级。如果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素导致公司或本次可转债的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生一定影响。

四、特别风险提示

公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）经营业绩和毛利率波动风险

2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 267,827.03 万元、373,428.46 万元、548,537.14 万元和 438,826.02 万元，主营业务毛利率分别为 30.10%、28.92%、29.88%和 35.36%。随着公司业务规模快速扩大，公司在研发、采购、生产、销售等方面的管理复杂程度相应提高，对公司的经营管理能力提出了更高要求。

在前期业绩高增长形成较高基数的情况下，若未来市场竞争加剧、AI 算力基础设施投资及相关市场需求增速放缓或出现波动、下游客户需求、**产品销售价格、主要原材料价格**等因素发生重大变化、公司产能消化不及预期，且公司未能采取措施有效应对，公司可能面临收入及业绩增速放缓甚至下滑、**毛利率下降**、经营效率下降等风险，进而对公司的经营业绩、**本次募投项目的效益实现**产生不利影响。

（二）原材料价格波动及供应稳定风险

公司原材料占主营业务成本的比例较高。公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。未来若主要原材料价格大幅上涨，或出现供应短缺、交付延迟、质量不稳定等情形，而公司未能及时采取价格传导、增加备货、拓展采购渠道或开发替代材料等应对措施，可能对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

（三）市场竞争加剧的风险

PCB 行业的下游应用场景广泛，市场格局相对分散，竞争态势一直较为激烈。自 2025 年以来，业内企业普遍加大了对算力基础设施领域的资本投入，随着后续新增产能陆续释放，行业竞争压力预计将进一步上升。**若公司**无法有效应对日趋白热化的市场角逐，可能对公司经营业绩造成负面影响。

（四）汇率风险

报告期内各期，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 81.18%、77.10%、71.65%和 77.58%，公司外销产品主要以美元等货币计价。报告期内，公司汇兑损益分别为-893.60 万元、-4,861.23 万元、3,029.86 万元和 11,928.44 万元。

若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

（五）募投项目效益不达预期的风险

本次募投项目中，云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目进行了效益测算。本次募投项目效益测算**考虑了产品销售价格变化、涉及境外销售相关国际形势及贸易政策、原材料价格波动、汇率波动等影响，且**基于项目如期建设完毕并按计划投产

后实现销售，因此若项目建设进度不及预期、产品**销售**价格、**原材料价格、汇率水平**出现大幅波动或者未来**国际形势及贸易政策或**行业技术发展趋势出现重大变化，可能对本次募投项目的效益释放带来一定影响，募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险。同时，由于下游客户实际采购需求和本次募投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面临营业收入和利润总额等经营业绩指标下滑，投资回报率降低的风险。

（六）募投项目建设进度不及预期的风险

受市场环境变化等因素影响，公司前次募投项目存在延期的情况。公司本次募集资金投资的建设项目包括云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目，是在公司现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。本次募投实际实施过程中，若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

（七）募投项目新增产能消化及产能过剩风险

本次募投项目达产后，公司将新增年产 11.15 万平方米人工智能高阶 HDI 板和高多层板产能以及年产 12.00 万平方米高多层印制电路板产能，合计新增年产能 23.15 万平方米。公司新增产能的消化受到下游市场需求、行业竞争格局、客户开发及认证进度、订单获取、产品价格以及项目投产和产能爬坡进度等因素的影响。若未来下游市场需求增长不及预期、客户开发及订单导入进度放缓，或同行业企业新增产能集中释放导致市场竞争加剧，公司可能面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降或产能过剩的风险，进而对本次募投项目的预期效益及公司经营业绩产生不利影响。

（八）募集资金购置长期资产导致公司折旧摊销费用增加的风险

本次募投项目云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目为建设项目，涉及规模较大的资本性支出，上述两个项目的实施将新增相应的长期资产，折旧摊销金额相应增加，达产年折旧摊销合计约 2.74 亿元，占公司当年营业收入[1]的比例为 2.88%。如果未来行业政策或市场环境发生重大变化，导致募集资金投资项目不能实现预期收益，则新增折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

[1] 假设营业收入为本次募投项目达产年新增营业收入与公司 2025 年营业收入的合计；上述假设仅用于测算本次募投项目新增折旧摊销对未来业绩的影响，不构成任何盈利预测，投资者不应据此进行决策。

五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况

（一）公司利润分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定，为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。本公司现行利润分配政策如下：

“第一百六十二条 公司实施积极的利润分配政策，具体如下：

（一）利润的分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配方式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

（三）利润分配间隔

原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

（四）利润分配条件

1、现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司预计未来 12 个月内不存在重大资本性支出项目（募集资金投资项目除外）累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30%情形的；

（4）进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。

2、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

（五）现金分红比例

在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）利润分配的执行

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。若因应法律法规和公司股票上市地证券监管规则的规定无法在 2 个月内实施具体方案的，则具体方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。

第一百六十三条 利润分配的决策程序和机制

（一）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事、中小股东及审计委员会的意见。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前应该通过电话、互联网等方式主动与股东特别是机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东提出的相关问题。

（二）决策程序

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）利润分配的监督

审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第一百六十四条 利润分配政策的调整机制

（一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的有关规定。

（二）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经审计委员会和 1/2 以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

（三）调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东会审议，在董事会审议通过后提交股东会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。”

（二）公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、最近三年现金分红情况

最近三年，公司利润分配情况如下：

单位：万元

分红所属年度	分红类型	分红实施年度	利润分配方案/现金回购情况	分红金额（含税）
2023	年度利润分配	2024	每 10 股派现金人民币 2.50 元（含税），以方案实施前的公司总股本的 422,300,000 股为基数，合计派发现金红利人民币 10,557.50 万元	10,557.50
2024	年度利润分配	2025	每 10 股派现金人民币 4.80 元（含税），以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，合计派发现金红利人民币 20,411.28 万元	20,411.28
2025	年度利润分配	2026	每 10 股派现金人民币 6.46 元（含税），以公司 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本总数为基数，公司 2025 年度实际现金分红总额为人民币 30,520.05 万元。其中，A 股总股本 426,709,164 股，实际每 10 股派发人民币 6.456411 元（含税），实际现金分红金额为人民币 27,550.10 万元；H 股总股本 46,000,000 股，H 股股息以港币支付，实际每 10 股派发港币 7.4266804 元（含税），折合人民币约 2,969.95 万元。	30,520.05

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 61,488.83 万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 70,219.17 万元的比例为 87.57%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红金额（含税）	30,520.05	20,411.28	10,557.50
归属母公司所有者的净利润	101,578.90	67,610.04	41,468.57

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
累计未分配利润（母公司）	202,578.34	136,676.47	83,951.99
现金分红/归属母公司所有者的净利润	30.05%	30.19%	25.46%
现金分红/累计未分配利润	15.07%	14.93%	12.58%
最近三年累计现金分红金额			61,488.83
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			70,219.17
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			87.57%

公司最近三年每年以现金方式分配的利润占最近三年累计未分配利润的 12.58%、14.93%及 15.07%；最近三年以现金方式累计分配的利润共计 61,488.83 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 70,219.17 万元的 87.57%，公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

2、最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，作为公司业务发展资金的一部分，主要用于日常经营、对外投资、项目开拓等方面，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

目 录

声 明 1

重大事项提示 2

一、关于本次可转债发行符合发行条件的说明 2

二、公司本次发行的可转换公司债券未提供担保 2

三、关于公司本次发行可转换公司债券的信用评级 2

四、特别风险提示 2

五、公司的利润分配政策及最近三年现金分红情况 5

目 录 10

第一节 释义 13

一、一般术语 13

二、专业术语 14

第二节 本次发行概况 16

一、发行人基本情况 16

二、本次发行的背景和目的 16

三、本次发行基本情况 20

四、本次发行的有关机构 32

五、发行人与本次发行有关人员之间的关系 34

第三节 风险因素 36

一、与发行人相关的风险 36

二、行业相关风险 40

三、其他风险 41

第四节 发行人基本情况 45

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 45

二、公司组织结构及对外投资情况 46

三、控股股东和实际控制人的基本情况 50

四、发行人最近三年控股股东和实际控制人变动情况 51

五、承诺事项履行情况 51

六、公司董事、高级管理人员 52

七、发行人特别表决权股份或类似安排 58

八、公司所处行业的基本情况.....59
九、公司主营业务具体情况.....77
十、公司的核心技术及研发情况.....91
十一、公司的主要固定资产及无形资产.....94
十二、业务经营许可情况.....100
十三、安全生产和环境保护.....102
十四、公司上市以来重大资产重组情况.....102
十五、公司境外经营情况.....103
十六、报告期内的分红情况.....103
十七、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况.....110
第五节 财务会计信息与管理层分析.....112
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....112
二、最近三年及一期财务报表.....112
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况.....117
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....118
五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正.....119
六、财务状况分析.....121
七、经营成果分析.....143
八、现金流量分析.....153
九、资本性支出分析.....156
十、技术创新分析.....156
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项.....157
十二、本次发行的影响.....158
第六节 合规经营与独立性.....160
一、公司报告期内受到的行政处罚.....160
二、公司及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况.....160
三、关联方资金占用情况.....160
四、同业竞争情况.....160
五、关联方和关联交易情况.....162
第七节 本次募集资金运用.....172

一、本次募集资金使用计划.....172
二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系.....172
三、本次募集资金投资项目的具体情况.....173
四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式.....184
五、本次募集资金用于扩大既有业务的相关说明.....184
六、本次发行对公司的影响分析.....185
第八节 历次募集资金运用 187
一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况.....187
二、前次募集资金实际使用情况说明.....187
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明.....190
四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况.....191
五、会计师对于前次募集资金运用所出具的报告结论.....191
第九节 声明 192
一、发行人及全体董事、高级管理人员声明.....192
一、发行人及全体董事会审计委员会成员声明.....196
二、实际控制人声明.....198
二、控股股东声明.....199
三、保荐机构（主承销商）声明.....200
四、律师事务所声明.....203
五、会计师事务所声明.....204
六、资信评级机构声明.....205
七、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺.....206
第十节 备查文件 209
一、备查文件内容.....209
二、备查文件查询时间及地点.....209
附件一：广合科技及其控股子公司持有的主要注册商标 210
附件二：广合科技及其控股子公司持有的主要注册专利 213
附件三：广合科技及其控股子公司持有的主要软件著作权 233

第一节 释义

本募集说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：

一、一般术语

广合科技、公司、上市公司、发行人	指	广州广合科技股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行、本次发行的可转换公司债券、本次可转债、本次发行的可转债、本期可转债	指	广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
保荐机构、保荐人、中信证券、主承销商、受托管理人	指	中信证券股份有限公司
发行人律师	指	上海市锦天城律师事务所
容诚会计师	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评级公司	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
《受托管理协议》	指	《广州广合科技股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《广州广合科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》
《公司章程》	指	《广州广合科技股份有限公司章程》及其修正案
股东会	指	广州广合科技股份有限公司股东会
董事会	指	广州广合科技股份有限公司董事会
审计委员会	指	广州广合科技股份有限公司董事会审计委员会
监事会	指	广州广合科技股份有限公司监事会
公司章程	指	广州广合科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》
《管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法（2025修正）》
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

报告期、报告期各期、最近三年及一期	指	2023年、2024年、2025年及2026年1-6月
报告期各期末	指	2023年末、2024年末、2025年末、2026年6月30日
报告期末	指	2026年6月30日

注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人亦未为此支付费用或提供帮助。

二、专业术语

印制电路板/PCB	指	英文全称 Printed Circuit Board（或 Printed Wire Board，PWB），是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用，又称为“印刷线路板”“印制线路板”
单面板	指	仅一面有导体图形的印制电路板
双面板	指	两面均有导体图形的印制电路板
多层板	指	指具有更多层导电图形的印制电路板。其生产过程需采用定位技术将印制电路板（层）与绝缘介质交替粘结，并根据设计要求通过适当的导孔互连。
刚性板	指	指由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成的印制电路板，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑，又称“硬板”
挠性板	指	指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板，并具有一定弯曲性的印制电路板，又称“软板”、“柔性板”
刚挠结合板	指	刚性板和挠性板的结合，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求，又称“软硬结合板”
HDI 板	指	HDI 是高密度互连（High Density Interconnector）的缩写，是生产印制电路板的一种类型，使用微盲埋孔技术加工的一种线路分布密度比较高的电路板。HDI 电路板的特点是指微孔孔径在 6mil 以下，采用激光钻孔的加工方法，孔环之环径（Hole Pad）在 0.25mm 或以下的微导孔（Microvia），接点密度在 130 点 / 平方英寸以上，布线密度于 117 英寸 / 平方英寸以上，线宽 / 间距一般设在 3mil/3mil 或以下的印制电路板
高频高速板	指	采用具有低介电常数、低介质损耗等特性的高频、高速材料制造而成的印制电路板，用于处理 1GHz 以上高频信号
覆铜板/基板/基材/CCL	指	Copper Clad Laminate，简称 CCL，为制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基材）和柔性材料两大类
半固化片	指	又称为“PP 片”或“树脂片”，是制作多层板的主要材料，主要由树脂和增强材料组成，增强材料又分为玻纤布、纸基、复合材料等几种类型。制作多层印制板所使用的半固化片大多采用玻纤布做增强材料
电镀	指	一种电离子沉积过程，利用电极通过电流，使金属附着在物体表面上，其目的为改变物体表面的特性或尺寸
EMS 公司	指	电子制造服务商（Electronics Manufacturing Service），为电子产品类客户提供包括产品设计、代工生产等服务的厂商
RoHS	指	Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment，即《关于在电子电器设备中限制使用某些有害物质指令》
CPCA	指	中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association）
Prismark	指	美国 Prismark Partners LLC，是印制电路板及其相关领域知名的市场分析机构，其发布的数据在 PCB 行业有较大影响力

印制电路板/PCB	指	英文全称 Printed Circuit Board（或 Printed Wire Board，PWB），是组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板，主要功能是使各种电子零组件形成预定电路的连接，起中继传输作用，又称为“印刷线路板”“印制线路板”
AOI	指	Automatic Optical Inspection，自动光学检查，主要通过高速精度视觉处理技术，检测 PCB 上各种不同的图形缺陷
BGA	指	Ball Grid Array Package，球栅阵列封装，一种封装方式
ERP	指	Enterprise Resource planning，企业资源管理，是指建立在信息技术基础上整合企业管理理念、业务流程、基础数据、人力物力、计算机硬件和软件于一体的企业资源管理系统
MES	指	Manufacturing Execution System，制造企业生产过程执行管理系统，通过信息传递对从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理
SRM	指	Supplier Relationship Management，即供应商关系管理系统，一种致力于实现与供货商建立和维持长久、紧密伙伴关系的管理思想和软件技术的解决方案
WMS	指	Warehouse Management System，仓库管理系统，系通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，可有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程
AGV	指	Automated Guided Vehicle，自动导引运输车，能够按照规定的导引路径行驶，安全保护性高，可以适应多种不同生产状况

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：广州广合科技股份有限公司

英文名称：Delton Technology (Guangzhou) Inc.

注册地址：广州保税区保盈南路 22 号

股票简称：广合科技

股票代码：001389.SZ、01989.HK

股票上市地：深圳证券交易所、香港联合交易所

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、政策体系持续完善，为高端 PCB 产业发展创造有利条件

PCB 是电子元器件的支撑载体和电气连接部件，其产品性能直接影响电子设备的信号传输、运行稳定性和使用寿命，是电子信息产业的重要基础产品。随着新一代信息技术加快发展，PCB 产业的技术水平和供应能力已成为支撑先进计算、人工智能、通信网络及智能制造等领域发展的重要基础。

近年来，国家围绕新型工业化、数字经济和电子信息制造业高质量发展持续完善政策体系。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》《电子信息制造业数字化转型实施方案》《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》《算力互联互通行动计划》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》等政策文件，从提升电子信息产业基础能力、推进制造业数字化和智能化转型、完善算力基础设施以及强化关键技术供给等方面作出部署，为 PCB 行业向高端化、智能化方向发展提供了良好的政策环境。

在政策引导和产业升级需求的共同作用下，PCB 企业需要持续提升高层数、高密度、高速传输及高可靠性产品的研发和制造能力。公司本次发行募集资金主要用于高端 PCB 产能建设，与国家推动电子信息制造业提质升级、增强先进制造能力的政策方向

相契合。

2、算力基础设施加速建设，高端 PCB 需求进入新一轮扩张期

PCB 广泛应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信和汽车电子等领域。近年来，人工智能模型训练和推理需求快速增长，带动 AI 服务器、高性能计算设备、数据中心交换机及高速网络基础设施持续升级。相关设备需要在有限空间内实现更高算力密度和更大数据传输带宽，对 PCB 的层数、布线密度、信号完整性、散热性能及可靠性提出了更高要求，进而拉动高多层板、高阶 HDI 板等高端产品的需求。

根据 Prismark 2026 年第一季度报告数据，2025 年全球 PCB 产值为 858.36 亿美元，同比增长 16.7%；其中，中国大陆 PCB 产值估计为 496.52 亿美元，同比增长 20.9%。预计到 2030 年，全球 PCB 产值将达到 1,446.10 亿美元，2025 年至 2030 年的年均复合增长率为 11.0%；中国大陆 PCB 产值预计将达到 817.64 亿美元，同期年均复合增长率为 10.5%。从产品结构看，预计 2030 年全球 HDI 板产值将达到 300.10 亿美元，2025 年至 2030 年的年均复合增长率为 13.1%；18 层以上多层板产值将达到 197.59 亿美元，同期年均复合增长率为 30.3%，高端 PCB 产品的增长速度预计高于行业整体水平。

公司主营业务为多高层印制电路板的研发、生产和销售，产品主要定位于中高端应用市场。公司服务器用 PCB 产品收入占比较高，相关产品应用于高性能计算服务器、AI 服务器、存储服务器及数据中心交换机等核心设备。随着全球算力基础设施投资持续增加、服务器平台加快迭代，公司所处的高端算力 PCB 市场具备良好的需求基础。

3、产品迭代持续提速，高端制造与稳定交付能力成为竞争关键

算力设备正朝着更高计算密度、更快互连速率和更低传输损耗方向演进，PCB 产品相应呈现层数增加、线路精细化、互连结构复杂化和材料性能要求提高等趋势。与传统 PCB 产品相比，高多层板和高阶 HDI 板在叠层设计、材料选型、层间对位、精密钻孔、阻抗控制、多次压合及可靠性验证等方面具有更高的工艺要求，对生产设备、过程控制和工程经验提出了更高标准。

与此同时，服务器及数据中心产品更新周期较快，不同客户、不同平台的 PCB 设计方案和工艺参数存在差异。下游客户在选择 PCB 供应商时，不仅关注其技术水平和产品质量，也更加重视供应商的柔性生产、快速响应、批量一致性和持续交付能力。能否将产品开发及工程验证成果及时转化为稳定的规模化产能，已成为高端 PCB 企业承

接订单并深化客户合作的重要竞争因素。

公司经过多年积累，已形成高速、高多层服务器 PCB 的技术和客户基础，并具备高频高速、高密度互连等产品的研发及制造能力。随着下游产品加快升级、客户需求持续增长，公司需要进一步完善高端产能配置，提升复杂产品的制造效率、柔性调配和批量交付能力。本次募投项目将围绕高多层板及高阶 HDI 板配置先进生产、检测及配套设备，有助于公司承接更高技术要求的订单，更好地把握高端算力 PCB 市场的发展机遇。

（二）本次发行的目的

1、落实产业升级导向，提升高端 PCB 规模化制造水平

推动电子信息制造业向高端化、智能化方向发展，是我国建设现代化产业体系和推进新型工业化的重要内容。PCB 作为电子信息产品的基础部件，其技术水平和制造能力直接影响服务器、通信设备等高端电子产品的信号传输、运行稳定性和可靠性。提升高端 PCB 产品的自主研发、工程转化及规模化制造能力，符合电子信息产业升级方向。

高端 PCB 产品在材料应用、叠层设计、精密加工、阻抗控制及可靠性验证等方面具有较高要求，研发成果能否稳定转化为量产能力，取决于生产设备、工艺体系、质量控制和工程管理等方面的综合水平。公司长期深耕多高层印制电路板领域，已围绕高速信号传输、高层数结构和高密度互连等方向形成技术积累，并建立了相应的研发、生产和质量管理体系。2026 年，公司入选广东省先进级智能工厂名单，为进一步提升高端 PCB 规模化、智能化制造水平提供了良好基础。

公司本次募投项目拟引进高端 PCB 生产、检测及配套设备，扩大服务器领域高多层板、高阶 HDI 板等产品的生产能力。通过本次募投项目，公司将进一步提升高端 PCB 产品的生产和检测能力，改善相关产品的加工精度、运行稳定性及综合性能，提升高端 PCB 制造水平。

2、补充高端产能，增强重点客户配套及交付保障能力

人工智能算力需求持续增长，推动服务器平台、数据中心网络和高速互连设备加快升级，高端算力 PCB 的需求规模相应扩大。AI 服务器及高性能计算设备对 PCB 的层数、材料性能、互连密度和可靠性提出了更高要求，高多层板、高阶 HDI 板的市场需求随之增长。下游 AI 服务器、数据中心及高速通信等领域客户业务规模持续扩张、产品持

续迭代，对 PCB 供应商的高端产能配套、稳定供货、品质保障及全周期服务能力提出了更高要求。同时，高端 PCB 客户在供应商筛选过程中，会重点关注企业的高端产线配置、柔性生产能力和高端量产规模。

服务器用 PCB 是公司最主要的下游应用领域。公司已围绕 AI 服务器、通用服务器、高性能计算、存储设备及数据中心交换机等场景形成产品布局，并与全球领先的服务器品牌和 EMS 厂商建立了长期合作关系。随着客户新产品导入及采购需求增长，公司现有高端产能需要进一步扩充和优化，以匹配订单增长和产品升级节奏。

本次募投项目实施后，公司高多层板及高阶 HDI 板的生产供应和柔性调配能力将得到提升，有利于匹配现有核心客户的产品升级和产能扩容需求，增强持续、稳定的高端产品供货能力；同时，公司高端产线配置和量产能力的提升，将为后续开拓高端客户和优化客户结构提供支持。

3、优化产品与产能结构，夯实长期增长基础

PCB 行业正逐步由一般产能规模竞争转向技术、品质、效率和服务能力的综合竞争。随着下游产品向高集成度、高速传输和复杂互连方向发展，技术难度和附加值相对较高的产品在 PCB 产品结构中的重要性持续提升。PCB 企业需要根据市场需求和技术路线变化及时调整产能配置，推动产品结构与生产体系协同升级。

公司坚持以技术创新推动产品升级，近年来持续加强高速、高多层及高密度互连产品的研发和工艺积累。伴随公司订单结构和产品技术要求发生变化，公司需要进一步提高高多层板等高端产品的生产能力，推动现有产能和工艺结构与产品升级方向相匹配。

本次募投项目实施后，公司高多层板等高端产品的生产能力和产品占比将得到提升，产品品质及附加值有望进一步提高，有利于优化产品和产能结构，增强公司在高端 PCB 领域的竞争能力，为主营业务持续发展奠定基础。此外，本次发行拟使用部分募集资金补充流动资金。随着业务规模扩大和产能建设持续推进，公司在原材料采购、研发投入、生产运营及客户服务等方面的营运资金需求相应增加。补充流动资金有助于保障日常经营和业务扩张的资金需求，增强财务弹性，并为募投项目建设、产能爬坡及后续市场开拓提供配套支持，进一步提升公司的持续经营和抗风险能力。

三、本次发行基本情况

（一）本次发行的基本条款

1、发行证券的种类

本次发行证券的品种为向不特定对象发行可转换为公司 A 股股票的可转债。该等可转债及未来转换的 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

2、发行规模

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行 A 股可转债募集资金总额不超过人民币 360,000.00 万元（含本数），具体募集资金数额由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

3、票面金额和发行价格

本次发行的可转债每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。

4、债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起六年。

5、债券利率

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东会授权董事会（或由董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

6、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会或董事会授权人士根据相关法律、法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

4）在本次发行的可转债到期日之后的五个交易日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。

5）本次发行的可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

7、转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

8、转股价格的确定及其调整

（1）初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格由公司股东会授权董事会

（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐人（主承销商）协商确定。

若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（2）转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，若公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0－D

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述情况时，将依次进行转股价格调整，在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作方法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和深圳证券交易所的相关规定来制订。

9、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（2）修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

10、转股股数确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q 指转股数量；V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行的可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本次发行的可转债持有人申请转股后，转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司等机构的有关规定，在可转债持有人转股日后

的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债的票面金额以及该余额对应的当期应计利息（当期应计利息的计算方式参见第 11 条赎回条款的相关内容）。

11、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

1）公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

12、回售条款

（1）有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（2）附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。

13、转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

14、发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

15、向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。

公司现有股东享有优先配售之外的余额和现有股东放弃优先配售部分采用网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

16、债券持有人会议相关事项

（1）债券持有人的权利

1）依照其所持有可转债数额享有约定利息；

2）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

3）根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；

4）根据约定的条件行使回售权；

5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

6）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；

7）按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

1）遵守公司发行 A 股可转债条款的相关规定；

2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4）除法律、行政法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

（3）债券持有人会议的权限范围

1）当公司提出变更本次《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；

2）当公司未能按期支付可转债本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

6）对变更、解聘债券受托管理人或受托管理协议的主要内容作出决议；

7）在法律规定许可的范围内对本次可转债债券持有人会议规则的修改作出决议；

8）法律法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（4）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议

1）公司拟变更《募集说明书》的约定；

2）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

3）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；

4）拟变更或解聘债券受托管理人、拟变更受托管理协议的主要内容或解除受托管理协议；

5）公司发生减资（因公司实施员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东权益而进行股份回购导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

7）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

8）公司提出债务重组方案；

9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动；

10）公司、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人书面提议召开；

11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

12）根据法律法规、规范性文件、中国证监会、深圳证券交易所、《募集说明书》及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

（5）下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

1）公司董事会；

2）债券受托管理人；

3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

4）法律法规、规范性文件、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

（6）投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本次可转债债券持有人会议规则的所有规定并接受其约束。

17、本次募集资金用途

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层印制电路板项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		**429,351.26**	**360,000.00**

在本次发行 A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

18、担保事项

本次发行的可转债不提供担保。

19、评级事项

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2026】第 Z【1418】号 01），公司主体信用等级为“AA+sti”，本次可转债信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。

在本次发行的可转债存续期间，评级机构将根据监管部门规定出具定期跟踪评级。

20、募集资金存管

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行 A 股可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会或董事会授权人士确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

21、本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东会审议通过之日起计算。

（二）债券受托管理相关事项

公司拟聘请中信证券股份有限公司为本次发行可转换公司债券的受托管理人，并就受托管理相关事宜与其签订受托管理协议。

（三）违约责任及争议解决机制

1、以下任一事件均构成公司在受托管理协议和本期可转债项下的违约事件

发行人未能按期支付本次可转债的本金或者利息，以及募集说明书、《债券持有人会议规则》《受托管理协议》或其他适用法律法规规定的其他违约事项。

2、违约责任及其承担方式

发生违约情形时，公司应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金和/或利息。对于逾期未付的利息或本金，公司将根据逾期天数按债券票面利率向债券持有人支付逾期利息。其他违约事项及具体法律救济方式参照《债券持有人会议规则》以及《受托管理协议》相关约定。

3、可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

本次可转债发行和存续期间所产生的争议或纠纷，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，争议各方有权按照《受托管理协议》和《债券持有人会议规则》等约定，向发行人住所地有管辖权人民法院提起诉讼。

（四）发行方式与发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（五）承销方式及承销期

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司以余额包销方式承销。

本次可转换公司债券的承销期为【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。

（六）发行费用

单位：万元

项目	金额
保荐及承销费用	【】
律师费用	【】
审计、资信评级及验资费用	【】
信息披露、路演推介、登记及其他费用	【】
合计	【】

（七）承销期间的停牌、复牌及证券上市的时间安排

1、承销期间的停牌、复牌及与本次发行有关的时间安排

日期	发行安排	停牌安排
T-2 日	1、刊登《募集说明书》及其摘要、《募集说明书提示性公告》《发行公告》《网上路演公告》	正常交易
T-1 日	1、原股东优先配售股权登记日 2、网上路演	正常交易
T 日	1、发行首日 2、刊登《发行提示性公告》 3、原股东优先配售认购日（缴付足额资金） 4、网上申购（无需缴付申购资金） 5、确定网上中签率	正常交易
T+1 日	1、刊登《网上中签率及优先配售结果公告》 2、网上申购摇号抽签	正常交易
T+2 日	1、刊登《网上中签结果公告》 2、网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金）	正常交易
T+3 日	保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额	正常交易
T+4 日	1、刊登《发行结果公告》 2、向发行人划付募集资金	正常交易

上述日期为交易日，如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事

件影响发行，公司将与保荐人（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。

2、本次发行证券上市的时间安排和申请上市证券交易所

本次发行结束后，公司将尽快向深交所申请本次发行的可转换公司债券上市挂牌交易，具体上市时间将另行公告。

（八）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，所有投资者均无持有期限制，公司将尽快申请可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌上市交易，具体上市时间公司将另行公告。

（九）本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

本次募投项目符合行业发展趋势，突出上市公司主营业务未来发展方向。本次募投项目的资金需求，系综合考虑公司经营状况确定的融资规模，具有合理性。

本次发行属于向不特定对象发行可转换公司债券，不适用《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条中关于融资间隔的规定。

四、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称：广州广合科技股份有限公司

法定代表人：肖红星

住所：广州保税区保盈南路 22 号

联系人：董事会秘书 曾杨清

联系电话：020-82211188-2885

传真：020-82210929

（二）保荐人（主承销商）

名称：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

保荐代表人：潘绍明、梁家健

项目协办人：杨颖欣

经办人员：缪政颖、赵锦波、程怡康

联系电话：010-60836030

传真：010-60836030

（三）律师事务所

名称：上海市锦天城律师事务所

负责人：沈国权

住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

经办律师：蒋鹏、杨蓉、祖岳灏

联系电话：021-20511000

（四）会计师事务所

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：刘维

住所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

签字注册会计师：杨敢林、林庆涛

联系电话：010-66001391

传真：010-66001392

（五）申请上市的证券交易所

名称：深圳证券交易所

住所：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号

联系电话：0755-88668888

传真：0755-82083295

（六）收款银行

户名：【】

账号：【】

开户行：【】

（七）资信评级机构

名称：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 1509

经办评级人员：游云星、焦玉如

联系电话：0755-82872897

传真：0755-82872090

（八）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：深圳证券交易所广场 25 楼

联系电话：0755-21899999

传真：0755-21899000

五、发行人与本次发行有关人员之间的关系

经核查，截至 2026 年 6 月 30 日，本保荐人中信证券或其重要关联方持有发行人广合科技 A 股（001389.SZ）及 H 股（01989.HK）股份的情况如下：

1、本保荐人通过自营业务股票账户持有发行人 A 股 190,548 股，通过信用融券专户持有发行人 A 股 26,100 股，通过资产管理业务股票账户持有发行人 A 股 9,700 股，中信证券全资子公司合计持有发行人 A 股 811,216 股，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有发行人 A 股 771,236 股，合计 1,808,800 股。

2、本保荐人通过自营业务股票账户持有发行人 H 股 40,000 股，通过资产管理业务股票账户持有发行人 H 股 52,900 股，中信证券全资子公司合计持有发行人 H 股 89,200

股，中信证券控股子公司华夏基金管理有限公司持有发行人 H 股 450,900 股，合计 633,000 股。

上述本保荐人或其重要关联方合计持有发行人股份 2,441,800 股，占发行人截至 2026 年 6 月 30 日总股本（472,709,164 股）的 0.52%。

中信证券已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响中信证券公正履行保荐及承销责任。

除上述情形外，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在其他直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）募集资金投资项目相关风险

1、募投项目效益不达预期的风险

本次募投项目中，云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目进行了效益测算。本次募投项目效益测算**考虑了产品销售价格变化、涉及境外销售相关国际形势及贸易政策、原材料价格波动、汇率波动等影响，且**基于项目如期建设完毕并按计划投产后实现销售，因此若项目建设进度不及预期、产品**销售**价格、**原材料价格、汇率水平**出现大幅波动或者未来**国际形势及贸易政策或**行业技术发展趋势出现重大变化，可能对本次募投项目的效益释放带来一定影响，募投项目可能面临短期内不能实现预测收入和利润的风险。同时，由于下游客户实际采购需求和本次募投项目的测算可能存在差距，如果本次募投项目的销售进展无法达到预期，可能导致本次募投项目面临营业收入和利润总额等经营业绩指标下滑，投资回报率降低的风险。

2、募集资金购置长期资产导致公司折旧摊销费用增加的风险

本次募投项目云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目为建设项目，涉及规模较大的资本性支出，上述两个项目的实施将新增相应的长期资产，折旧摊销金额相应增加，**达产年折旧摊销合计约 2.74 亿元，占公司当年营业收入[2]的比例为 2.88%**。如果未来行业政策或市场环境发生重大变化，导致募集资金投资项目不能实现预期收益，则新增折旧摊销将对公司未来的盈利情况产生不利影响。

3、募投项目建设进度不及预期的风险

受市场环境变化等因素影响，公司前次募投项目存在延期的情况。公司本次募集资金投资的建设项目包括云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目，是在公司现有业务的基础上依据业务发展规划所制定的。**本次募投实际实施过程中，**若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成

[2] 假设营业收入为本次募投项目达产年新增营业收入与公司 2025 年营业收入的合计；上述假设仅用于测算本次募投项目新增折旧摊销对未来业绩的影响，不构成任何盈利预测，投资者不应据此进行决策。

的风险。

4、募投项目新增产能消化及产能过剩风险

本次募投项目达产后，公司将新增年产 11.15 万平方米人工智能高阶 HDI 板和高多层板产能以及年产 12.00 万平方米高多层印制电路板产能，合计新增年产能 23.15 万平方米。**公司新增产能的消化受到下游市场需求、行业竞争格局、客户开发及认证进度、订单获取、产品价格以及项目投产和产能爬坡进度等因素的影响。**若未来下游市场需求增长不及预期、客户开发及订单导入进度放缓，或同行业企业新增产能集中释放导致市场竞争加剧，公司可能面临新增产能不能及时消化、产能利用率下降或产能过剩的风险，进而对本次募投项目的预期效益及公司经营业绩产生不利影响。

5、募投项目实施风险

本次募投项目云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目为高端 PCB 建设项目，项目的实施不仅需要具备在高阶 HDI 板和高多层板方面拥有丰富生产、经营管理经验及研发技术能力的人才队伍，以及各类知识产权及关键制造工艺的技术储备，还需要良好的市场储备及稳固的客户基础。若项目实施的过程中出现人才大量流失、技术储备不足，或市场储备不充分等情况，将可能导致本次募投项目无法顺利实施，公司还可能面临募投项目实施失败的风险。

（二）公司经营相关风险

1、经营业绩和毛利率波动风险

2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司营业收入分别为 267,827.03 万元、373,428.46 万元、548,537.14 万元和 438,826.02 万元，主营业务毛利率分别为 30.10%、28.92%、29.88%和 35.36%。随着公司业务规模快速扩大，公司在研发、采购、生产、销售等方面的管理复杂程度相应提高，对公司的经营管理能力提出了更高要求。在前期业绩高增长形成较高基数的情况下，若未来市场竞争加剧、AI 算力基础设施投资及相关市场需求增速放缓或出现波动、下游客户需求、**产品销售价格、主要原材料价格**等因素发生重大变化、公司产能消化不及预期，且公司未能采取措施有效应对，公司可能面临收入及业绩增速放缓甚至下滑、**毛利率下降**、经营效率下降等风险，进而对公司的经营业绩、**本次募投项目的效益实现**产生不利影响。

2、下游算力需求波动的风险

公司 PCB 产品需求与 AI 算力产业链景气度关联度较高，而算力需求受云厂商及服务器厂商资本开支节奏、数据中心项目落地进度、算力芯片供给、技术路线迭代以及终端应用商业化进展等多重因素影响，具有一定周期性和波动性。若下游客户因投资回报、预算调整或外部环境变化而推迟采购、减少订单等，可能导致公司相关产品订单需求减少、交付节奏波动、产能利用率下降，进而对经营业绩的稳定性造成不利影响。

3、技术研发及应用风险

随着 PCB 行业竞争逐渐激烈以及行业的发展，技术能力成为企业能否在长期的竞争中取得优势的重要因素。一方面，产品的技术含量是下游客户选择供应商的重要标准；另一方面，产品的技术含量也影响企业自身的盈利能力。若公司不能紧跟 PCB 市场未来发展方向，或存在技术研发失败、技术未能实现产业化的情形，将可能对公司的经营业绩带来不利影响。

4、核心技术人员流失的风险

PCB 行业对生产科技属性要求较高，不仅需要具备对产品结构、制造工艺进行深入研究和创新开发的能力，以帮助客户快速完成新产品开发、抢占市场先机，还需要具备满足客户优化产品的设计布局、提升产品稳定性需求的能力。因此，PCB 企业必须拥有大量的高素质综合型人才。综合型专业人才的培育往往需要经过大量的知识体系训练和长期的行业经验积累，耗时较长。若未来核心技术人员大面积流失，公司生产经营尤其是新产品研发将受到较大的影响。

5、下游应用领域集中风险

目前，公司生产的 PCB 主要应用于服务器、消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，其中服务器领域占比较高。报告期内，公司服务器领域收入占当期主营业务收入比例为 73.24%、77.76%、80.82%和 89.77%。PCB 是服务器的重要原材料之一，若未来下游 AI 算力数据中心行业发生波动，且对 PCB 需求发生不利变化，可能对发行人业务发展产生不利影响。

6、客户集中的风险

公司下游行业企业主要为规模较大的电子产品制造商，包括终端客户及 EMS 公司

（电子制造服务商），如戴尔、鸿海精密、广达电脑、英业达及浪潮集团等。报告期，公司前五大客户销售额占同期营业收入的比例分别为65.59%、61.38%、60.74%和66.35%，客户相对集中。若公司因产品和服务质量不符合主要客户要求导致双方合作关系发生重大不利变化，或主要客户未来因经营状况恶化导致对公司的订单需求大幅下滑，均将可能对公司的经营业绩产生不利影响。

7、产品质量风险

公司产品质量控制涉及环节多，管理难度大。如公司产品质量出现瑕疵，则可能引致产品质量纠纷，将对公司品牌声誉和产品销售造成不利影响，同时可能导致公司潜在的赔偿风险。

（三）公司财务相关风险

1、应收账款风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 83,967.87 万元、116,467.01 万元、193,662.93 万元和 283,372.52 万元，占流动资产的比例分别为 46.58%、40.88%、52.43%和 39.29%。**随着公司生产经营规模的扩大及本次募投项目实施，公司营业收入及应收账款规模将相应增加。若未来下游客户经营状况或资信情况发生重大不利变化，导致应收账款回收周期延长或无法收回，公司坏账准备可能大幅增加，进而对公司经营业绩产生不利影响。**

2、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 45,730.06 万元、53,546.37 万元、84,799.33 万元和 146,657.81 万元。公司已按照会计政策的要求并结合存货的实际状况计提了存货跌价准备。**随着公司生产经营规模的扩大及本次募投项目实施，公司存货规模将随生产经营规模扩大而相应增加，存货跌价准备金额亦将随之增长。若未来市场需求、产品价格或技术路线发生重大不利变化，导致存货出现滞销或价格大幅下跌，公司存货跌价准备可能大幅增加，进而对公司经营业绩产生不利影响。**

3、汇率风险

报告期内各期，公司外销收入占当期主营业务收入的比例分别为 81.18%、77.10%、71.65%和 77.58%，公司外销产品主要以美元等货币计价。报告期内，公司汇兑损益分

别为-893.60 万元、-4,861.23 万元、3,029.86 万元和 11,928.44 万元。

若未来人民币出现大幅升值，一方面会导致公司汇兑损失增加，另一方面相对国外竞争对手的价格优势可能被减弱，假设在外币销售价格不变的情况下，以人民币折算的销售收入减少，可能对公司经营业绩造成不利影响。

二、行业相关风险

（一）宏观经济及下游市场需求波动带来的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件，其发展与下游行业联系密切，与全球宏观经济形势相关性较大。宏观经济的波动对 PCB 下游行业将产生不同程度的影响，进而影响 PCB 行业的市场需求。

（二）市场竞争加剧的风险

PCB 行业的下游应用场景广泛，市场格局相对分散，竞争态势一直较为激烈。自 2025 年以来，业内企业普遍加大了对算力基础设施领域的资本投入，随着后续新增产能陆续释放，行业竞争压力预计将进一步上升。**若公司**无法有效应对日趋白热化的市场角逐，可能对公司经营业绩造成负面影响。

（三）原材料价格波动及供应稳定风险

公司原材料占主营业务成本的比例较高。公司生产经营所使用的主要原材料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等，上述主要原材料价格受国际市场铜、黄金、石油等大宗商品的影响较大。未来若主要原材料价格大幅上涨，或出现供应短缺、交付延迟、质量不稳定等情形，而公司未能及时采取价格传导、增加备货、拓展采购渠道或开发替代材料等应对措施，可能对公司的生产经营及经营业绩造成不利影响。

（四）贸易摩擦风险

当前国际政治经济形势复杂多变，在关税、科技等方面仍存在较大不确定性，全球市场都不可避免地受此系统性风险的影响。2026 年外部环境主要受贸易保护主义加剧、国际地缘政治风险以及全球通胀与关税、货币政策的不确定性等因素影响。

如果因国际贸易摩擦而导致相关国家对我国 PCB 产品采取**贸易**限制政策、**出口管制**、提高关税及采取其他方面的贸易保护主义措施，将会对我国 PCB 行业造成一定冲击，从而可能对公司的业务发展产生不利影响。

三、其他风险

（一）发行注册审批风险

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会和股东会审议通过，尚需深交所审核同意和中国证监会同意履行注册程序，能否取得相关的批准、审核或注册，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

（二）与本次可转债相关的风险

1、本息兑付风险

本次发行可转债的存续期内，公司需按可转债的发行条款就可转债未转股的部分每年偿付利息及到期兑付本金。除此之外，在可转债触发回售条件时，公司还需承兑投资者可能提出的回售要求。受国家政策、法规、行业和市场等多种不可控因素的影响，**以及受到本次发行对公司资产负债结构、流动比率、速动比率等偿债指标和现金流造成的影响**，公司的经营活动如未达到预期的回报，将可能使公司不能从预期的还款来源获得足够的资金，**公司将面临不具备足够的现金流支付债券本息的风险**，进而影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及对投资者回售要求的承兑能力。

2、可转债到期未转股的风险

本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好及其对公司未来股价预期等因素。若本次可转债未能在转股期限内转股，公司则需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司的财务费用和资金压力。

3、可转债二级市场价格波动的风险

可转债作为一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其二级市场价格受市场利率、票面利率、债券剩余期限、转股价格、转股价格向下修正条款、上市公司股票价格走势、赎回条款、回售条款及投资者心理预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。本次发行的可转债在上市交易过程中，市场价格存在波动风险，甚至可能会出现异常波动或与其投资价值背离的现象，从而可能使投资者不能获得预期的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

4、可转债转股后摊薄每股收益和净资产收益率的风险

本次发行的可转债募集资金投资项目将在可转债存续期内逐渐产生收益，可转债进入转股期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄公司的每股收益和净资产收益率，因此公司在转股期内可能面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

5、信用评级变化的风险

中证鹏元资信评估股份有限公司对本次可转债进行了评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广州广合科技股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2026】第 Z【1418】号 01），公司主体信用等级为“AA+sti”，本次可转债信用等级为“AA+”，评级展望为稳定。中证鹏元资信评估股份有限公司将持续关注公司经营环境的变化、经营或财务状况的重大事项等因素，并出具跟踪评级报告。如果由于公司外部经营环境、自身或评级标准等因素变化，导致本次债券的信用评级级别发生变化，将会增大投资者的风险，对投资人的利益产生一定影响。

6、未提供担保的风险

公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

7、不实施向下修正及修正幅度不确定性风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。可转债存续期内，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出了与投资者预期相符的转股价格向下修正方案，但该方案未能通过股东会的批准。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。

此外，公司股价走势取决于宏观经济、股票市场环境和经营业绩等多重因素，在本次可转债触及向下修正条件时，股东会召开日前二十个交易日和前一交易日公司 A 股股票均价存在不确定性，并相应导致转股价格修正幅度的不确定性。

8、利率风险

本次可转债采用固定利率，在债券存续期内，当市场利率上升时，可转债的价值可

能会相应降低，从而使投资者遭受损失。公司提醒投资者充分考虑市场利率波动可能引起的风险，以避免和减少损失。

（三）管理风险

本次可转债发行后，公司资产规模将进一步提高，人员规模也会相应增长，需要在资源整合、市场开拓、产品研发与质量管理、财务管理、内部控制等多方面进行及时有效的调整，对各部门工作的协调性、严密性、连续性也提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，将削弱公司的市场竞争力，存在规模扩张导致的管理风险。

（四）人才风险

PCB 行业具有很强的专业性，知识结构的更新也很迅速，优秀的技术和市场人员是公司的宝贵财富。随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

（五）海外工厂建设运营风险

公司基于业务发展需要和完善海外布局战略，积极推动泰国生产基地建设进展。泰国的法律法规、供应链配套、人力资源、文化特征等与国内存在较大差异，泰国生产基地在建设及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险。

（六）环保风险

印制电路板的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物。公司不能完全排除在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能，若处理不当，可能会对环境造成一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司的声誉及日常经营造成不利影响。此外，环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准提高导致公司环保费用增加的可能。

（七）新增关联交易的风险

报告期内，发行人与关联方存在关联采购，本次募集资金投资项目投向发行人主业，

发行人将延续现有的主要经营模式，项目实施预计会扩大公司的业务规模，因此也可能扩大公司现有的关联交易规模。公司已制定了关联交易决策制度，对关联交易的决策程序、审批权限进行了约定。若未来公司因正常经营需要，与关联方之间发生关联交易，公司将按照相关规定，及时履行相应的决策程序及披露义务，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性。上述新增关联交易预计不会对公司生产经营的独立性造成重大不利影响，但仍提请投资者关注因本次募投项目实施而新增关联交易的风险。

第四节 发行人基本情况

一、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司总股本为 472,568,764 元，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件的股份数量
1	广州臻蕴投资有限公司	境内非国有法人	171,142,853	36.21	171,142,853
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	45,999,499	9.73	-
3	瑞昌广谐创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	43,249,099	9.15	43,249,099
4	深圳广财投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28,832,734	6.10	28,832,734
5	深圳广生投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	28,832,734	6.10	28,832,734
6	香港中央结算有限公司	境外法人	18,229,385	3.86	-
7	长江证券创新投资（湖北）有限公司	境内非国有法人	6,818,868	1.44	-
8	柳嘉鸿	境内自然人	5,467,141	1.16	-
9	国投（广东）创业投资管理有限公司－国投（广东）科技成果转化创业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	5,140,221	1.09	-
10	广东粤科创业投资管理有限公司－广东粤科振粤一号股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	5,100,023	1.08	-
合计			**358,812,557**	**75.91**	**272,057,420**

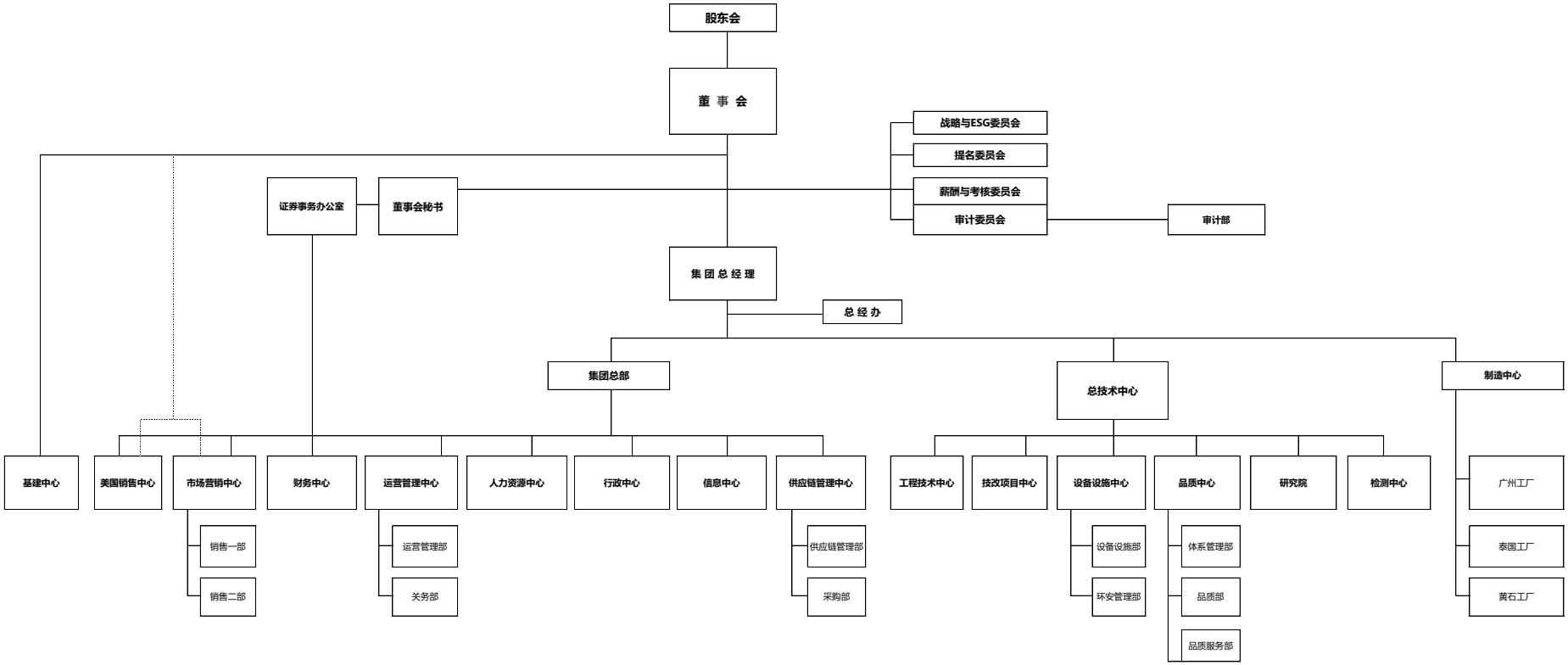
注 1：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

注 2：2026 年 6 月 30 日，公司股本为 472,568,764 元，中国结算深圳分公司登记的股份数 472,709,164，两者差异主要是 6 月底行权的资金次月到账，公司股本确认时点以行权资金到账时间为准。

二、公司组织结构及对外投资情况

（一）公司组织结构图

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人的组织结构图如下：



（二）重要子公司基本情况

截至本募集说明书签署日，公司有 3 家全资一级子公司，3 家全资二级子公司，2 家全资三级子公司，具体情况如下：

1、全资一级子公司基本情况

（1）黄石广合精密电路有限公司

名称	黄石广合精密电路有限公司	
统一社会信用代码	91420200MA49AUDU70	
住所	湖北省黄石市开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号	
法定代表人	肖红星	
注册资本	87,600 万元人民币	
实收资本	87,600 万元人民币	
股东构成	广合科技持股 100%	
成立日期	2019 年 9 月 9 日	
主营业务	电路板研发、生产、销售	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	158,781.24
	净资产	56,992.43
	营业收入	81,975.08
	净利润	9,668.90

注：2025 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（2）东莞广合数控科技有限公司

名称	东莞广合数控科技有限公司	
统一社会信用代码	91441900MA55XA2E5T	
住所	广东省东莞市麻涌镇水乡大道 1 号	
法定代表人	肖红星	
注册资本	10,000 万元人民币	
实收资本	10,000 万元人民币	
股东构成	广合科技持股 100%	
成立日期	2021 年 1 月 28 日	
主营业务	从事钻孔加工业务，为公司提供机加工配套	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	47,365.45

	净资产	10,381.79
	营业收入	26,771.73
	净利润	258.57

注：2025 年度财务数据经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计

（3）DELTON TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED

名称	DELTON TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED	
住所	香港铜锣湾谢斐道 408-412 号华斐商业大厦 1701-1702 室	
法定代表人	肖红星	
注册资本	12,200 万美元	
股东构成	广合科技持股 100%	
成立日期	2019 年 1 月 3 日	
主营业务	电路板销售	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	189,014.82
	净资产	42,338.92
	营业收入	371,205.08
	净利润	6,104.24

注：2025 年度财务数据未经审计

2、全资二级子公司基本情况

（1）Delton Investment Holdings Limited

名称	Delton Investment Holdings Limited	
住所	英国英属维尔京群岛托托拉岛罗德镇梅里迪安广场水边大厦 4 楼	
注册资本	1 万美元	
股东构成	广合国际持股 100%	
成立日期	2023 年 4 月	
主营业务	仅作为股权持有实体，未开展任何业务	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	32,329.93
	净资产	268.11
	营业收入	-
	净利润	653.92

注：2025 年度财务数据未经审计

（2）Delton Technology Inc.

名称	Delton Technology Inc.	
住所	美国加利福尼亚州圣何塞市北第一街 1735 号 307 室	
注册资本	300 万美元	
股东构成	广合国际持股 100%	
成立日期	2025 年 4 月	
主营业务	PCB 研发及分销	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	694.84
	净资产	368.30
	营业收入	-
	净利润	-339.64

注：2025 年度财务数据未经审计

（3）Skytech Union Inc.

名称	Skytech Union Inc.	
住所	OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.	
注册资本	1,500 万美元	
股东构成	广合国际持股 100%	
成立日期	2004 年 8 月	
主营业务	电路板销售	
主要财务数据（万美元）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	2,648.51
	净资产	900.91
	营业收入	1,603.69
	净利润	-183.33

注：2025 年度财务数据未经审计

3、全资三级子公司基本情况

（1）Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd

名称	Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd
住所	Prachinburi 府 Kabinburi 区 BorThong 县金池工业区第 8 组 888 号
注册资本	41.63 亿泰铢
股东构成	广合控股持股 98%，广合国际持股 2%

成立日期	2023 年 5 月 19 日	
主营业务	电子零部件及组件（包括电子印刷电路板）的生产、销售、进出口及研发业务	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	122,271.50
	净资产	26,257.01
	营业收入	16,065.94
	净利润	-5,711.28

注：2025 年度财务数据未经审计

（2）广天科技（广州）有限公司

名称	广天科技（广州）有限公司	
住所	广州保税区保盈南路 1 号	
注册资本	1,500 万美元	
股东构成	Skytech Union Inc.持股 100%	
成立日期	2004 年 10 月	
主营业务	电路板制造	
主要财务数据（万元人民币）	**项目**	**2025 年 12 月 31 日/2025 年度**
	总资产	22,466.09
	净资产	2,374.51
	营业收入	11,703.20
	净利润	-187.57

注：2025 年度财务数据未经审计

三、控股股东和实际控制人的基本情况

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东为广州臻蕴投资有限公司，基本情况如下：

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州臻蕴投资有限公司	肖红星	2016 年 12 月 05 日	91440101MA59GNJD1D	企业自有资金投资；企业信用咨询服务；企业管理咨询服务；企业财务咨询服务；受金融企业委托提供非金融业务服务；企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；公共关系服务；投资咨询服务
控股股东报告期内控股和参股的其	无			

他境内外上市公司的股权情况				
最近一年财务报表主要财务数据（单位：万元）				
2025 年末/2025 年度	资产总额	净资产	营业收入	净利润
	24,893.47	16,290.59	-	8,214.54

注：2025 年度财务数据未经审计

发行人实际控制人为肖红星、刘锦婵夫妇。**截至 2026 年 9 月 30 日**，肖红星、刘锦婵夫妇通过臻蕴投资、广生投资、广财投资间接控制发行人 228,808,321 股股份，占发行人总股本的 48.40%。肖红星与刘锦婵简历参见本募集说明书本节“六、公司董事、高级管理人员”之“（一）董事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。

四、发行人最近三年控股股东和实际控制人变动情况

最近三年，发行人控股股东和实际控制人未发生变更。

五、承诺事项履行情况

（一）报告期内公司及相关人员作出的重要承诺及履行情况

报告期内，公司及相关人员已作出的重要承诺及其履行情况参见公司于 2026 年 3 月 28 日在深圳证券交易所网站（https://www.szse.cn）披露的《广州广合科技股份有限公司 2025 年年度报告》之“第五节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

截至本募集说明书签署日，公司及相关人员不存在未履行向投资者所做出的公开承诺的情形。

（二）本次发行相关的承诺事项

1、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

公司全体董事、高级管理人员就公司本次向不特定对象发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行等相关事项作出以下承诺：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

2、广州臻蕴投资有限公司对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

广州臻蕴投资有限公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券填补即期回报措施能够得到切实履行等相关事项作出如下承诺：

“1、不会越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；

2、自本承诺函出具日至上市公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所等规定时，本单位/本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

3、切实履行上市公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。”

六、公司董事、高级管理人员

（一）董事、高级管理人员基本情况

1、董事

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。现任董事基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期
肖红星	董事长	男	59	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
刘锦婵	董事	女	60	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
曾红	董事、总经理	女	60	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
彭镜辉	职工代表董事	男	40	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
陈丽梅	独立董事	女	58	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
张瑾	独立董事	女	63	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
施凌	独立董事	男	46	2026 年 6 月至 2029 年 6 月

上述各位董事简历如下：

肖红星先生：董事长。1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，化学专业，本科学历。1988 年 7 月至 1992 年 3 月任职东莞生益电子有限公司生产经理；后与妻子刘锦婵自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化学品业务的个体工商户和公司；2010 年 3 月设立湖北优尼科光电技术股份有限公司，从事液晶面板的薄化和抛光等加工服务。2013 年 3 月至今，任公司董事长。

刘锦婵女士：董事。1966 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于惠州教育学院，英文专业，大专学历。1988 年 3 月至 1992 年 12 月任职东莞生益电子有限公司员工，后与丈夫肖红星自主创业，先后设立并经营东莞市道滘广华电子材料经营部、东莞市道滘广华电路板辅助材料厂、东莞市盛华电路板辅助材料有限公司、东莞市广华化工有限公司、东莞秀博电子材料有限公司等从事电子化学品业务的个体工商户和公司。2013 年 3 月至 2019 年 4 月，任公司监事；2019 年 4 月至今任公司董事。

曾红女士：董事、总经理。1966 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历，电子技术高级工程师职称，担任中国电子电路行业协会科学技术委员会主任委员、中国电子学会电子制造与封装技术分会全国印制电路专委会副主任委员、广东省质量技术监督局及广东省信息技术标准化技术委员会委员、中国国家标准化管理委员会全国印制电路标准化技术委员会委员、广东省电路板行业协会及广东省电路板行业协会理事会副会长、中国电子电路行业协会第九届理事会副理事长。1988 年 7 月至 2013 年 2 月，历任东莞生益电子有限公司品质经理、副厂长、副总经理。2013 年 2 月至今，任公司董事、总经理。

彭镜辉先生：职工董事、研究院总监。1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，化学工程与工艺专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司工艺工程师（2009 年 7 月至 2013 年 2 月），广合科技（广州）有限公司工艺工程师、高级工程师、主任工程师（2013 年 3 月至 2015 年 8 月），广州添利电子科技有限公司高级工程师（2015 年 11 月至 2015 年 12 月）。2015 年 12 月加入公司，历任公司职工监事（2020 年 6 月 22 日至 2025 年 5 月 16 日），现任公司职工董事、研究院总监。

陈丽梅女士：独立董事。1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。毕业于华南理工大学，应用化学专业，本科学历。历任广州珠江会计师事务所审计助理（1999 年 10 月至 2000 年 3 月），广州市明通会计师事务所审计员（2000 年 3 月至 2000 年 6 月），广州市知力税务师事务所企业税务审核员（2000 年 6 月至 2000 年 12 月），广东金桥会计师事务所审计部部长（2000 年 12 月至 2005 年 12 月），广州高澜节能技术股份有限公司独立董事（2011 年 5 月至 2017 年 5 月），国义招标股份有限公司独立董事（2014 年 12 月至 2020 年 6 月），广州天赐高新材料股份有限公司独立董事（2020 年 5 月至 2026 年 3 月）。现任广州市新东越会计师事务所有限公司副所长，黄埔文化（广州）发展集团有限公司外部董事，广东保伦电子股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今，任公司独立董事。

张瑾女士：独立董事。1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海工商经济进修学院工商管理专业，大专学历。2003 年 3 月至 2015 年 3 月历任中国印制电路行业协会副秘书长、常务副秘书长；2015 年 3 月至 2017 年 1 月任中国印制电路行业协会常务理事兼秘书长；2017 年 1 月至 2026 年 3 月历任中国电子电路行业协会秘书长、顾问兼科学技术委员会主任；2006 年 3 月至 2026 年 1 月，任上海纯煜信息科技有限公司执行董事；2017 年 8 月至 2023 年 8 月，任深圳市容大感光科技股份有限公司独立董事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任南亚新材料科技股份有限公司独立董事；2018 年 8 月至 2024 年 9 月，任深圳市精诚达电路科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 5 月任广东科翔电子科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至 2025 年 6 月任浙江振有电子股份有限公司独立董事。现任中国电子电路行业协会顾问、中国电子信息行业联合会监事、上海印制电路行业协会顾问、上海广联信息科技有限公司董事、上海颖展商务服务有限公司董事；2025 年 12 月至今，任深圳市强达电路股份有限

公司独立董事。2026 年 6 月至今，任公司独立董事。

施凌先生：独立董事。1980 年 6 月出生，中国香港籍，汉族，博士学历。毕业于加州理工学院，控制与动力系统专业。2002 年获香港科技大学电子与电机工程学士学位（数学辅修）。历任香港科技大学电子及计算机工程系助理教授（2008 年 10 月至 2014 年 6 月）、副教授（2014 年 7 月至 2020 年 6 月）、教授（2020 年 7 月至今），香港科技大学机器人研究所副所长（2017 年 2 月至 2021 年 11 月），香港科技大学太空科学与技术研究院副院长（2024 年 6 月至今），香港科技大学郑家纯机器人研究院院长（2026 年 1 月至今），主要研究方向为信息物理系统、传感器融合与信号处理、强化学习、人工智能及网络化控制系统。2023 年当选 IEEE Fellow，2024 年当选香港青年科学院院士并获陈翰馥奖。现任宏宇创新有限公司董事，知远创新有限公司董事，深圳佑驾创新科技股份有限公司首席科学家，平天创新（池州）科技有限公司执行事务董事。2025 年 5 月至今，任公司独立董事。

2、高级管理人员

公司现任高级管理人员基本情况如下表：

姓名	职务	性别	年龄	任期
曾红	总经理	女	60	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
王峻	副总经理	男	53	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
黎钦源	副总经理	男	53	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
曾杨清	副总经理、董事会秘书	男	49	2026 年 6 月至 2029 年 6 月
贺剑青	财务总监	女	51	2026 年 6 月至 2029 年 6 月

上述各位高级管理人员简历如下：

曾红，请参阅本节“1、董事”。

王峻先生：副总经理。1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京兴华大学，工商管理专业，本科学历。历任东莞生益电子有限公司品质技术员、助理工程师、工程师、总管、经理、品质总监（1992 年 8 月至 2013 年 2 月）。2013 年 2 月加入公司，现任公司副总经理。

黎钦源先生：副总经理、总工程师。1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南理工大学，化学工程专业，本科学历，高级工程师。历任东莞生益电子有限公司制作工艺助理工程师、工程师、主任工程师、经理、高级经理（1996 年 7

月至 2012 年 6 月），广州杰赛科技股份有限公司技术总监（2012 年 6 月至 2012 年 12 月）。2013 年 1 月加入公司，现任公司副总经理、总工程师兼广州工厂总经理。

曾杨清先生：副总经理、董事会秘书。1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国计量大学，自动检测技术及仪器仪表专业，本科学历。历任广东福地科技股份有限公司工程师（2000 年 7 月至 2001 年 9 月），广东博信投资控股股份有限公司总经理秘书、证券事务代表、副总经理兼董事会秘书（2001 年 10 月至 2007 年 6 月），佛山星期六股份有限公司副总经理兼董事会秘书（2007 年 7 月至 2012 年 6 月），梅花伞业股份有限公司投资总监（2012 年 6 月至 2013 年 7 月），南京中锗科技有限责任公司董事、副总经理（2013 年 7 月至 2016 年 1 月），扬州宁达贵金属有限公司董事长（2013 年 7 月至 2016 年 1 月），深圳华皓汇金资产管理有限公司投资总监（2016 年 4 月至 2017 年 3 月）。2017 年 3 月加入公司，现任公司副总经理、董事会秘书。

贺剑青女士：财务总监。1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福建师范大学，财务管理专业，本科学历。历任艾美特电器（深圳）有限公司成本会计（2001 年 5 月至 2004 年 8 月），鸿富锦精密工业（深圳）有限公司经营课长（2004 年 8 月至 2011 年 7 月），深圳市凯中精密技术股份有限公司成本经理（2011 年 7 月至 2017 年 2 月）。2017 年 2 月加入公司，现任公司财务总监。

（二）董事、高级管理人员对外兼职情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司现任董事及高级管理人员在除发行人及其下属子公司以外的公司或单位的主要任职情况如下：

姓名	在公司职务	兼职单位	在兼职单位担任的职务
肖红星	董事长	广州臻蕴投资有限公司	执行董事、总经理
		深圳广生投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		深圳广财投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		广州臻达投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
		湖北优尼科光电技术股份有限公司	董事长
		湖北广华化工有限公司	执行董事
		东莞市优尼特化学有限公司	执行董事
		东莞秀博电子材料有限公司	执行董事兼经理
		易安爱富（武汉）科技有限公司	董事
		东莞市广弘微电子材料有限公司	董事长

姓名	在公司职务	兼职单位	在兼职单位担任的职务
		深圳市智软通科技有限公司	董事
刘锦婵	董事	广州臻蕴投资有限公司	监事
		东莞市广华化工有限公司	执行董事、总经理
		湖北广华化工有限公司	监事
		东莞市优尼特化学有限公司	监事
曾红	董事、总经理	瑞昌广谐创业投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
施凌	独立董事	平天创新（池州）科技有限公司	董事
		深圳佑驾创新科技股份有限公司	首席科学官
张瑾	独立董事	上海广联信息科技有限公司	董事
		上海颖展商务服务有限公司	董事
		深圳市强达电路股份有限公司	独立董事
陈丽梅	独立董事	广州市新东越会计师事务所有限公司	监事
		广东保伦电子股份有限公司	独立董事
		黄埔文化（广州）发展集团有限公司	董事

（三）董事、高级管理人员薪酬情况

公司现任董事及高级管理人员于 2025 年度在公司领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	从公司获得的税前报酬总额	是否在关联单位领取薪酬
肖红星	男	59	董事长	-	是
刘锦婵	女	60	董事	-	是
曾红	女	60	董事 总经理	458.99	否
陈丽梅	女	58	独立董事	10.42	否
张瑾	女	63	独立董事	-	否
施凌	男	46	独立董事	7.14	否
彭镜辉	男	40	职工董事	279.96	否
王峻	男	53	副总经理	222.77	否
黎钦源	男	53	副总经理	401.57	否
曾杨清	男	49	董事会秘书 副总经理	251.80	否
贺剑青	女	51	财务总监	231.71	否
合计				**1,864.36**	-

（四）董事、高级管理人员持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司现任董事、高级管理人员持有公司股份情况如下：

姓名	职务	期末持股数（股）	持股比例
肖红星	董事长	176,738,257	37.39%
刘锦婵	董事	22,386,006	4.74%
曾红	董事、总经理	28,832,444	6.10%
陈丽梅	独立董事	-	-
张瑾	独立董事	-	-
施凌	独立董事	-	-
彭镜辉	职工董事	578,738	0.12%
王峻	副总经理	8,649,820	1.83%
黎钦源	副总经理	5,766,835	1.22%
曾杨清	董事会秘书、副总经理	3,034,035	0.64%
贺剑青	财务总监	810,233	0.17%
合计		**246,796,368**	**52.21%**

（五）报告期内，董事、高级管理人员变动情况

报告期内，发行人的董事成员变动情况如下：

时间	姓名	职务	变动说明
2025 年 05 月 16 日	施凌	独立董事	被选举
2025 年 05 月 30 日	彭镜辉	职工代表董事	被选举
2026 年 6 月 18 日	李莹	独立董事	任期满离任
2026 年 6 月 18 日	张瑾	独立董事	被选举

最近三年内，发行人的高级管理人员变动情况如下：

时间	姓名	职务	变动说明
2025 年 08 月 06 日	管术春	副总经理	因工作调整原因离任
2025 年 05 月 30 日	陈炯辉	副总经理	因工作调整原因离任

报告期内，公司的董事、高级管理人员未发生重大变化。上述人员的变动是基于公司的规范运作及公司生产经营的需要而作出的调整，已履行了必要的法律程序。

七、发行人特别表决权股份或类似安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排情形。

八、公司所处行业的基本情况

（一）公司所处行业的分类

公司主营业务为印制电路板的研发、生产与销售。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”。

（二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业主管部门及监管体制

广合科技所处行业按照市场规律运作，市场竞争充分。企业进行面向市场自主经营，政府部门进行产业宏观调控，行业协会进行引导协调。

（1）行业的主管部门

中华人民共和国工业和信息化部（以下简称“工信部”）是印制电路板行业的主管部门，其主要职责包括提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

（2）行业自律性组织

中国电子电路行业协会（China Printed Circuit Association，CPCA），原名中国印制电路行业协会，是行业自律组织，隶属工信部业务主管领导的具有独立法人资格的国家一级行业协会。公司是协会理事单位之一。

CPCA 履行服务企业的宗旨，为企业提供服务与咨询，提供行业动态信息；参与行业标准制定，负责组织各类学术交流活动等；根据国家法律法规对企业进行指导，协助政府部门对印制电路行业进行管理等。

2、最近三年监管政策变化

印制电路板是支撑数字经济发展的重要资源和基础设施，近年来国家政策大力支持我国印制电路板产业发展。有关法律、法规及政策情况见下表：

序号	发布时间	部门	政策名称	有关内容
1	2026 年 3 月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	规划提出要推进全产业链创新，在建设现代化产业体系方面，明确强调要巩固提升我国产业在全球分工中的地位和竞争力，特别是要推进电子信息全产业链创新。打好关键核心技术攻坚战，要全链条推动集成电路、基础软件等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。
2	2025 年 11 月	工业和信息化部	《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》《印制电路板行业规范公告管理办法（2025 年本）》（征求意见稿）	提出引导 PCB 行业高质量发展，严格控制新上技术水平低的单纯扩大产能的印制电路板项目，鼓励向产业配套完善的园区集聚。文件从研发投入、产品技术能力、质量追溯、自动检测及 ERP、MES 等数字化建设提出要求；同时强调清洁生产、资源回收、节能减排、安全生产和职业卫生，并建立企业自愿申报、公告、抽查和动态退出机制。
3	2025 年 9 月	工业和信息化部、市场监管总局	《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》	提出围绕优供给、扩需求、强创新部署 16 项任务；目标为规模以上计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速约 7%，并推动电子信息制造业高端化、智能化、绿色化发展。
4	2025 年 5 月	工业和信息化部、国家发改委、国家数据局	《电子信息制造业数字化转型实施方案》	该方案旨在推动电子信息制造业数字化转型与智能化升级。围绕核心数智技术攻关、“点线面”一体化数转智改、高端化智能化绿色化协同提升、软硬协同基础和服务保障部署 18 项任务；到 2027 年，规模以上电子信息制造业企业关键工序数控化率超过 85%。
5	2024 年 9 月	工业和信息化部	《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》	以电子元器件及电子材料生产检测设备的自动化、智能化、柔性化、节能化改造为重点，加快推动电子元器件产品向微型化、片式化、集成化、高频化、高精度、高可靠发展。争取到 2027 年，全行业设备改造后，基本满足我国电子元器件、电子材料产业及相关行业对高性能、高效率、智能化、绿色化生产检测设备的使用需求，部分领域行业龙头企业的设备水平达到世界一流。
6	2024 年 4 月	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局	《推动工业领域设备更新实施方案》	方案提出实施先进设备更新行动，在电子等重点行业，围绕设计验证、测试验证、工艺验证等中试验证和检验检测环节，更新一批先进设备，提升工程化和产业化能力。同时实施数字化转型行动，重点推进电子信息制造业的电子产品专用智能制造装备与自动化装配线集成应用。
7	2024 年 1 月	广东省发展和改革委员会、广东省科学技术厅、广东省工业和信息化厅	《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划（2023-2025 年）》	推动电子元器件企业与整机厂联合开展核心技术攻关，支持建设高端片式电容器、电感器、电阻器等元器件以及高端印制电路板生产线，提升国产化水平；推动广州、深圳、珠海等地打造涵盖设计、制造、封测等环节的全产业链，并支持有关地区在封装测试、半导体材料、特种装备及零部件、电子化学品等领域培育产业龙头企业。
8	2023 年	国家发改委	《产业结构调整	将高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、

序号	发布时间	部门	政策名称	有关内容
	12 月		指导目录（2024 年本）》	刚挠印刷电路板及封装载板等列入鼓励类“二十八、信息产业”第 5 项“新型电子元器件制造”；第 6 项“电子元器件生产专用材料”涉及高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等电子产品用材料。
9	2023 年 9 月	工业和信息化部、财政部	《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》	将电子信息制造业界定为战略性、基础性、先导性产业；提出扩需求、优供给、强创新、稳外贸、促投资等工作举措，并提出 2023-2024 年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速 5%左右。
10	2023 年 2 月	中共中央、国务院	《数字中国建设整体布局规划》	夯实数字中国建设基础。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。

（三）行业发展基本情况

1、全球 PCB 行业发展基本情况

（1）全球 PCB 行业驱动因素

全球 PCB 行业需求持续增长，主要受下游应用领域日益多元以及新兴技术加快应用的推动。数据中心、人工智能、物联网、5G/6G 通信、智能驾驶、汽车电动化等产业的发展，带动高性能、高密度 PCB 的市场需求持续增加；工业自动化、医疗电子等领域的发展，也为 PCB 行业提供了新的市场空间。

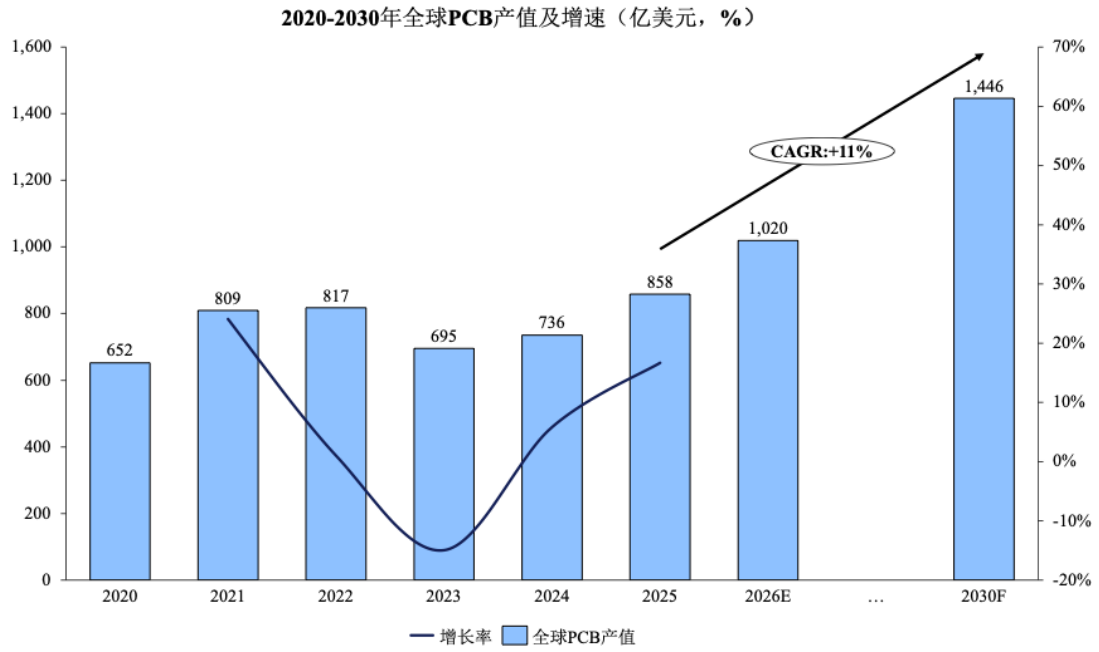
与此同时，下游电子产品向高性能、高集成度方向发展，推动 PCB 行业持续进行技术和产品迭代。为满足高性能计算、先进封装等应用需求，高多层板、HDI 板、柔性板、IC 载板等高端产品的市场需求不断增加。新材料及先进生产工艺的研发和应用，将进一步推动 PCB 行业技术升级，并对 PCB 企业的研发能力、工艺水平和规模化生产能力提出更高要求。

PCB 作为电子信息产业的重要基础组成部分，其发展受到主要国家和地区产业政策的支持，相关资金支持、税收优惠及产业链协同政策为 PCB 行业发展创造了良好的政策环境。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》提出，深入推进“东数西算”工程，构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网，推进算力资源规模化、集约化、绿色化、普惠化发展。相关政策的实施有利于推动算力基础设施及电子信息产业发展，为服务器、数据中心等领域的 PCB 需求提供支撑。

（2）全球 PCB 市场规模

受益于算力服务器及相关高速网络基础设施爆发式增长，高多层板及 HDI 板等高端 PCB 产品需求迅速增长，PCB 行业整体增长动能强劲。根据 Prismark 数据，2025 年全球 PCB 产值为 858.36 亿美元，同比增长 16.7%。

在人工智能技术变革浪潮下，未来算力基础设施、人工智能终端等高成长赛道将蓬勃发展，为 PCB 行业带来新一轮增长周期，未来全球 PCB 行业仍将呈现稳定增长的趋势。根据 Prismark 数据，2030 年全球 PCB 产值将达到 1,446.10 亿美元，2025 年至 2030 年的年均复合增长率达 11.0%。



资料来源：Prismark 2026 年 Q1 报告

1）按产品划分

从产品角度来看，多层板在全球 PCB 整体市场中占比最高，2025 年全球多层 PCB 的销售额为 334.05 亿美元，占比为 38.92%。随着全球对算力需求的提升，预计未来高多层板和 HDI 凭借其高密度互联、高性能数据传输、优越的散热性能、高可靠性和稳定性等优势，成为满足现代服务器复杂计算需求的最佳选择。

根据 Prismark 数据，PCB 市场中，不同层数的多层板在技术、应用等方面呈现显著差异。2025 年 4-6 层多层板全球总销售额达 167.06 亿美元；8-16 层 PCB 则主要应用于通信设备、服务器和高端汽车电子等领域，2025 年全球总销售额达到 114.45 亿美元；18 层及以上的多层 PCB 正处于快速发展阶段，主要应用 AI 服务器、高速网络通信等

新兴领域，2025 年全球总销售额达到 52.54 亿美元，并预计在 2030 年达到 197.59 亿美元，期间年复合增长率为 30.3%，是增长最快的细分市场。此外，HDI 销售额亦有望在 2030 年达到 300.10 亿美元，2025 年至 2030 年的年复合增长率达 13.1%。

2025-2030 年全球 PCB 行业产品情况

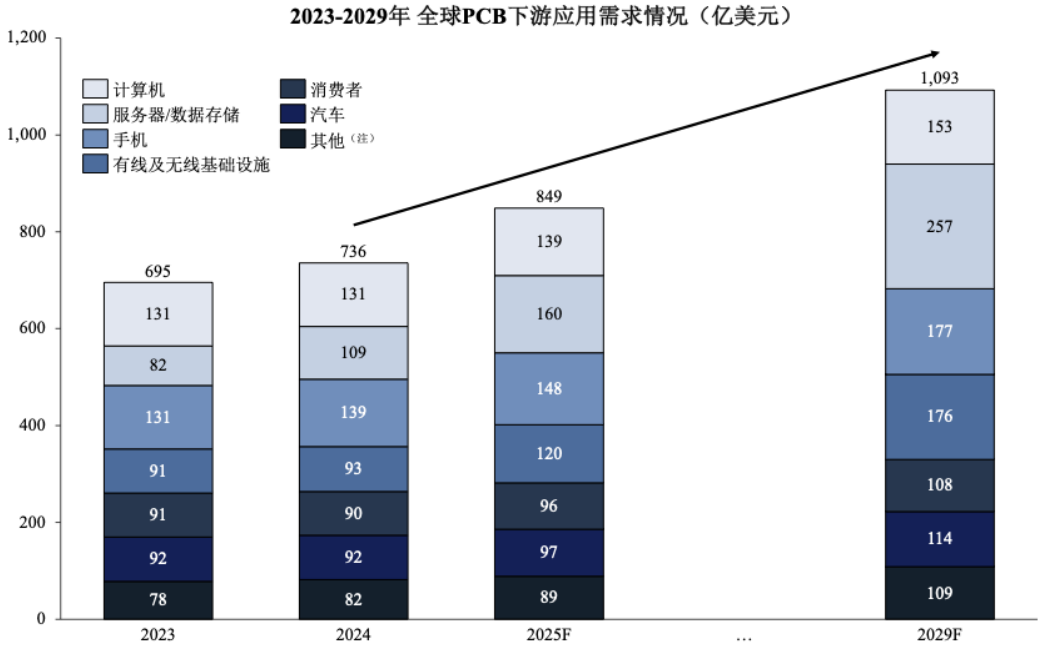
单位：百万美元

产品类别	2025		2026E		2030F	2025-2030F
	产值	同比增长率	产值	同比增长率	产值	复合增长率
纸基板/单面板/双面板	8,440	6.2%	8,806	4.3%	10,344	4.2%
4-6 层板	16,706	7.2%	17,218	3.1%	20,159	3.8%
8-16 层板	11,445	19.8%	13,706	19.7%	18,645	10.3%
18 层及以上多层板	5,254	84.2%	9,406	79.0%	19,759	30.3%
HDI 板	16,197	29.4%	19,923	23.0%	30,010	13.1%
封装基板	14,891	18.2%	19,180	28.8%	29,610	14.7%
柔性板	12,903	3.2%	13,714	6.3%	16,083	4.5%
合计	**85,836**	**16.7%**	**101,954**	**18.8%**	**144,610**	**11.0%**

2）按下游应用划分

全球 PCB 下游应用领域分布广泛，主要包括计算机、服务器/数据存储、手机、有线及无线基础设施、消费电子、汽车、工业、医疗等领域。从下游应用来看，根据 Prismark 的数据，2024 年服务器/数据存储 PCB 的销售额达到 109.16 亿美元，并预计在 2029 年增长至 257.29 亿美元，是增速最快的细分赛道，期间年复合增长率为 18.7%。

PCB 行业的成长与下游电子信息产业的发展密切相关，两者相互促进。随着以人工智能为代表的新一代信息技术的发展，对数据存储和算力的需求呈高增长态势，算力服务器行业发展空间广阔。



资料来源：Prismark 2025 年 Q4 报告
注：其他包括工控、医疗、军事/航空航天

（3）全球 PCB 行业发展趋势

高性能化发展。高性能化主要是指 PCB 提高阻抗性和散热性等方面的性能，从而增强产品的可靠性。使用层数更高、配线更短、电路阻抗更低的 PCB，使终端产品能够高速高频工作、性能稳定、承担更复杂的功能。PCB 的阻抗性提升常见于服务器主板，通过优化材料与层间结构，确保服务器高速处理数据时的稳定性。而通信设备对 PCB 的高频稳定性要求高，这类 PCB 采用高频专用材料、结合高精度加工技术确保毫米波频段信号的完整传输。高速高频终端应用也对 PCB 的散热性提出高要求，针对算力服务器、汽车电子等应用场景，PCB 行业正在开发更先进的散热解决方案，以解决高功率密度带来的热管理挑战。

高密度化发展。电子产品更新换代速度加快，新一代的电子产品朝着微型化的方向发展，促进 PCB 产品向高密度化方向发展。高密度化对电路板孔径大小、布线宽度、层数高低等方面提出高要求，HDI 技术是 PCB 先进技术的体现，正不断从低阶 HDI 向更高阶的任意层互连发展，以满足智能手机、可穿戴设备等消费电子产品对更小体积和更高集成度的需求。高密度要求对电路板的孔径大小、布线宽度、层数高低等参数提出了挑战。通过采用更精细的盲埋孔设计和微孔技术，PCB 布线密度得到显著提升。

绿色化发展。全球环保法规趋严与碳中和目标驱动下，PCB 行业加速转向低碳可

持续制造模式。环保材料逐步替代传统工艺，从源头减少有毒物质排放。生物基树脂和可降解材料的研发突破，为 PCB 全生命周期绿色化提供技术支撑。同时，循环经济理念推动废旧电路板金属回收、再生铜箔等闭环工艺革新，形成“生产－应用－回收”的生态链。绿色化发展将成为 PCB 企业构建差异化竞争力的核心要素。

区域化供应链重构。地缘政治格局及供应链安全需求驱动全球 PCB 产业链加速重构，形成多中心、区域化布局新态势。东南亚凭借劳动力成本优势和政策激励，正承接产能转移，形成规模化制造集群。中国作为全球最大生产基地，正通过东部沿海地区的高端产业集群，加速向高频高速 PCB、HDI PCB 等高附加值产品升级，逐步实现进口替代。同时推动产能向泰国等东南亚国家梯度转移，深化区域产业链协作，优化跨境生产网络，构建更具韧性的全球供应链生态系统。

2、算力服务器 PCB 行业发展基本情况

（1）算力服务器 PCB 定义及分类

算力服务器 PCB 作为算力基础设施的物理载体与信号中枢，其功能已从基础电路连接演变为支撑高性能计算的核心技术平台。首先，PCB 为 CPU、GPU、内存、网卡、电源等核心组件提供物理安装平台，通过导电线路和焊盘实现各组件间的机械固定与电气连接。其次，作为信号传输通道，PCB 通过精密布线设计实现高速数据交换。其导线和层间连接技术保障了芯片间、内存与存储设备之间的低延迟、高带宽通信，同时减少信号干扰和损耗。算力服务器 PCB 主要包括 AI 服务器加速板、UBB 及交换板、CPU 主板，以及存储、内存、网卡等配板。

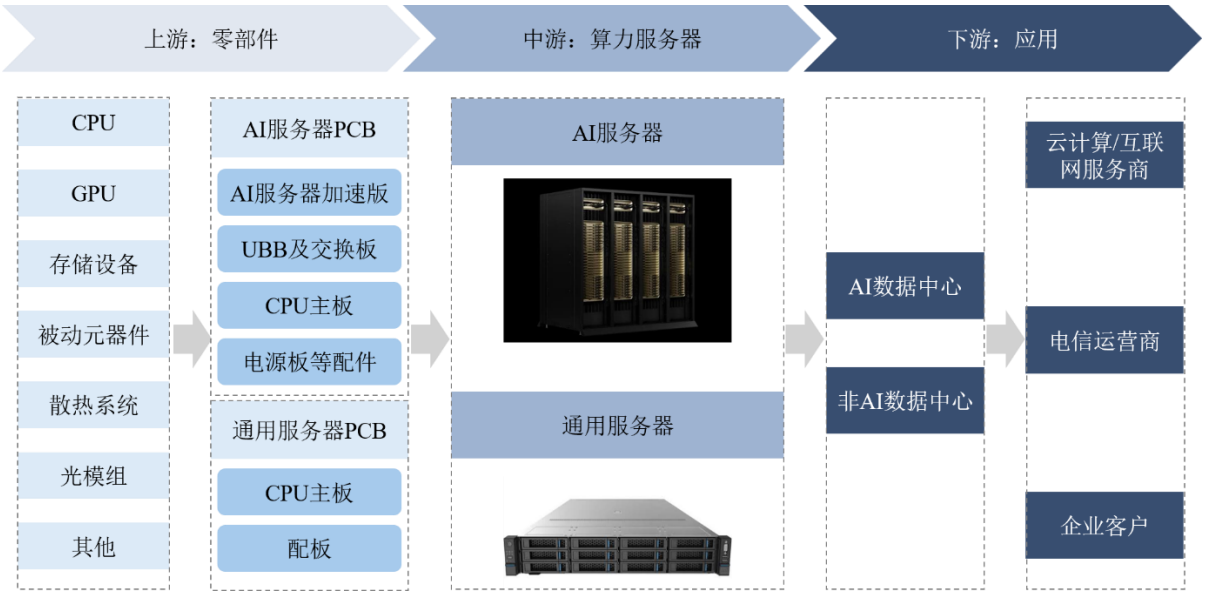
CPU 主板作为核心枢纽，协调各部件高效运作，在设计上采用多层布线，确保信号稳定，处理复杂任务。CPU 主板在高负载下仍然能够保持稳定，保障服务器可靠运行。随着服务器芯片平台的持续迭代，CPU 主板的工艺和材料技术经历了显著升级，以满足更高的信号传输速度、更低的数据传输损耗及更复杂的布线密度需求。因此，CPU 主板的产品单价随着其工艺、材料的升级，逐步提升。

（2）算力服务器产业链

算力服务器产业链的上游包括 CPU、GPU、存储设备、被动元器件、散热系统、光模块及 PCB 等零部件。其中，PCB 作为关键基础材料，应用广泛，贯穿整个算力硬件体系。算力 PCB 包括 AI 服务器加速板、UBB 及交换板、CPU 主板以及配板。

产业链中游的服务器是算力的主要载体，分为 AI 服务器和通用服务器两类。AI 服务器专为人工智能应用设计，适用于深度学习训练、推理、自然语言处理和计算机视觉等复杂计算任务。下游的数据中心是算力服务的基础设施，包括 AI 数据中心和非 AI 数据中心。终端应用客户主要包括互联网服务商、云计算服务商、电信运营商、企业客户等。

算力服务器价值链



（3）算力服务器 PCB 行业驱动因素

数据中心扩张驱动需求增长。全球数字化转型加速推动数据中心建设进入高速增长期，云计算、大数据、物联网及人工智能应用的普及促使数据处理需求上升。服务器作为数据存储与处理的核心载体，其部署密度和性能标准持续提升，带动 PCB 作为关键互连组件的用量增长。同时，绿色低碳政策推动数据中心能效升级，增加对高密度、高散热性能的 PCB 的需求。

服务器平台迭代推动技术升级。新一代 PCIe 5.0/6.0 协议及高速通信标准的普及，对 PCB 信号完整性提出更高要求。服务器架构从传统 CPU 为主向 CPU+GPU 异构计算演进，需通过多层堆迭设计实现芯片间高速互联，并采用极低损耗材料减少高频信号衰减。此外，AI 服务器加速卡与交换机板等组件推动 PCB 向高厚径比、微孔互连等精密制造方向发展。

国产替代加速本土供应链崛起。全球供应链安全诉求与本土技术突破双轮驱动下，国产 PCB 制造商正加速抢占高端市场。国产算力芯片的崛起，带动配套 PCB 供应链向

本土化迁移。国内企业通过改良材料配方、优化加工工艺、引入智能化产线等，提高多层服务器 PCB 的量产能力打破国外在超高层板领域的垄断，通过成本优势推动算力服务器 PCB 的规模化应用。

（4）算力服务器 PCB 市场规模

按算力服务器类型划分，算力服务器 PCB 包括通用服务器 PCB 和 AI 服务器 PCB。AI 服务器已成为算力服务器 PCB 市场的重要增长动力。与通用服务器相比，AI 服务器增加了加速板、UBB 及交换板，这使得其 PCB 产品在技术门槛和单机价值量方面均显著高于传统通用服务器。因此，在 AI 服务器市场的驱动下，AI 服务器 PCB 市场规模将以更高的增速增长。根据 Prismark 的数据，2025 年应用于 AI 服务器的 PCB 及封装基板合计约占全球 PCB 市场的 11%，市场规模约为 94 亿美元；预计 2026 年该占比将提升至 17%，市场规模达到 169 亿美元。其中，HDI 板占据较大比重；应用于 AI 服务器的多层板市场规模在 2025 年约为 38 亿美元，预计 2026 年将增至 77 亿美元，且复杂高多层板市场增长尤为迅速。AI 服务器多层板的快速增长，不仅得益于 AI 数据中心的加速建设，也受到服务器架构变革的推动。随着大语言模型（LLM）的规模不断扩大以及推理需求快速增长，行业正由传统的 8-GPU 服务器向集成数十颗 GPU 的高度集成化 AI 机柜演进。

（5）算力服务器 PCB 行业发展趋势

持续的产品迭代及高端化发展。AI 算力需求的爆发推动 PCB 技术向高频高速、高密度方向加速迭代。AI 服务器对 PCB 层数、信号传输速率及散热性能的要求显著提升。主流 AI 服务器 PCB 层数相比传统服务器大幅增加，且需支持 PCIe 5.0/6.0 接口，传输速率显著提高，同时采用极低损耗材料来降低介电常数和介质损耗。PCB 向超高层数、微型化布线演进，进一步提升信号完整性和电源分配效率。

国内企业的全球扩张与产能转移。在地缘政治压力和成本驱动因素下，中国 PCB 企业正加速全球产能布局。为绕过贸易壁垒并降低制造成本，许多 PCB 企业在越南和泰国建立生产基地，形成“国内研发+海外制造”的双循环模式。与此同时，国内企业将产能转移至海外。

市场集中度进一步提升。行业加速向技术壁垒高、规模化生产的头部企业集中。部分国内制造商突破高端 PCB 技术，如 HDI、先进封装基板，逐步替代欧美日企份额。

此外，头部效应凸显，AI 服务器 PCB 的高技术门槛挤压中小制造商生存空间，龙头企业凭借技术储备、客户绑定及产能优势主导市场。

智能化制造与工艺革新。算力服务器 PCB 生产正向全流程智能化与工艺深度革新演进。随着 AI 算法的渗透，PCB 制造商开始利用机器学习优化布线方案。产线智能化改造推动精密加工能力跃升，通过视觉检测系统实时监控微孔精度、层间对位偏差等关键参数，确保超高层板良率稳定。同时，工艺革新聚焦超薄芯板压合、高厚径比钻孔等核心环节，突破传统多层板物理极限，为下一代算力硬件提供可靠基板支撑。

3、行业竞争格局及主要参与者

（1）全球 PCB 行业竞争格局与主要企业

全球 PCB 产业主要分布于中国大陆、中国台湾、日本、韩国、欧美及东南亚等国家和地区。近年来，随着电子信息制造产业链持续向亚洲地区集中，中国大陆已成为全球 PCB 产值规模最大的生产区域。同时，受供应链安全、贴近客户生产基地及降低跨境供应风险等因素影响，主要 PCB 企业逐步完善中国大陆、中国台湾及东南亚等地的生产布局，全球 PCB 产业呈现区域化、多中心的发展趋势。

全球 PCB 生产企业数量较多，行业整体市场竞争较为充分。不同 PCB 企业在产品类型、技术能力和下游应用领域等方面形成了差异化竞争格局。随着人工智能、数据中心、高速网络和先进封装等领域快速发展，具备高多层板、HDI 板、IC 载板及高速高频 PCB 研发和规模化生产能力的企业竞争优势逐步增强，行业资源呈现向技术、产能及客户资源领先企业集中的趋势。

根据 Prismark 统计，2025 年全球前十大 PCB 企业收入合计为 323.91 亿美元，具体情况如下：

单位：亿美元

排名	公司简称	总部位置	2025 年收入	基本情况
1	ZD Tech（臻鼎）	中国台湾	58.69	提供刚性板、FPC、HDI 板及 IC 载板的一站式产品服务，持续扩充产能，增长主要由 AI/服务器、光通信 PCB 及 IC 载板需求驱动。
2	Unimicron（欣兴）	中国台湾	42.25	IC 载板及 HDI 板的主要供应商，持续扩充先进载板和高端 HDI 板产能；2026 年初二期工厂处于设备安装阶段，并扩充 AI 及高性能计算用 ABF 载板产能。
3	Dongshan Precision（东山精密）	中国大陆	35.70	刚性板、FPC 及刚柔结合板的主要供应商，近期扩产重点包括 FPC、超细线路 PCB 及高

排名	公司简称	总部位置	2025 年收入	基本情况
				端 AI/服务器/计算 PCB，并将进一步加强 HDI 板及高层数板生产能力。
4	Shennan Circuit（深南电路）	中国大陆	32.95	2025 年增长主要受 AI 及通信 PCB 和 IC 载板需求推动，后续扩产将聚焦先进载板及高端 PCB。
5	TTM（迅达）	美国	29.06	近年来数据中心及军用 PCB 销售持续增长，并持续扩充产能，新增产能主要面向 AI/计算、网络、医疗及工业应用的先进 PCB。
6	WUS Group（沪电股份）	中国台湾	27.60	2025 年增长主要受 AI 及高性能计算、服务器、高速网络交换机和其他通信 PCB 需求推动，扩产将聚焦先进 PCB、高层数板及 HDI 板。
7	Victory Giant Technology（胜宏科技）	中国大陆	26.86	2025 年通过将业务重点转向 AI 服务器/计算及数据中心 PCB 实现显著增长，相关产品收入占 PCB 收入超过 40%；后续扩产将聚焦高层数板、HDI 板及高端多层板。
8	Compeq（华通）	中国台湾	24.46	2025 年增长主要由卫星、数据中心/网络 PCB 及高端 HDI 板需求推动；二期扩产项目主要面向卫星、数据中心及光模块用刚性 PCB，预计 2027 年投产。
9	Tripod（健鼎科技）	中国台湾	23.61	2025 年销售增长主要由服务器及笔记本电脑相关 PCB 带动；后续增长动力包括内存模组、服务器/AI 服务器、网络 PCB 及高层数板。
10	Mektec（旗胜科技）	日本	22.73	2025 年汽车及手机 FPC 出货较弱导致销售下滑；未来随着日本及欧洲客户订单增长，汽车 PCB 收入预计增加。
合计			**323.91**	

数据来源：Prismark

（2）中国大陆 PCB 行业竞争格局与主要企业

我国 PCB 产业经过多年发展，已形成珠三角、长三角等主要产业集群，市场参与者包括本土内资企业、中国台湾及中国香港资本控制企业以及其他外商投资企业，市场竞争较为充分。不同企业根据自身技术积累、客户结构和生产布局，在消费电子、通信设备、服务器及数据中心、汽车电子、工业控制等细分领域形成了不同的竞争优势。

近年来，伴随本土 PCB 企业持续加大技术研发和产能投入，内资企业在高多层板、HDI 板、IC 载板及高速高频 PCB 等中高端产品领域的竞争力不断增强。同时，人工智能及算力基础设施的发展进一步提高了下游客户对 PCB 企业技术研发、规模化生产、质量控制和全球交付能力的要求。

根据中国电子电路行业协会发布的《2025 年中国电子电路行业主要企业营收表》，2025 年 PCB 制造主要企业前十名营业收入合计为 1,944.80 亿元，具体情况如下：

单位：亿元

排名	公司名称	2025 年营业收入	同比增长	基本情况
1	鹏鼎控股	391.47	11.40%	A 股上市公司，其大陆生产基地主要分布在深圳、淮安和秦皇岛
2	东山精密	256.20	3.30%	A 股上市公司，相关情况见上表，其国内生产基地主要分布在苏州、盐城和珠海
3	深南电路	236.47	32.05%	A 股上市公司，相关情况见上表，主要生产基地位于深圳、无锡和南通
4	胜宏科技	192.92	79.77%	A 股上市公司，相关情况见上表，其大陆生产基地主要分布在广东惠州以及湖南长沙、益阳
5	沪电股份	189.45	42.00%	A 股上市公司，其大陆生产基地主要分布在昆山、黄石和常州金坛
6	健鼎科技	153.52	18.63%	中国台湾上市公司，相关情况见上表，其大陆生产基地主要分布在无锡和仙桃
7	景旺电子	153.08	20.92%	A 股上市公司，主营产品包括多层板、HDI 板、高多层板、FPC、MPCB 及刚挠结合板等，其大陆生产基地主要分布在深圳、龙川、吉水、信丰和珠海
8	华通	125.63	7.95%	中国台湾上市公司，相关情况见上表，其大陆生产基地主要分布在重庆、苏州和惠州
9	欣兴电子	124.06	22.76%	中国台湾上市公司，相关情况见上表，其大陆生产基地主要分布在深圳、昆山、苏州和黄石
10	建滔集团	122.00	10.51%	中国香港上市公司，主营单面板、双面板、多层板及 HDI 板
合计		**1,944.80**	-	-

注：东山精密营业收入为 PCB 业务收入；华通及欣兴电子营业收入为仅统计其中国大陆工厂的估值；建滔集团营业收入为相关 PCB 企业合计数据。
数据来源：中国电子电路行业协会、Prismark

（3）PCB 行业主要可比企业

公司是全球领先的算力服务器关键部件 PCB 制造商，主要从事研发、生产及销售应用于算力服务器及其他算力场景的定制化 PCB。结合相关企业的产品类型、技术能力和下游应用领域，公司主要竞争对手包括健鼎科技、金像电、深南电路、沪电股份、生益电子和胜宏科技。上述企业基本情况如下：

1）健鼎科技（3044.TW）

健鼎科技股份有限公司（简称“健鼎科技”）成立于 1991 年，总部位于中国台湾桃园，2002 年在中国台湾证券交易所上市。健鼎科技主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品主要应用于服务器、笔记本电脑、内存模块、网络设备及汽车电子等领域。近年来，健鼎科技持续发展服务器、AI 服务器及网络设备相关 PCB 产品，并提升高多层板和 HDI 板的生产能力。2025 年，健鼎科技实现合并营业收入 733.99 亿新台币。

2）金像电（2368.TW）

金像电子股份有限公司（简称“金像电”）成立于 1981 年，总部位于中国台湾桃园，1998 年在中国台湾证券交易所上市。金像电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品主要应用于服务器、AI 服务器、工作站、笔记本电脑、桌面电脑及网络通信设备等领域。近年来，金像电子持续扩大服务器及 AI 服务器 PCB 生产能力，并在中国台湾、中国大陆及泰国推进相关产能布局。2025 年，金像电子实现合并营业收入 600.04 亿新台币。

3）深南电路（002916.SZ）

深南电路股份有限公司（简称“深南电路”）成立于 1984 年，总部位于广东省深圳市，2017 年在深圳证券交易所主板上市。深南电路专注于电子互联领域，拥有印制电路板、封装基板及电子装联三项主营业务，具备由样品、中小批量至大批量的综合制造能力。其 PCB 产品主要应用于通信设备、服务器及数据中心、汽车电子和工业控制等领域，并持续发展 AI、通信领域所需的高速、高密度和高多层 PCB 产品。2025 年，深南电路实现营业收入 236.47 亿元。

4）沪电股份（002463.SZ）

沪士电子股份有限公司（简称“沪电股份”）成立于 1992 年，位于江苏省昆山市，2010 年在深圳证券交易所主板上市。沪电股份主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品主要应用于企业通信、数据中心基础设施、汽车电子以及办公和工业设备等领域。随着人工智能及算力基础设施的发展，沪电股份持续发展 AI 服务器、高性能计算和高速网络设备所需的高多层、高速高频 PCB 产品。2025 年，沪电股份实现营业收入 189.45 亿元。

5）胜宏科技（300476.SZ）

胜宏科技（惠州）股份有限公司（简称“胜宏科技”）成立于 2006 年，位于广东省惠州市，2015 年在深圳证券交易所创业板上市。胜宏科技主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品包括多层板、HDI 板、FPC 及刚挠结合板等，主要应用于人工智能、数据中心、汽车电子、通信设备、消费电子及工业控制等领域。近年来，胜宏科技重点发展 AI 服务器、算力及数据中心所需的高端多层板、高多层板和 HDI 产品。2025 年，胜宏科技实现营业收入 192.92 亿元。

6）生益电子（688183.SH）

生益电子股份有限公司（简称“生益电子”）成立于 1985 年，位于广东省东莞市，2021 年在上海证券交易所科创板上市。生益电子主要从事印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于通信设备、网络设备、计算机及服务器、汽车电子、消费电子和工业控制等领域。其产品技术定位以通信网络和服务器所需的高层、高密度、高速 PCB 为重点，并持续发展服务器、AI 服务器和高速网络设备所需的高多层板、HDI 板及高速高频 PCB 产品。2025 年，生益电子实现营业收入 94.94 亿元。

总体来看，PCB 产品市场参与者较多，市场竞争较为充分。算力服务器 PCB 在层数、材料、信号完整性、加工精度、可靠性及批量生产一致性等方面具有较高要求，行业竞争更多体现为研发设计能力、复杂工艺量产能力、客户认证、质量控制和全球交付能力等方面的综合竞争。公司主要面向服务器等中高端 PCB 应用市场，产品包括 CPU 主板、AI 服务器加速板、UBB 及交换板等。公司与上述可比企业的竞争主要集中于服务器、AI 算力、数据中心及高速网络所需高多层、高速高频 PCB 领域。

（四）公司的市场地位

1、市场地位

公司 2025 年主营业务收入为 510,188.98 万元，同比增长 46.63%。根据 Prismark 数据，以 2025 年收入计，公司在总部位于中国大陆的 PCB 制造商中排名第 12 位，在全球 PCB 制造商中排名第 34 位。

2、公司的核心竞争力

经过二十余年发展，公司在高性能计算、AI 服务器、通用服务器、存储服务器及数据中心交换机等领域积累了较为深厚的技术和产品经验，形成了以高速、高多层算力 PCB 为核心的产品体系。公司通过持续完善材料研究、工艺开发、产品验证、客户服务、生产管理和全球交付能力，逐步形成了算力 PCB 先发、客户资源、技术研发、快速响应以及管理运营等方面的竞争优势。

（1）算力 PCB 先发优势

算力服务器 PCB 通常与服务器芯片及整机平台同步迭代，具有产品层数高、材料性能要求严格、制造工艺复杂、研发及客户认证周期较长等特点。PCB 供应商不仅需

要具备高速低损耗材料应用、高多层及高阶 HDI 制造、可靠性验证和稳定交付能力，还需要及时跟进芯片及服务器平台的发展路线，在客户产品开发初期开展相应的材料和工艺储备。

公司成立于 2002 年，长期专注于多高层印制电路板的研发、生产与销售，并较早将云计算领域高速 PCB 材料及技术确立为核心研发方向。经过二十余年的积累，公司已形成覆盖材料研究、制造工艺、产品开发、客户验证及规模化生产的能力体系，产品广泛应用于 AI 服务器、通用服务器、高性能计算服务器、存储服务器及数据中心交换机等核心设备。

凭借长期积累的材料、工艺和产品经验，公司能够根据芯片和服务器平台的技术路线提前开展技术预研，并在客户新产品开发初期参与材料选型、设计优化和工艺验证，有助于公司及时把握产品迭代方向，推动研发成果通过客户认证并转化为批量生产能力，形成算力服务器 PCB 领域的先发优势。

（2）客户资源优势

PCB 作为电子元件的载体和连接纽带，其电气性能、可靠性及一致性直接影响服务器等终端产品的整体性能。全球领先服务器厂商及 EMS 提供商通常会对 PCB 供应商的研发能力、工艺技术、质量控制、交付保障、环保合规及可持续发展能力进行全面评估，初始认证周期通常长达一至两年。认证通过后，为保障产品质量和持续迭代，客户一般会与合格供应商保持长期稳定的合作关系，客户认证因此构成行业新进入者拓展高端服务器客户的重要壁垒。

公司已与全球领先的服务器品牌厂商、云计算及数据中心设备 OEM 厂商、ODM 厂商和 EMS 提供商建立长期合作关系。截至 2026 年 6 月 30 日，公司与多家全球领先服务器制造商的合作时间已超过十年；2017 年至 2025 年，公司获得某头部客户累计 30 次最佳供应商评级。长期稳定的客户合作关系使公司能够持续跟踪客户产品路线，在客户新产品研发、验证和量产阶段提供支持。

公司从客户产品开发早期即参与材料选型、设计优化、工艺验证及可靠性测试，并通过驻场技术支持、良率分析、工艺优化和成本改善等方式及时响应客户需求。公司在巩固算力服务器领域客户资源的同时，还积极拓展消费电子、工业控制、安防电子、通信及汽车电子等领域客户，进一步丰富产品应用场景和客户结构。

（3）技术研发优势

公司始终重视研发创新，建立了覆盖材料研究、制造工艺和产品开发的研发体系。公司研究院设置材料应用与研究实验室、产品研发组及创新工艺研究组，研发团队覆盖云计算产品、通信产品、应用终端产品及材料科学等方向。公司能够根据行业技术趋势和客户需求组织跨部门团队，开展前沿技术预研、新材料验证、定制化工艺开发和产品验证，并推动研发成果向量产工艺转化。2025 年度，公司研发投入为 2.80 亿元，同比增长 56.14%，占营业收入的 5.10%；截至 2026 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 699 人。持续的研发投入和专业化研发团队，为公司跟进芯片及服务器平台迭代、完善高速 PCB 材料数据库、开展高端产品工艺开发和提升产品可靠性提供了基础。

公司持续提升高速高多层、高阶 HDI 及复杂结构产品的研发和制造能力。2025 年，公司已具备 PCIe 6.0 平台转批量能力，完成 PCIe 交换板、UBB/IO 板、GPU 主板、中置背板等高端产品的工艺能力认证，并实现 400G、800G 交换机板量产；在厚板钻孔、高厚径比电镀和高精度背钻等关键工艺方面亦取得进展。2026 年 1-6 月，公司已完成 54 层高多层 PCB 及八阶 HDI 制造工艺的验证。

公司的技术创新成果获得了相关政府部门及行业组织认可。“服务器主板用印制电路板”获评第七批国家级“制造业单项冠军产品”，公司被认定为“高端服务器用 PCB 智能制造示范工厂”。2025 年，公司多项技术研发项目获得中国电子学会、广东省电子学会及广东省高新技术协会相关科技奖项，多项高端服务器 PCB 产品被认定为广东省名优高新技术产品。

（4）快速响应优势

随着算力服务器 PCB 向更高层数、更高密度、更低损耗和更复杂结构发展，客户对 PCB 产品的定制化及快速迭代能力提出了更高要求。针对上述特点，公司建立了 JDM（Joint Design Manufacture，联合设计制造）模式，参与客户产品早期开发、工程验证、设计验证、生产验证及量产优化等环节，实现客户需求、产品研发、工艺设计、验证测试、生产制造和量产交付之间的有效衔接。

在产品开发阶段，公司结合芯片规格和客户需求开展材料应用、前端设计及制造可行性研究，并根据验证结果优化材料选择、叠层结构和制造工艺；产品进入试生产及量产阶段后，公司通过数字化生产管理、关键工序监控、关键物料储备、双供应商管理及

质量追溯等措施保障生产和交付，并持续向客户提供良率分析、工艺优化及成本改善方案。

通过 JDM 模式，公司能够在客户产品开发早期识别材料、设计及工艺方面的潜在问题，缩短客户需求响应时间，提高产品由设计验证向规模化生产转换的效率。同时，公司在不同客户和产品平台中积累的项目经验能够持续完善材料数据库、工艺参数及产品开发体系，进一步提升产品稳定性、可靠性和交付能力。

（5）远见卓识的管理优势

公司核心管理团队均在电子电路、PCB 行业拥有超过 20 年的丰富经验，具备深厚的市场洞察力和卓越的执行能力。公司管理团队能够有效识别行业趋势，牵头推动公司战略落地，助力公司实现稳健成长。

公司创始人肖红星先生拥有近 30 年的电子技术行业经验。2013 年，其战略性组建富有经验的管理团队，带领公司稳步实现盈利增长。凭借其敏锐的市场洞察力，早在 2016 年即前瞻性布局了高速 PCB 材料在云计算领域的应用，推动公司在算力场景 PCB 领域取得显著的先发优势。公司总经理曾红女士亦拥有超过 30 年的 PCB 行业经验，是广受认可的行业专家，同时担任中国电子电路行业协会科学技术委员会副会长、中国电子学会电子制造与封装技术分会全国印制电路专委会副主任委员等重要职务。公司副总经理、总工程师黎钦源先生拥有超过 30 年的 PCB 行业经验，从事 PCB 的工艺制造及产品研发 20 余年，曾获得中国电子学会 2021 年科学技术进步三等奖，被广东省电路板行业协会评选为 2022 年“PCB 行业科技之星”，黎先生亦是多项行业标准修订的主要起草人，持有多项发明专利。

3、行业壁垒

（1）技术壁垒

PCB 制造属于资金和技术密集型行业，制造工艺复杂，具有一定的技术壁垒，具体表现为：

首先，印制电路板是一个市场细分复杂的行业，产品种类亦十分繁杂，包括单双面板、多层板、柔性板、HDI 板和封装基板等。各类 PCB 产品虽具有一些共同的基本工艺，但不同的 PCB 产品对基板厚度和材质、线宽、孔径和线距等技术要求、设计结构等要求均有所不同，对 PCB 制造企业的技术和工艺水平提出较高要求。

其次，从 PCB 生产流程来看，从产品开料到包装入库，需要经历数十道工序，同时需要融合材料、机械、计算机、电子、光学、化学等多学科的工艺技术。PCB 企业的工艺技术水平不仅取决于企业生产设备的配置，更来源于企业在生产过程中不断积累的经验。新进企业 PCB 生产制造经验不足，将面临较高的技术障碍。

（2）环保壁垒

PCB 的生产制造过程涉及到多种化学和电化学反应过程，生产的材料中也包含铜、镍金、银等重金属，存在一定的环保风险。近年来，全球环保力度在不断增强，国内外均颁布有环保方面的法规。国际上有欧盟颁布的《关于电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》（RoHS）、《报废电子电气设备指令》（WEEE）、《包装和包装废物指令》、《关于限制全氟辛烷磺酸销售及使用的指令》和《化学品注册、评估、许可和限制法规》（REACH）等；针对国内环保问题，中国政府发布了《中华人民共和国清洁生产促进法》《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》《清洁生产标准—印制电路板制造业》等一系列法律法规。这些规定对 PCB 行业面临的环保问题提出了规范性要求，保障 PCB 产业的可持续发展。环保的严格要求增加了 PCB 企业的运营成本，强化了企业的社会责任，拥有更强生产管理能力和资金实力的企业地位会加强，而规模较小、管理不规范的企业会被淘汰，行业门槛随之提高。

（3）客户壁垒

PCB 企业为客户提供定制化的产品，PCB 的质量直接影响客户的产品性能。因此，下游客户对 PCB 供应商的选择认证和管理非常重视。客户通常需要对供应商的工艺技术水平、运营管理能力、产品交期保障、质量控制体系、环保处理手段等方面要求较高，只有通过其认证的企业才有资格供货。一般情况下，要通过大客户的认证，从递交供应商申请资料到最终进入体系需要 1 到 2 年的时间。现有的企业进入大客户认证体系之后，往往会和客户保持长久稳定的合作关系，相对于新进入者具有明显的先发优势。

（4）管理能力壁垒

PCB 行业产品具有产品种类繁杂、生产流程长、工序多、定制化程度高、原材料品种多等特点，为保障自身的正常运行，企业必须具备较强的管理能力。良好的管理能力能有效保障产品的品质稳定以及交货及时，同时还能有效的控制生产成本，提高企业

的核心竞争力。对于新进入者，要构建一个完整、准确和高效运转的生产管理体系需要长期实践的积累，从而形成行业的管理能力壁垒。

（5）资金壁垒

PCB 生产具有技术复杂、生产流程长和制造工序多的特点，PCB 企业需要投入大量资金购置较多先进生产设备，同时为保障产品质量的可靠性往往还需配套高端的检测设备。PCB 企业的资金投入高，具有一定的资金壁垒。

（五）公司所在行业与上下游行业之间的关联性

公司所在行业的上游主要包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等原材料的生产及供应商。公司与上游供应商均建立了稳定的合作关系，能够满足公司经营需要。

公司所在行业的下游为各类电子产品的生产商，包括算力、工业、消费等领域。目前，我国国民经济各行业发展形势良好，各行业的信息化建设需求仍然旺盛。

综上所述，从产业链整体来看，公司所处行业的上游供应相对稳定，在下游客户的技术路线实现和迭代发展中起到至关重要的作用，在上下游产业链中具有重要地位。

九、公司主营业务具体情况

（一）公司主营业务、主营产品或服务

1、公司主营业务

公司是全球领先的算力服务器关键部件 PCB 制造商，主要从事研发、生产及销售应用于算力服务器及其他算力场景的定制化 PCB。于 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司来自算力场景 PCB 的收入分别为 18.58 亿元、27.06 亿元、41.23 亿元及 36.69 亿元，占主营业务收入的 73.24%、77.76%、80.82%及 89.77%。

PCB 是电子设备中承载并连接电子元器件的关键部件。在算力服务器领域，PCB 主要承担了服务器芯片、内存模块及其他关键组件之间的数据传输和散热功能。随着全球算力需求的不断提升，高性能的 PCB 已成为支持算力服务器高效运行不可或缺的关键部件。报告期内，公司向全球领先的算力服务器制造商和 EMS 提供商提供 PCB，持续在先进 PCB 材料研究、制造工艺，以及新产品开发等关键领域实现突破。

2、公司的主要产品

公司主要通过销售 PCB 获取收入。PCB 以绝缘基材为基板，表面覆压薄铜箔层；通过蚀刻工艺将铜箔加工成导电线路，实现集成电路、芯片、电阻、电容、连接器等各类电子元器件之间的电气互连，同时为元器件提供机械固定支撑，是各类电子产品不可或缺的核心基础组件。

（1）产品按应用领域分类

公司销售的 PCB 主要包括算力场景 PCB、工业场景 PCB 及消费场景 PCB。

1）算力场景 PCB

公司的算力场景 PCB 是专为算力服务器及 AI 训练和推理使用的运算及数据管理设备设计的高密度多层板 PCB。报告期内，公司的算力场景 PCB 包括算力服务器 PCB 和数据中心交换机 PCB。

①算力服务器 PCB

算力服务器 PCB 专为满足先进数据中心及智能计算基础设施在性能、可靠性和集成度方面的严苛要求而设计。算力服务器 PCB 是算力服务器的核心基础组件。公司算力服务器 PCB 主要分为两类，AI 服务器 PCB 及通用服务器 PCB。

AI 服务器 PCB

公司的 AI 服务器 PCB 是专为 AI 运算系统优化的服务器 PCB。这类 PCB 具有先进的性能，包括高密度多层结构及快速信号传输，这些对于以 AI 工作负载，如机器学习训练、推理任务和密集并行数据处理至关重要。截至报告期末，公司的 AI 服务器 PCB 的主要产品线如下：

AI 服务器加速板。这类 PCB 是 AI 服务器中 GPU 和 ASIC 等芯片的加速器模块的接口载体，旨在满足深度学习和其他计算密集型 AI 应用对稳定高效数据传输的需求。通过采用高层数及 HDI 设计，结合极低损耗层压板和极低轮廓铜箔，公司可以精确控制信号完整性，从而提供最佳性能。公司的 AI 加速板为 12 至 22 层的多层设计或三至七阶的 HDI 设计，导线最小宽度／间距为 50 微米，可实现高速传输和最佳的信号完整性。

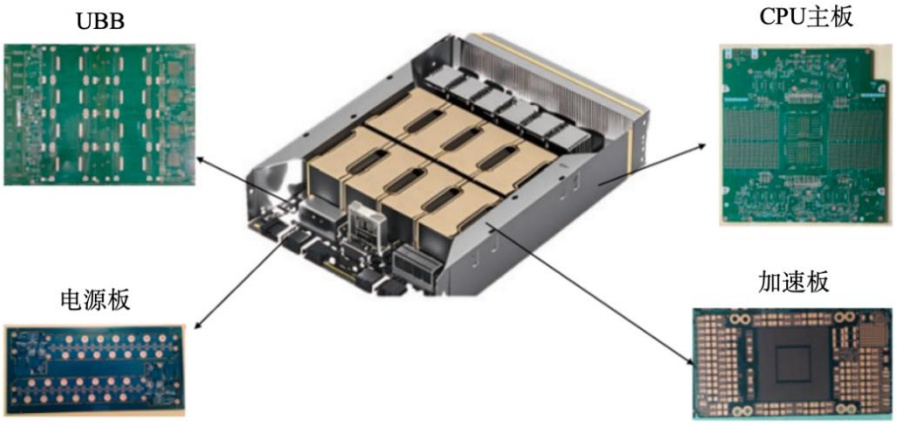
UBB 及交换板。这类 PCB 专为支持 GPU 等高性能芯片而设计。它们的主要功能

是将多个加速器模块互连起来，以最大限度地提高计算能力，通常采用高速连接器或 SMT 安装到 UBB 上，再将 2~8 个 GPU 互连起来的架构。公司的 UBB 及交换板具有 22 至 54 层的高层数、高厚径比以及使用极低损耗和极低轮廓铜箔以确保信号完整性等特点。

CPU 主板。这类 PCB 在 AI 服务器作为控制中枢，负责搭载 Host CPU 与大容量内存，完成系统初始化、任务调度、数据预处理、存储与网络 I/O 管理；通过 PCIe/CXL 高速链路连接 GPU 加速卡，分配算力任务、汇总计算结果；同时实现整机电源、温度、风扇的带外监控管理，是 CPU 与 GPU 算力集群协同工作的基础载体。类似的，交换机 CPU 主板（控制板）承担网络层面的控制功能，负责运行路由协议、网络配置、流量遥测、安全策略与设备管理。公司的 CPU 主板普遍采用 12 至 30 层的高层数设计，并提供单路、双路及四路设计方案，以适配不同算力规模与扩展需求。

电源板及其他配板。这类 PCB 主要包括电源板、风扇控制板、riser 卡、I/O 模块、硬盘背板等，在系统内发挥不同功能。比如电源板，这类 PCB 专为 AI 服务器工作负载优化，提供电源分配及组件互连等核心支持功能。它们设计用于处理高电流负载，具有强大的电源管理分配功能，以确保 AI 计算环境中的系统可靠性。公司的电源板采用 4 至 18 层的多层设计或二至四阶的 HDI 设计，可实现超大电流传输和保持热稳定性。

以下为集成于客户终端产品中的 AI 服务器 PCB 主要板卡示意图：



通用服务器 PCB

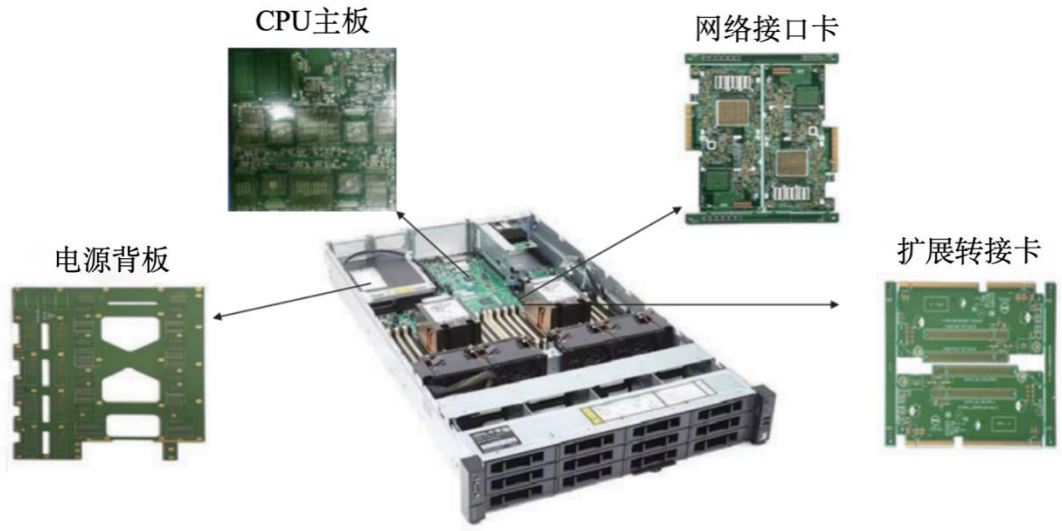
公司的通用服务器 PCB 是专为支持通用服务器内的标准运算操作而设计，用于处

理一般数据处理、存储管理和日常网络活动等任务。以下为截至报告期末，公司的通用服务器 PCB 的主要产品线：

通用服务器主板。这类 PCB 作为通用服务器内的中央计算平台，支持数据处理和网络管理任务。公司采用先进的制造工艺，如脉冲垂直连续电镀、高速介电材料、激光直接成像和真空蚀刻技术，以实现对导线宽度、间距和阻抗的精确控制。公司的通用服务器主板通常采用 12 至 22 层的多层设计。

通用服务器配板。这类 PCB 主要为标准计算操作承担电源分配、网络连接及垂直组件扩展等通用任务。这类 PCB 包含电源背板、网络接口卡和扩展转接卡等典型产品，通过紧凑精密的布线方案确保稳定的电气性能和高效的热管理能力。公司的通用服务器配板采用 4 至 12 层的多层设计。

以下为集成于客户终端产品中的通用服务器 PCB 示意图：



②数据中心交换机 PCB

公司的数据中心交换机 PCB 用于满足先进数据中心和 5G 网络对高速信号传输日益增长的需求，并采用小间距 BGA 走线、背钻、树脂塞孔等先进设计技术，以保持信号完整性并减少插入损耗，广泛应用于数据中心交换机等算力应用场景。截至报告期末，公司提供的数据中心交换机 PCB 层数范围为 16 至 46 层。

以下为集成于客户终端产品中的数据中心交换机 PCB 示意图：

数据中心交换机PCB



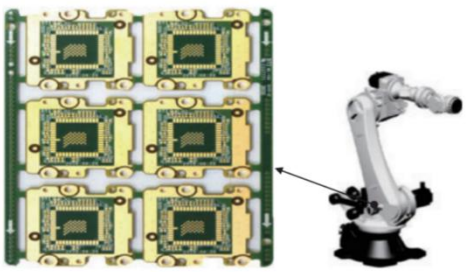
2）工业场景 PCB

公司的工业场景 PCB 是专为工业环境设计的 PCB，这些环境通常需要增强的耐用性、精度及一致的性能。公司的工业场景 PCB 主要包括工业控制 PCB、汽车电子 PCB 及通讯 PCB。以下为公司工业场景 PCB 的主要产品线：

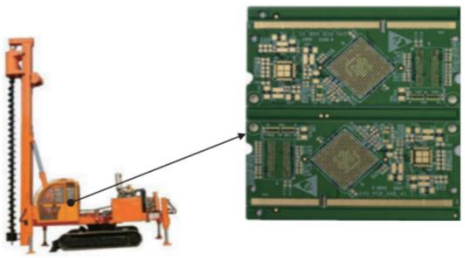
①工业控制 PCB

该类 PCB 旨在为集成至工业控制系统中而设计，其中包括工业机器人、工业相机、伺服驱动器及地质探测钻头。公司的工业控制 PCB 部分采用先进的多层 HDI 技术及阻抗控制在±10%以内。这使公司能够提供满足客户对功能性、安全性和耐用性要求的高精度 PCB。公司的工业控制 PCB 通常为 4 至 24 层板。

以下为集成于客户终端产品中的工业控制 PCB 示意图：



工业机器人

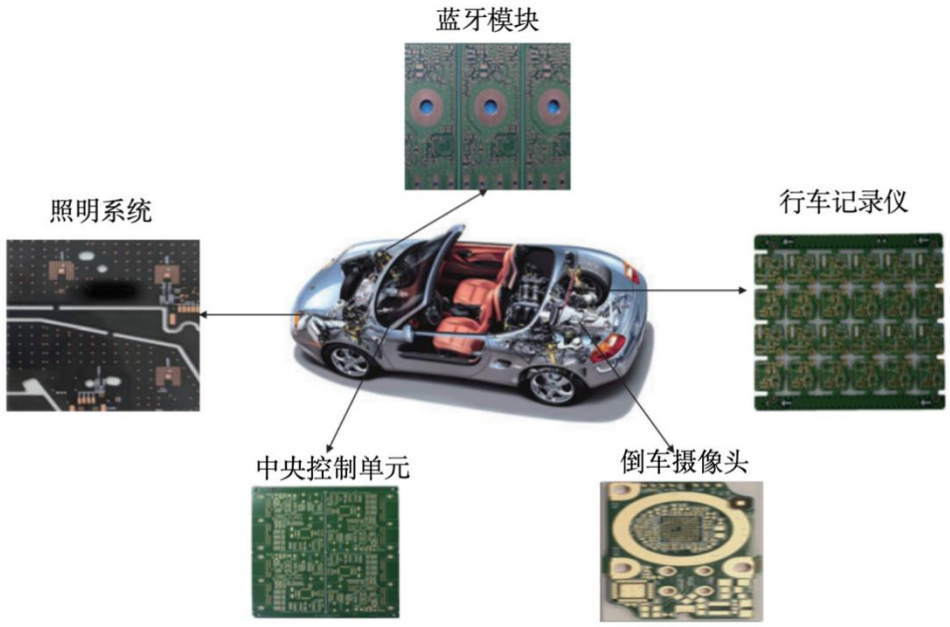


地质探测钻头

②汽车电子 PCB

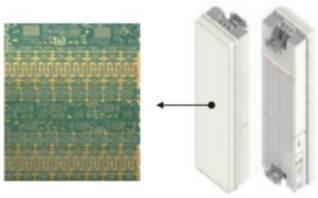
该类 PCB 专为关键汽车电子系统设计，主要应用于中央控制单元、车灯照明、蓝牙模块、行车记录仪及倒车摄像头等领域。公司的汽车电子 PCB 产品可靠性高、热管理性能及信号完整性更强，这些因素对于车载工作环境至关重要。为满足日益增长的行业需求，公司在汽车电子 PCB 中开发出先进的散热层结构，有效提升局部元器件的热管理效能及产品整体可靠性。公司提供 2 至 12 层板不等的汽车电子 PCB。

以下为集成于客户终端产品中的汽车电子 PCB 示意图：

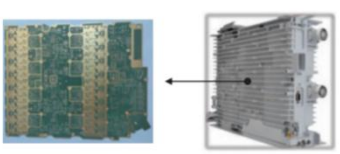


③通讯 PCB

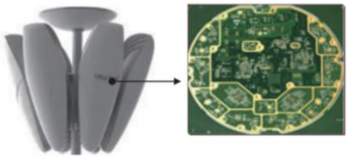
该类 PCB 主要应用于电信设备领域，支持数据传输、信号处理及网络连接等功能。核心设备 PCB 包括（i）通讯交换机 PCB——主要用于电信基站和通信服务器的信号传输和管理；及（ii）通讯基站 PCB，如包括有源天线处理单元模块（AAU）PCB、射频拉远单元（RRU）PCB、小基地台（Small Cell）PCB、通信光模块 PCB 等，可全面适配 5G 基础设施等现代通信基站的特定需求。公司的通讯 PCB 通常为 10 至 24 层板。



有源天线单元模块



射频拉远单元



小基地台

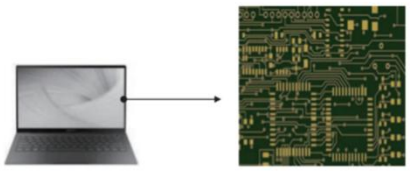
3）消费场景 PCB

公司的消费场景 PCB 专为大众消费电子设备及安防设备设计，具有结构紧凑、性价比高及在多种使用环境中性能稳定的特性。报告期内，公司的消费场景 PCB 主要包括消费电子 PCB 及安防电子 PCB。截至报告期末，公司消费场景 PCB 的主要产品线：

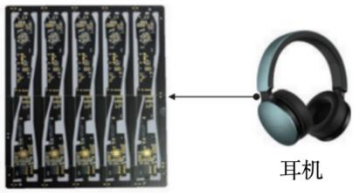
①消费电子 PCB

该类 PCB 通常用于打印机、笔记本电脑和平板电脑、显示卡、智能可穿戴设备和家用电器等消费类设备。凭借公司在算力和工业场景 PCB 方面的技术和经验，公司提供采用紧凑多层设计的消费电子产品，导线间距精确到 50 至 75 微米，并经过优化，以满足市场对微型化、能效和功能可靠性的需求。公司的消费电子 PCB 采用 6 至 14 层板的多层设计或 2 至 4 阶的 HDI 设计。

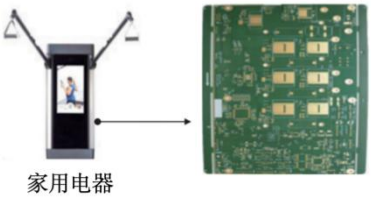
以下为集成于客户终端产品中的消费电子 PCB 示意图：



笔记本电脑



耳机



家用电器

②安防电子 PCB

该类 PCB 专为安防和监控系统设计，包括监控摄像头、烟雾探测器、面部识别系统和门禁对讲系统。公司的安防电子 PCB 采用 6 至 10 层板的多层设计或 2 至 3 阶的 HDI 设计。

以下为集成于客户终端产品中的安防电子 PCB 示意图：



面部识别系统　　烟雾探测器

（2）产品按制作工艺分类

公司销售的 PCB 主要包括多层板及 HDI 板。

1）多层板

多层板按层数分类。除单层板外，公司的多层板是通过在固定厚度内将多层导电电路堆栈在一起而制成的，可实现更复杂的设计并提供更高的性能。8 层或以上板（尤其是 18 层及以上板）的多层板 PCB 通常用于需要先进电气性能的应用，例如 AI 服务器 PCB 下的 CPU 主板、数据中心交换机 PCB 和通信 PCB。

2）HDI 板

HDI 板按级别分类，级别是指微孔层的数量。HDI 板使用专门的制造技术，包括盲孔和埋孔，以扩大可用的布线面积，从而允许在更小的板面积内进行更密集的电路连接。相较于主要采用机械钻孔且孔径较大的典型多层 PCB，微孔板 PCB 通常运用激光钻孔技术，从而实现更小的孔径。微孔的紧凑尺寸使单位面积内的互连点密度更高，并支持更细的导线宽度与间距。因此，HDI PCB 通常用于紧凑、高密度的电子产品，如 AI 服务器加速板等小型化、高性能产品，如智能网络接口卡及智能手机与笔记本计算机之主板。

（二）公司的业务模式

1、采购模式

公司根据生产计划安排采购计划，采取“以产定购”的采购模式。公司采购的主要原材料为覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等，主要来自中国大陆的供货商。公司供应链管理中心下设供应链管理部、采购部负责采购事务，供应链管理部负责集团供应商的定价、份额和管理，采购部负责主要原材料的集中采购。公司采用 ERP 和 SRM 系统管理采购信息和采购流程。原材料的主要采购流程如下：

（1）客户订单信息由市场营销中心录入到 ERP 系统，运营管理部根据需求时间和系统物控模块自动生成的主要原材料需求明细（原材料种类、型号、数量等）确定订单物料需求；

（2）基于客户订单对应的物料需求和整体物料预算，运营管理部统筹制定整体物料需求计划，提出采购申请，并交由采购部负责采购；采购部向 2 家及以上的《合格供应商名册》中的供应商询价，获得其报价后再综合考虑品质、交期、付款方式等因素后确定合格供应商，并向其发送采购订单；

（3）供应商根据采购订单的要求供货，采购部跟进原材料的供货进度，物品到货后，仓库检查采购到货物品、送货单等是否与采购订单一致，对需要送检的物品按要求送检，检验合格后方能办理入库，不合格物品分别按相应的程序要求作退货或让步接收处理。

2、生产模式

公司实行“以销定产”的生产组织模式，根据订单情况制定相应的生产计划，依据生产计划组织生产。公司的订单是根据客户的独特规格和技术要求的定制订单。公司的产能旨在与客户需求保持一致，确保 PCB 产品的稳定可靠供应。公司通常会根据客户的预测需求以及预期的市场趋势，以每月为基础来规划公司的生产。公司会持续监控工厂及设备利用率，并根据客户订单的滚动预测来更新公司的生产计划。此外，当公司的产能无法满足生产计划，会通过《合格供应商名册》寻找外协加工厂商进行生产，满足客户需求。

3、销售模式

报告期内，公司主要采用直销的销售模式，客户主要为电子产品制造商，包括终端品牌客户及 EMS 公司等。此外，公司委聘贸易商，以扩展市场触达并高效服务规模较小的终端客户及部分地区的终端客户，同时也有一小部分产品售予其他 PCB 制造商。该等 PCB 制造商在产能不足或不具备生产客户所需产品的能力时，对公司的产品有需求。

报告期内，公司营业收入按直销和非直销模式的分类构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	432,880.08	98.65%	535,454.37	97.61%	362,133.67	96.98%	251,684.36	93.97%
非直销	5,945.94	1.35%	13,082.77	2.39%	11,294.79	3.02%	16,142.67	6.03%
合计	**438,826.02**	**100.00%**	**548,537.14**	**100.00%**	**373,428.46**	**100.00%**	**267,827.03**	**100.00%**

注：上述非直销包括公司向贸易商与其他 PCB 制造商的销售金额。

经过多年发展，公司建立了较为完善的销售网络和售后服务体系。公司的市场营销人员和技术支持人员按照分工，共同负责公司对境内外客户的售前、售中和售后服务。公司与主要客户建立了长期稳定的合作关系。

4、研发模式

公司已建立系统化的研发管理机制，系统化地管理跨部门的研发活动。公司的研究院下设材料研究组、云计算产品研发组、通讯产品研发组、应用终端产品研发组、HDI 产品研发组、创新工艺组、专利保护及政府项目组，分工明确，各司其职。公司已建立完善的新项目研发流程，主要包括规划、立项、实施、进度监控、验收、归档六个环节，为公司的新产品、新技术、新工艺的研发提供了保障。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、产量及销售情况

报告期，公司产品的产能、产量和销量具体情况如下：

单位：万平方米

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产能	110.49	205.98	187.57	175.12

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
产量	94.17	183.05	148.76	125.90
销量	98.08	182.44	149.16	123.19
产能利用率	85.22%	88.87%	79.31%	71.89%
产销率	104.15%	99.67%	100.27%	97.85%

注：产能利用率=自产产量/产能；产销率=销量/自产产量。

2、主要客户情况

2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，广合科技向前五名客户的销售额分别为 175,669.13 万元、229,194.17 万元、333,192.90 万元和 291,171.26 万元，占各期销售总额的比例分别为 65.59%、61.38%、60.74%和 66.35%。公司客户集中度较高，与公司所处行业的市场竞争和产业供需格局相关。

单位：万元

	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
向前五名客户的营业收入合计数	291,171.26	333,192.90	229,194.17	175,669.13
占当期营业收入的比例	66.35%	60.74%	61.38%	65.59%

报告期内，各期第一大客户销售占比分别为 26.64%、24.61%、20.20%和 27.38%，公司不存在对单一客户的重大依赖。报告期各期，公司的前五大客户未发生变更。

报告期内，董事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东未在上述客户中持有权益。

（四）采购情况和主要供应商

广合科技产品和服务所需的主要原材料为覆铜板、半固化片、铜箔、铜球等材料。2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，广合科技向前五大供应商采购金额分别为 76,595.34 万元、122,229.59 万元、194,943.53 万元和 178,692.19 万元，占各期采购总额的比例分别为 58.25%、63.07%、61.22%和 63.61%，整体维持稳定，体现了公司与核心供应商长期稳定的合作关系。

单位：万元

	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
向前五名供应商的采购金额合计数	178,692.19	194,943.53	122,229.59	76,595.34
占当期采购总额的比例	63.61%	61.22%	63.07%	58.25%

报告期内，各期第一大供应商采购占比分别为 25.60%、22.08%、19.31%和 21.23%，

公司不存在对单一供应商的重大依赖的情况，报告期内前五大供应商未发生变化。

报告期内，董事、高级管理人员和其他核心人员，主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东未在上述供应商中持有权益。

（五）境外采购、销售情况

1、境内外采购情况

报告期内，公司境内外采购情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内采购	277,380.86	98.75%	311,859.62	97.93%	193,582.06	99.89%	131,227.73	99.81%
境外采购	3,523.63	1.25%	6,579.14	2.07%	209.33	0.11%	253.61	0.19%
合计	**280,904.50**	**100.00%**	**318,438.76**	**100.00%**	**193,791.39**	**100.00%**	**131,481.34**	**100.00%**

报告期内，发行人直接向境外供应商采购的金额分别为 253.61 万元、209.33 万元、6,579.14 万元和 3,523.63 万元，占采购总额的比例分别为 0.19%、0.11%、2.07%和 1.25%。发行人存在部分原材料直接向境外供应商采购的情况，包括覆铜板、半固化片等，境外直接采购金额较小，发行人对单一相关供应商不存在依赖。

2、境内外销售情况

报告期内，按销售区域划分的主营业务收入构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	91,618.23	22.42%	144,634.50	28.35%	79,662.61	22.90%	47,745.94	18.82%
境外销售	317,075.70	77.58%	365,554.48	71.65%	268,275.34	77.10%	205,967.65	81.18%
合计	**408,693.93**	**100.00%**	**510,188.98**	**100.00%**	**347,937.96**	**100.00%**	**253,713.59**	**100.00%**

发行人主营业务收入主要来源于中国境外。报告期内，境外销售收入分别为 205,967.65 万元、268,275.34 万元、365,554.48 万元和 317,075.70 万元，占主营业务收入的比例分别为 81.18%、77.10%、71.65%及 77.58%。公司出口产品主要销往保税区、中国香港、中国台湾、泰国、墨西哥等地区或国家。报告期内，公司各主要出口地区或国家未发生针对公司的重大贸易纠纷。

（六）现有业务发展安排及未来发展战略

1、现有业务发展安排

（1）技术纵深构建核心竞争力

1）前沿预研：针对全球先进材料设备技术，与供应商研发团队密切互动，改良 224G 及更高速率所需的新材料及其加工工艺；结合海内外头部客户需求，布局 448G 及以上信号速率的新工艺技术的开发；

2）极限制造：成立专项攻关团队，在超高层板、超细线路、高性能等领域实现良率与稳定性的行业标杆式突破；

3）仿真驱动设计：开展内部专项研究及产学研合作，深化从“制造执行”向“设计优化”前端延伸，为客户提供涵盖设计、制造的一体化解决方案。

（2）客户共生为客户创造价值

1）推行共同开发：设立战略客户技术研发团队，从早期到全过程参与客户设计及产品开发；

2）提供专属价值：探索为顶级客户设立专属产能单元和“一站式”服务团队，实现最高优先级响应；

3）深化数字连接：建立与核心客户的数据交换平台，实现需求、排产、物料计划的共享及应用。

（3）将质量打造成核心战略优势

1）技术快速迭代对产品可靠性及品质稳定性提出了更大挑战，品质管理必须从“保障性能”升维为“战略核心”和“信任基石”；

2）建立源头治理，过程免疫，供应链协同的“全程免疫”品质防控系统，打造“透视未来”的质量检测与可靠性验证能力，建设针对下一代产品可靠性测试与失效分析实验室，利用 AI 进行质量数据挖掘，实现从“检测缺陷”到“预测并预防潜在缺陷的跨越”；

3）推行零缺陷文化，在全员中树立“质量是设计并制造进去的，而非检验出来的”核心品质价值观，推动第一次就把工作做对的零缺陷实践。

2、未来发展战略

在广纳智慧、合聚创新的愿景指导下，公司致力于以卓越的质量与服务打造智能互联领域的全球领导者。

（1）拓展和深化全球业务

公司将通过深化客户合作和加强本地化运营，进一步拓展国际业务，提升全球市场竞争力。依托成熟的 JDM 模式，公司将进一步深化与全球领先服务器制造商的合作，积极参与客户产品从概念设计到量产的开发全过程，及时掌握客户需求变化，并提供与客户需求相匹配的技术及制造支持。较早参与客户产品开发，有助于公司更加准确地把握客户需求，并在传统制造服务基础上提供产品设计、工艺开发等增值服务。

未来，公司研发团队将持续提升核心 PCB 技术水平，重点围绕先进算力场景对高速数据传输、低信号损耗及高频运行稳定性等方面的需求开展研发，以适应客户产品规格的持续升级和迭代。公司将依托符合客户要求的质量保证流程、可靠性测试及认证体系，持续拓展国际客户群体，巩固全球市场地位。

同时，公司将持续推进国际化布局和本地化经营。目前，公司已完成泰国基地一期建设，主要生产算力服务器用高附加值 PCB 产品，并正在加快推进泰国基地二期建设。泰国基地二期建成后，预计将进一步扩大公司产能、完善技术储备，更好地满足全球领先客户持续增长的产品需求。此外，公司计划进一步开拓海外成熟市场，通过在当地组建销售和服务团队，开展客户关系维护和技术支持，相关团队不直接从事进出口业务，以提高客户沟通和服务效率，增强本地化市场开拓能力，提升品牌知名度和客户满意度。

（2）扩充高附加值产品组合

公司将持续优化产品结构，加大对高附加值、高技术含量 PCB 产品的研发投入，提高高端产品占比，增强盈利能力和市场竞争力。具体而言，公司将持续跟进服务器芯片平台的升级和迭代，积极开发具有稳定、可靠电气性能的 CPU 主板相关产品。在超高层数 UBB 及交换板方面，公司将通过持续积累生产经验，进一步提升规模化生产能力。同时，公司将继续开展相关技术研究，进一步提升产品的信号完整性及其在不同运行条件下的可靠性，并密切跟踪新兴市场发展趋势，积极发掘高附加值产品领域的业务机会。

在此基础上，公司拟进一步加大对重点产品和新兴应用领域的研发投入，重点覆盖

算力、AI 个人计算机、新型显示、低轨卫星、低空经济等领域。围绕相关产品的技术需求，公司将持续提升高速信号的稳定性和传输效率，增强精密制造能力，提高产品质量，进一步巩固技术优势。

（3）完善人才培养和储备体系

为满足业务持续发展需要，公司将进一步完善人才培养和储备体系，打造多元化、专业化且具有国际视野的人才队伍。目前，公司已建立较为完善的人才培养机制，通过持续开展内部培训、导师指导、自主学习及产学研合作等活动，系统提升员工的专业技能和履职能力，为员工成长和公司持续发展提供支持。

同时，公司将进一步加大研发、制造、营销及供应链管理等关键职能领域专业人才的引进力度，整合境内外招聘渠道，重点吸引 PCB 及相关行业人才，逐步建立跨地域、多学科的专业人才队伍，增强公司的市场竞争力。

此外，公司将持续深化与高等院校及科研机构的合作，通过共建联合实验室、开展研究项目及学术交流等方式培养专业人才，逐步建立兼具技术能力和管理能力的人才储备。未来，公司将进一步拓展与相关高等院校及科研机构的合作，完善人才储备机制，提升人才队伍建设水平。

十、公司的核心技术及研发情况

（一）研发投入情况

报告期内，公司的研发投入及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	23,010.51	27,979.30	17,919.75	12,058.87
研发投入占营业收入的比重	5.24%	5.10%	4.80%	4.50%

注：公司研发投入均为研发费用。

报告期各期，公司研发投入为 12,058.87 万元、17,919.75 万元、27,979.30 万元和 23,010.51 万元，占营业收入的比例分别为 4.50%、4.80%、5.10%和 5.24%。

公司一直注重核心技术的发展，目前拥有的核心技术均由公司研发团队通过自主研发获得，属于原始创新技术，处于国内领先水平。公司的核心技术覆盖了多层高精密 PCB 及 HDI 产品的设计、制造工艺及品质控制等多个关键领域，涵盖了新型工艺流程

优化、设备选型升级及材料应用创新等方向。截至 2026 年 6 月 30 日，公司获授权的境内专利共 279 项，其中含 103 项发明专利。

（二）研发人员情况

报告期各期末，发行人研发人员情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
人员数量（人）	699	530	391	291
人员数量占比	11.24%	10.60%	11.09%	11.09%

公司重视研发活动，通过多层次的人才梯队建设，构建高素质研发团队。报告期内，为了保证公司能够不断进行技术创新，保持产品的技术领先水平，保证公司能稳抓算力市场高速发展的机遇，公司在研发方面的投入逐年增加，研发人员也随之增长。

（三）公司核心技术及其先进性

自成立以来，广合科技坚持创新驱动，注重研发投入，始终专注于算力场景 PCB 等核心产品的研发工作，已经掌握了大量算力等领域的 PCB 核心技术。公司核心技术的基本情况如下：

序号	技术名称	技术来源	技术主要应用领域	技术先进性的具体表现
1	不对称叠构高速交换机电路板制造技术	自主技术	算力	该技术适配 112Gb/s 交换机主板生产，核心应用于 AI 1.6T 高速交换网络设备。采用超低损耗（super Low Loss）专用材料，产品板厚 4.5mm、层数可达 36 层以上，严格控制背钻残桩尺寸 2~6mil、阻抗精度±7%，保障高速信号稳定传输。创新采用 PCB 不对称 N+M 叠构设计，将 BGA 平整度管控至 0.1mm 以内，有效提升设备运行稳定性，广泛应用于 AI 算力设备及数据中心高速交换机场景。
2	超高密度互连 AI 加速卡电路板制造技术	自主技术	算力	基于多阶 HDI 板核心技术，成功实现 5 阶 HDI 盲孔精密加工。搭配超低损耗材料及 HVLP4 及以上高速铜箔，突破 18 层超高密度 AI 加速卡 PCB 加工工艺壁垒。可精准适配 AI 服务器 CPU、GPU 核心芯片的主板设计与生产，大幅提升电路板互连密度与信号传输效率，满足高端 AI 算力设备高速、精密的运行需求。
3	112Gb/s 电路板制造过程中的信号完整性控制技术	自主技术	算力	聚焦高速 PCB 加工过程中的信号完整性管控难点，通过仿真模拟精准把控板材介层厚度、铜箔粗糙度、背钻残桩范围及阻抗等核心参数。结合实际量产生产数据，搭建完善的 PCB 插入损耗数据库，形成“仿真+实测”一体化信号完整性管控体系。可实现 112Gb/s 高速电路板批量稳定生产，精准控制信号传输损耗，解决高速信号传输失真问题，为高端高速 PCB 设备的稳定运行提供核心技术支撑。

序号	技术名称	技术来源	技术主要应用领域	技术先进性的具体表现
4	PCIe 6 平台高速传输技术的服务器主板制作技术	自主技术	算力	适配 PCIe 6.0 全新传输标准，满足 32Gb/s 高速传输需求。采用超超低损耗（ultra low loss）高端板材，精细化管控背钻残桩尺寸 2~8mil，将 16GHz 频段插入损耗控制在 0.74db/inch 以内，同时将服务器主板 BGA 平整度严格管控在 0.1mm 以下。多维度精准把控核心工艺参数，有效保障 PCIe 高速传输的稳定性与可靠性，适配高端高速服务器主板量产需求。
5	超高厚径比制造技术	自主技术	算力	针对超高层、超厚 PCB 板材加工痛点，通过长期迭代优化电镀药水配方与生产工艺参数，突破超高厚径比加工技术壁垒。可实现板厚 4mm、孔径 0.2mm、厚径比 20:1 的高精度 PCB 加工，工艺精度行业领先。主要应用于 AI 设备及高速交换机超厚背板生产，有效提升厚板电路板的导通性能与结构稳定性，适配高端算力设备严苛的工艺要求。
6	超大 BGA 直接 SMT 无 socket 电路板制造技术	自主技术	算力	突破大尺寸 BGA 无插座直接贴片加工技术难题，适配 100mm 以上超大尺寸 PCB 板及 ARM 服务器芯片、400G 及以上高端交换机芯片的 SMT 直贴工艺。通过优化残铜率平衡方案，精准管控板材 X、Y、Z 三轴涨缩系数，搭配全流程热平衡控制技术，将大尺寸 BGA 区域平整度控制在 0.1mm 以内，大幅提升超大芯片贴片焊接精度与连接可靠性，保障高端网络及服务器设备长期稳定运行。

（四）公司在研项目情况

截至报告期末，公司主要在研项目情况如下：

序号	项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目的	预计对公司未来发展的影响
1	背钻 D+6/D+4 对准度控制技术研究	研究背钻 D+6/D+4 工艺下的对准度控制技术，解决多层板背钻对准精度不足、孔位偏差等问题	研究中	建立稳定的对准度控制工艺体系，将背钻对准精度提升至领先水平	提升该领域技术领先优势
2	GPU 加速卡（OAM）多阶 HDI 产品关键技术研究开发	开发 OAM 架构下多阶 HDI 产品关键技术，解决多阶 HDI 层间对准、阻抗控制等难题，满足高集成度需求	研究中	突破多阶 HDI 关键技术，实现 OAM 加速卡稳定量产，满足头部 GPU 厂商技术要求	拓展 AI 产业链客户，驱动公司 AI 领域业务布局
3	基于机器学习的高精度阻抗控制技术研究及应用项目	将机器学习应用于阻抗控制，优化预测与调节模型，解决传统工艺阻抗偏差大、调试周期长的问题	研究中	建立高精度阻抗控制体系，提升阻抗控制精度与生产良率，缩短调试周期	提升该领域技术领先优势
4	5%阻抗设计及控制技术研究	研究 5%阻抗设计与控制技术，优化阻抗匹配模型，满足高速信号传输场景需求	研究中	建立稳定的 5%阻抗设计与控制体系，将阻抗控制精度提升至行业领先水平	提升该领域技术领先优势
5	深微孔电镀关键技术的研究	研究深微孔电镀关键技术，解决深微孔电镀均匀	研究中	突破深微孔电镀技术瓶颈，实现深微孔电镀	提升该领域技术领先优势

序号	项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目的	预计对公司未来发展的影响
		性、孔壁质量及镀层可靠性等问题		工艺稳定量产，满足高密度多层板要求	
6	PAM4 信号链路仿真技术研究	研究 PAM4 信号链路仿真技术，优化仿真模型与算法，提升信号完整性预测准确性	研究中	建立高精度 PAM4 信号链路仿真体系，提升仿真预测精度达行业领先水平	提升高速信号 PCB 研发效率与技术优势
7	AI 服务器用大 BGA 阶梯金手指印制电路板关键技术的研究	开发适配 AI 服务器的阶梯金手指产品，解决阶梯结构加工精度与可靠性难题，满足 AI 设备连接需求	研究中	实现 AI 服务器用大 BGA 阶梯金手指印制电路板稳定量产，制造工艺能力达到行业领先水平	拓展 AI 产业链客户，驱动公司 AI 领域业务布局
8	PCB 超高厚径比电镀工艺技术的研究	攻克 PCB 超高厚径比电镀工艺技术难题，满足高端服务器 PCB 厚板产品制造要求	研究中	掌握超高厚径比电镀核心工艺，相关工艺能力达到行业领先水平	提升该领域技术领先优势
9	基于 PCIe6.0 信号速率的服务器主板用印制电路板的研究开发	攻克 PCIe6.0 服务器电路板核心技术难题，满足 PCIe6.0 服务器主板信号传输要求	研究中	实现 PCIe6.0 服务器电路板成功量产，相关性能指标达到行业领先水平	布局新一代高速服务器硬件赛道，夯实高速 PCB 核心竞争力
10	AI 服务器用 UBB 主板的研究开发	攻克 AI 服务器用 UBB 主板核心技术难题满足 AI 大算力主板硬件需求	研究中	实现 AI 服务器用 UBB 主板稳定量产，制造工艺能力达到行业领先水平	拓展 AI 产业链客户，驱动公司 AI 领域业务布局

（五）核心技术的技术来源及其对公司的影响

公司核心技术均来源于自主研发。公司在相关领域积累的核心技术形成了大量的专利。公司自主研发的一系列核心技术是公司最重要的核心资产，是确保公司持续保持创新能力、行业竞争力的必要前提，也是推进公司高水平科技自立自强和高质量发展的重要基础。

十一、公司的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备等，均与公司日常经营活动直接相关。截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产账面原值、累计折旧、减值准备及成新率情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
房屋及建筑物	188,372.29	23,067.23	-	165,305.06	87.75%

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	成新率
机器设备	283,594.16	80,529.41	2,271.62	200,793.13	70.80%
工具器具	5,770.31	2,511.15	17.35	3,241.81	56.18%
办公设备及其他	6,706.36	2,577.85	5.02	4,123.49	61.49%
合计	**484,443.12**	**108,685.64**	**2,293.98**	**373,463.50**	**77.09%**

注：成新率=固定资产账面价值/固定资产账面原值

截至 2026 年 6 月 30 日，公司固定资产的综合成新率为 77.09%，公司固定资产整体状态较好。

截至 2026 年 9 月 30 日，广合科技拥有的房屋及建筑物情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	房屋建筑面积（㎡）	用途	权利性质	他项权利
1	发行人	粤（2021）广州市不动产权第 06005712 号	广州开发区保盈大道 18 号	房屋所有权	33,284.88	厂房等	受让	无
2		粤（2024）广州市不动产权第 06019383 号	广州开发区保盈南路 22 号		34,538.76	厂房等	自建房	无
3	黄石广合	鄂（2022）黄石市不动产权第 0034499 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 A1 厂房及办公楼		139,770.40	工业	自建房	抵押
4		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034458 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 C 调度中心及食堂		8,169.42		自建房	无
5		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034459 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 C2 倒班楼		13,100.89		自建房	无
6		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034452 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D1 甲类化学品库		1,480.15		自建房	无
7		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034453 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D2 乙类化学品库		1,480.15		自建房	无
8		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034454 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D4 废水处理厂		2,837.01		自建房	无
9		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034455 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D5 消防水池及水泵房		346.69		自建房	无
10		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034500 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P1 门卫室		78.69		自建房	无
11		鄂（2022）黄石市不动产权第	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P2 门卫室		32.20		自建房	无

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	房屋建筑面积（㎡）	用途	权利性质	他项权利
		0034456 号						
12		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034460 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P3 门卫室		98.12		自建房	无
13	东莞广合	粤（2025）东莞不动产权第 0072039 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 1 号厂房		58,581.21	工业	自建房	无
14		粤（2025）东莞不动产权第 0072012 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 2 号厂房		10,365.79	工业	自建房	无
15		粤（2025）东莞不动产权第 0231601 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 3 号地下室		594.32	车库/车位	自建房	无
16		粤（2025）东莞不动产权第 0233926 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 4 号宿舍楼		25,456.09	集体宿舍	自建房	无
17		粤（2025）东莞不动产权第 0231631 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 5 号门卫室		28.50	工业	自建房	无
18	广天科技	粤（2017）广州市不动产权第 06204091 号	广州开发区保盈南路 1 号	房屋（构筑物）所有权	47,896.7	厂房等	自建房	无

（二）主要无形资产

1、土地使用权

截至 2026 年 9 月 30 日，公司拥有的土地使用权情况如下：

（1）境内不动产权

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	土地使用权面积（㎡）	用途	土地使用权期限	权利性质	他项权利
1	发行人	粤（2021）广州市不动产权第 06005712 号	广州开发区保盈大道 18 号	国有建设用地使用权	53,757.00	工业用地	2048.02.25 止	出让	无
2		粤（2024）广州市不动产权第 06019383 号	广州开发区保盈南路 22 号		37,001		2052.06.23 止		无
3		粤（2025）广州市不动产权第	广州市黄埔区东江大道以东		25,349.37		2075.10.27 止		无

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	土地使用权面积（㎡）	用途	土地使用权期限	权利性质	他项权利
		06098203 号							
4	黄石广合	鄂（2022）黄石市不动产权第 0034499 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 A1 厂房及办公楼		319,234		2069.12.30 止		抵押
5		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034458 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 C 调度中心及食堂		319,234				无
6		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034459 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 C2 倒班楼		319,234				无
7		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034452 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D1 甲类化学品库		319,234				无
8		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034453 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D2 乙类化学品库		319,234				无
9		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034454 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D4 废水处理厂		319,234				无
10		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034455 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 D5 消防水池及水泵房		319,234				无
11		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034500 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P1 门卫室		319,234				无
12		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034456 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P2 门卫室		319,234				无
13		鄂（2022）黄石市不动产权第 0034460 号	黄石开发区铁山区汪仁镇新城路东 19 号 P3 门卫室		319,234				无
14		鄂（2022）黄石市不动产权第 0033549 号	黄石开发区铁山区 A3 路以东钟山大道以南 B1 路以北 A5 路以西		174,901.72		2069.12.30 止		无
15	东莞广合	粤（2025）东莞不动产权第 0072039 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 1 号厂房		26,895.26		2071.9.16 止		无
16		粤（2025）东莞不动产权第 0072012 号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路 6 号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目 2 号厂房		26,895.26				无

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	土地使用权面积（㎡）	用途	土地使用权期限	权利性质	他项权利
17		粤（2025）东莞不动产权第0231601号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路6号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目3号地下室		26,895.26				无
18		粤（2025）东莞不动产权第0233926号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路6号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目4号宿舍楼		26,895.26				无
19		粤（2025）东莞不动产权第0231631号	东莞市望牛墩镇望牛墩临港路6号广合科技东莞智能自动化数控加工及电子制造服务项目5号门卫室		26,895.26				无
20	广天科技	粤（2017）广州市不动产权第06204091号	广州开发区保盈南路1号		34,791.00		2054.12.12止		无

（2）境外不动产权

序号	权利人	证书编号	坐落	权利类型	土地面积（㎡）	用途	土地使用权期限	权利性质	他项权利
1	泰国广合	86404	Bor Thong Subdistrict, Kabin Buri District, Prachin Buri Province, Thailand	土地所有权	约23,950.80	工业用地	永久	转让	无
2		86405			约23,951.60				
3		86406			约23,952.40				
4		86407			约34,944.80				
5		93988			约4,000				

根据境外律师出具的境外法律意见书，前述泰国土地目前已全部开发建设，并建有泰国广合的厂房及建筑物。具体而言，地契编号86404、86405、86406及86407的四宗土地相互毗邻，形成一块完整的大面积土地，并建有一栋大型厂房；而地契编号93988为另一宗独立土地，其上建有一栋多功能建筑物。泰国广合为前述建筑物的所有权人及占用人。

2、商标

截至2026年6月30日，公司及重要子公司拥有的对主营业务有重要影响的主要注册商标情况参见本募集说明书“附件一：广合科技及其控股子公司持有的主要注册商标”。

截至 2026 年 6 月 30 日，广合科技及其控股子公司拥有的商标权属清晰，不存在权利受限的情形。

3、专利

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及重要子公司拥有的对主营业务有重要影响的主要注册专利情况参见本募集说明书“附件二：广合科技及其控股子公司持有的主要注册专利”。截至 2026 年 6 月 30 日，广合科技及其控股子公司拥有的专利权属清晰，不存在权利受限的情形。

4、软件著作权

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及重要子公司拥有的对主营业务有重要影响的主要软件著作权情况参见本募集说明书“附件三：广合科技及其控股子公司持有的主要软件著作权”。截至 2026 年 6 月 30 日，广合科技及其控股子公司拥有的软件著作权权属清晰，不存在权利受限的情形。

（三）资产租赁情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司承租的用于生产，经营及研发房产的情况如下：

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	面积（m^2）	租赁用途	是否办理租赁备案
1	徐志鹏	广合科技	广州市黄埔区丰夏一街 11、15 号汇林公寓，B1008 等 204 间	2026.05.01-2027.04.30	/	员工宿舍	是
			广州市黄埔区丰夏一街 11、15 号汇林公寓，A801 等 50 间	2026.06.10-2027.06.30	/	员工宿舍	
			广州市黄埔区丰夏一街 11、15 号汇林公寓，B419 等 5 间	2026.03.01-2026.12.31	/	员工宿舍	是
2	广川科技（广州）有限公司	广合科技	广州市黄埔区开发大道 422 号第 3 栋（即 E 栋）、第 4 栋（即 F 栋）宿舍共 82 间宿舍	2026.01.01-2026.12.31	/	员工宿舍	否
			广州市黄埔区开发大道 422 号第 4 栋（即 F 栋）如 F252 等共 10 间宿舍	2026.01.01-2026.12.31	/	员工宿舍	否
			广州市黄埔区开发大道 422 号 B343 房	2026.01.01-2026.12.31	/	员工宿舍	否

序号	出租方	承租方	地址	租赁期间	面积（m^2）	租赁用途	是否办理租赁备案
3	普洛斯（广州）保税仓储有限公司	广合科技	广州市黄埔区保税区保盈西路 5 号	2026.04.01-2027.03.31	4,567	仓库	是
4	Airport II Property Management, LLC	美国广合	1735 North First Street in the City of San Jose, County of Santa Clara, and State of California	2025.6.1-2030.5.31	4,076 平方英尺	办公	/
5	M ESTATE CO., LTD.	泰国广合	位于 M ESTATE 的宿舍 85 间	2026.5.1-2027.4.30	/	员工宿舍	/
6	M ESTATE CO., LTD.	泰国广合	位于 M ESTATE 的宿舍 120 间	2026.11.1-2027.4.30	/	员工宿舍	/

十二、业务经营许可情况

（一）发行人拥有的主要生产经营资质

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已取得了与从事主营业务相关的主要业务资质，相关资质合法有效。公司拥有的与主营业务相关的主要资质如下：

序号	持证人	证书名称	核发机构	证书编号/备案编号	有效期
1	广合科技	辐射安全许可证	广州市生态环境局	粤环辐证[A0916]	2024.07.16-2029.07.15
2	黄石广合	辐射安全许可证	黄石市生态环境局	鄂环辐证[B2056]	2023.04.03-2028.04.02
3	东莞广合	辐射安全许可证	东莞市生态环境局望牛墩分局	粤环辐证[S1424]	2025.11.17-2030.11.16
4	泰国广合	投资促进证书	泰国投资促进委员会	67-0228-2-00-1-0	2024.02.08-2034.02.07
5	泰国广合	工业园区土地使用及经营许可	泰国工业园管理局	2-61-0-301-00758-2567	2023.07.06 起-长期
6	泰国广合	工业园区土地使用及经营许可	泰国工业园管理局	2-61-0-109 00540-2567	2024.05.31 起
7	泰国广合	建筑物建造、改建或拆除许可证	泰国工业园管理局	0551/2567	2024.05.07-2027.05.06
8	泰国广合	工业园区经营启动许可	泰国工业园管理局	2-61-0-301-00758-2567	2025.02.17 起
9	泰国广合	有害健康行业经营许可证	博通镇行政组织	57/2569	2026.09.18-2027.09.17
10	泰国广合	天然气设施运营许可证	泰国能源业务厅	/	2026.01.01-2026.12.31
11	泰国广合	食品经营场所设立许可证	博通镇行政组织	7/2569	2026.09.12-2027.09.13

“中国海关企业进出口信用信息公示平台”显示广合科技已完成报关单位备案（海关备案编码：440126002C），海关资质为“进出口货物收发货人”，行业种类为“电

子电路制造”，有效期至 2099 年 12 月 31 日。

“中国海关企业进出口信用信息公示平台”显示黄石广合已完成报关单位备案（海关备案编码：4202261002），海关资质为“进出口货物收发货人”，行业种类为“其他电子器件制造”，有效期至 2099 年 12 月 31 日。

“中国海关企业进出口信用信息公示平台”显示东莞广合已完成报关单位备案（海关备案编码：4419963DJD），海关资质为“进出口货物收发货人”，行业种类为“电子电路制造”，有效期至 2099 年 12 月 31 日。

发行人及其子公司排污许可证取得情况如下：

序号	持证人	证书名称	核发机构	证书编号/备案编号	有效期
1	广合科技	排污许可证	广州开发区行政审批局	91440116739749431N001T	2025.07.14-2030.07.13
2	广合科技	排污许可证	广州开发区行政审批局	91440116739749431N002Q	2024.12.26-2029.12.25
3	黄石广合	排污许可证	黄石市生态环境局	91420200MA49AUDU70001V	2024.07.12-2029.07.11
4	东莞广合	排污许可证	东莞市生态环境局	91441900MA55XA2E5T001X	2025.10.31-2030.10.30

发行人及其子公司的产品质量、技术标准证书取得情况如下：

序号	持证人	证书名称	核发机构	证书编号/备案编号	有效期
1	广合科技	IEQC QC080000：2017	SGS	IECQ-H SGSCN18.0067	2025.12.01-2027.12.03
2	广合科技	IATF16949：2016	SGS	0603117	2026.04.29-2029.04.28
3	广合科技	ISO/IEC27001：2022	SGS	CN20/31515	2026.09.14-2029.09.13
4	广合科技	ISO13485：2016	SGS	CN16/30665	2025.04.27-2028.04.26
5	广合科技	ISO45001：2018	SGS	CN19/30599	2025.05.07-2028.05.06
6	广合科技	ISO 14001：2015	SGS	CN13/31654	2025.07.04-2028.07.03
7	广合科技	ISO9001：2015	SGS	CN24/00006018	2025.05.19-2027.09.22
8	广合科技	ISO 50001:2018	中鉴	EnMS20240012	2024.03.22-2027.03.21
9	广合科技	CQC 产品认证证书（多层）	CQC	CQC24134448964	2026.5.12-2028.12.05
10	广合科技	CQC 产品认证证书（双层）	CQC	CQC24134448972	2024.10.18-2028.12.05
11	黄石广合	IEQC QC080000：2017	SGS	IECQ-HSGSCN21.0103	2024.10.28-2027.10.27
12	黄石广合	ISO9001：2015	SGS	CN22/00003766	2025.10.30-2028.10.29

序号	持证人	证书名称	核发机构	证书编号/备案编号	有效期
13	黄石广合	ISO45001：2018	SGS	CN22/00001028	2025.05.17-2028.05.16
14	黄石广合	ISO14001：2015	SGS	CN22/00001029	2025.05.17-2028.05.16
15	黄石广合	IATF16949：2016	SGS	CN2200003765	2025.10.30-2028.10.29
16	黄石广合	ISO/IEC27001：2022	SGS	CN23/00002780	2026.05.29-2029.05.28
17	黄石广合	ISO 50001：2018	兴原	0350124En20101R0M	2024.5.21-2027.5.20
18	东莞广合	ISO9001：2015	SGS	CN24/00006018	2025.05.19-2027.09.22
19	东莞广合	IATF16949：2016	SGS	0606588	2026.06.11-2029.06.10
20	东莞广合	ISO 14001：2015	SGS	CN13/31654	2025.07.04-2028.07.03
21	东莞广合	ISO45001：2018	SGS	CN19/30599	2025.05.07-2028.05.06
22	东莞广合	IEQC QC080000：2017	SGS	IECQ-H SGSCN18.0067-02	2025.12.01-2027.12.03
23	东莞广合	ISO/IEC27001：2022	SGS	CN20/31515	2026.09.14-2029.09.13
24	泰国广合	IECQ 有害物质过程管理符合性认证	SGS	TH25/00000598	2025.07.23-2028.07.22
25	泰国广合	ISO 9001:2015	SGS	TH25/00000460	2025.05.26-2028.05.25
26	泰国广合	ISO 14001:2015	SGS	TH25/00000461	2025.05.26-2028.05.25
27	泰国广合	ISO 45001:2018	SGS	TH25/00000463	2025.05.26-2028.05.25

十三、安全生产和环境保护

（一）安全生产

发行人高度重视安全生产工作，建立了相关管理制度。报告期内，发行人未发生过重大安全事故或因安全生产事宜遭受当地主管部门处罚的情形。

（二）环境保护

发行人遵守国家和地方环境保护法律、法规的要求，报告期内未因发生违反环保法律、法规行为而受到环保部门的重大行政处罚的情况。

十四、公司上市以来重大资产重组情况

自 2024 年 4 月在深圳证券交易所主板上市以来，发行人未实施过《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

十五、公司境外经营情况

截至本募集说明书签署日，公司在中国香港、英国英属维尔京群岛、泰国及美国设有子公司，具体情况参见“第四节 发行人基本情况”之“二、公司组织结构及对外投资情况”之“（二）重要子公司基本情况”。

十六、报告期内的分红情况

（一）公司利润分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定，为进一步加强公司现金分红与全面风险管理工作，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。发行人现行利润分配政策如下：

“第一百六十二条 公司实施积极的利润分配政策，具体如下：

（一）利润的分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

（二）利润分配方式

公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式，董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。

（三）利润分配间隔

原则上每个会计年度进行一次利润分配，必要时也可实行中期现金分红或发放股票股利。

（四）利润分配条件

1、现金分红条件

在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）公司当年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司当年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司预计未来 12 个月内不存在重大资本性支出项目（募集资金投资项目除外）累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产 30%情形的；

（4）进行现金分红不影响公司正常经营和可持续发展。

2、发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

（五）现金分红比例

在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（六）利润分配的执行

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或者公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。若因应法律法规和公司股票上市地证券监管规则的规定无法在 2 个月内实施具

体方案的，则具体方案实施日期可按照该等规定及实际情况相应调整。

第一百六十三条 利润分配的决策程序和机制

（一）利润分配预案的拟定

董事会根据公司经营情况拟定利润分配预案时，应充分听取独立董事、中小股东及审计委员会的意见。公司股东会对现金分红具体方案进行审议前应该通过电话、互联网等方式主动与股东特别是机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复股东提出的相关问题。

（二）决策程序

1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取审计委员会的意见；独立董事应发表明确意见。

2、利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会审议通过。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

（三）利润分配的监督

审计委员会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明确意见，并督促其及时改正：

1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；

2、未严格履行现金分红相应决策程序；

3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。

第一百六十四条 利润分配政策的调整机制

（一）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反公司股票上市地证券监管机构和证券交易所的有关规定。

（二）有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经审计委员会和 1/2 以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。

（三）调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东会审议，在董事会审议通过后提交股东会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东会提供便利。股东会审议调整利润分配政策的议案需经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。公司独立董事可在股东会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。”

（二）公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况

1、最近三年现金分红情况

最近三年，公司利润分配情况如下：

单位：万元

分红所属年度	分红类型	分红实施年度	利润分配方案/现金回购情况	分红金额（含税）
2023	年度利润分配	2024	每 10 股派现金人民币 2.50 元（含税），以方案实施前的公司总股本的 422,300,000 股为基数，合计派发现金红利人民币 10,557.50 万元	10,557.50
2024	年度利润分配	2025	每 10 股派现金人民币 4.80 元（含税），以利润分配预案披露之日的公司总股本扣除拟回购注销股权激励计划部分限制性股票 30,000 股后的股本 425,235,000 股为基数，合计派发现金红利人民币 20,411.28 万元	20,411.28
2025	年度利润分配	2026	每 10 股派现金人民币 6.46 元（含税），以公司 2025 年度利润分配方案实施时股权登记日的股本总数为基数，公司 2025 年度实际现金分红总额为人民币 30,520.05 万元。其中，A 股总股本 426,709,164 股，实际每 10 股派发人民币 6.456411 元（含税），实际现金分红金额为人民币 27,550.10 万元；H 股总股本 46,000,000 股，H 股股息以港币支付，实际每 10 股派发港币 7.4266804 元（含税），折合人民币约 2,969.95 万元。	30,520.05

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 61,488.83 万元，占最近三年实现的合并报表归属于母公司所有者的年均净利润 70,219.17 万元的比例为 87.57%，具体分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
现金分红金额（含税）	30,520.05	20,411.28	10,557.50
归属母公司所有者的净利润	101,578.90	67,610.04	41,468.57
累计未分配利润（母公司）	202,578.34	136,676.47	83,951.99
现金分红/归属母公司所有者的净利润	30.05%	30.19%	25.46%
现金分红/累计未分配利润	15.07%	14.93%	12.58%
最近三年累计现金分红金额			61,488.83
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			70,219.17
最近三年累计现金分红金额/最近三年年均归属于母公司所有者的净利润			87.57%

公司最近三年每年以现金方式分配的利润占最近三年累计未分配利润的 12.58%、14.93%及 15.07%；最近三年以现金方式累计分配的利润共计 61,488.83 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 70,219.17 万元的 87.57%，公司的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。

2、最近三年未分配利润使用情况

为保持公司的可持续发展，公司最近三年实现的归属于上市公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后，当年剩余的未分配利润结转至下一年度，作为公司业务发展资金的一部分，主要用于日常经营、对外投资、项目开拓等方面，以支持公司长期可持续发展，提高公司的市场竞争力和盈利能力。公司未分配利润的使用安排符合公司的实际情况和公司全体股东利益。

（三）公司未来股东回报规划

为健全和完善董事会、股东会对广州广合科技股份有限公司利润分配事项的决策程序和机制，进一步明确和完善公司的利润分配政策，增加股东分配决策透明度和可操作性。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件和《广州广合科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：

1、制定本规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续的发展，以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，

并给予投资者稳定回报。综合考虑公司经营发展现状、发展目标、股东意愿、当前及未来盈利模式、现金流量状况、外部融资成本和融资环境等因素，结合公司所处行业的特点、发展趋势等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2、本规划的制定原则

本规划的制定应符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等所规定的利润分配政策。公司在利润分配政策的研究论证和决策过程中，应充分考虑独立董事和公众投资者的意见。公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展需要和全体股东的整体利益。公司未来具备现金分红条件时，优先采用现金分红的方式进行利润分配。

3、未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划具体内容

（1）利润分配的原则

公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及远期战略发展目标，保持政策的连续性、合理性和稳定性。公司董事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董事和股东特别是中小股东的意见。

（2）利润分配的形式和间隔

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每个会计年度进行一次现金分红，公司可以根据公司的盈利状况及资金需求进行中期现金分红。

（3）利润分配的决策、变更机制和程序

公司在制定现金分红方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。在审议公司利润分配预案的董事会会议上，需经全体董事过半数表决同意方能提交公司股东会审议。

独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过电话、电子邮件等方式与股东特别是

中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

公司利润分配方案应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司在召开审议分红的股东会上应为股东提供网络投票方式。

公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案的，应当在年度报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事有权对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应当经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

公司应当严格执行章程确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境或自身经营状况发生较大变化，确有必要对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足章程规定的条件，且调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。调整利润分配政策的议案需提交董事会、股东会审议。有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并应在董事会审议通过后提交股东会批准。股东会审议修改利润分配政策的议案时，须经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。董事会在对利润分配政策或具体方案进行调整或者变更时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（4）利润分配的具体条件和比例

1）现金分红

在符合现金分红的条件下，公司当年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

④公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2）股票股利

公司在经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，同时在遵守上述现金分红的规定的前提下，可以提出股票股利分配预案。

（5）未分配利润的使用原则

公司利润分配后所剩余的未分配利润，应当主要用于公司业务经营。

4、公司利润分配的决策程序和机制

（1）公司董事会每三年重新审阅一次本规划，并根据形势或政策变化进行及时、合理的修订，确保其内容不违反相关法律法规和《公司章程》确定的利润分配政策。如因外部经营环境或自身经营状态发生重大变化而需要对本规划进行调整的，新的股东回报规划应符合相关法律法规。

（2）在充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和独立董事的意见的基础上，由董事会制定《未来三年股东回报规划》，并经独立董事专门会议审议通过后提交股东会审议。

十七、公司最近三年发行的债券情况和其他债务情况

（一）最近三年公司债券发行情况

最近三年，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。

（二）最近三年的债务偿付情况

最近三年，公司不存在债务违约或者延迟支付本息的情形。

（三）公司最近三年平均可分配利润支付公司债券利息的能力测算

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 41,468.57 万元、67,610.04 万元和 101,578.90 万元，最近三年平均可分配利润为 70,219.17 万元。本次向不特定对象发行可转债按募集资金 360,000.00 万元计算，参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

（四）本次发行规模对公司资产负债结构的影响

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 360,000.00 万元（含 360,000.00 万元）。本次发行完成后，公司累计债券余额不超过 360,000.00 万元，占截至 2026 年 6 月末公司合并口径净资产 792,882.19 万元的比例不超过 50%，符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见-证券期货法律适用意见第 18 号》的相关要求。

本次发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，资金实力将得到强化，整体财务状况得到进一步改善。本次发行有利于增强公司抵御财务风险的能力，优化资产结构，降低公司的财务风险。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计信息，非经特别说明，均引自公司 2023 年度、2024 年度和 2025 年度经审计的财务报告，及 2026 年 1-6 月经审阅的财务报告，财务指标以上述财务报表为基础编制。投资者欲对公司的财务状况、经营成果及会计政策进行更详细的了解，请阅读财务报告、审计报告及审阅报告全文。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度财务报表均业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了“容诚审字[2026]519Z0089 号”标准无保留意见的审计报告；公司 2026 年 1-6 月财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，并由其出具了“容诚阅字[2026]519Z0003 号”的审阅报告。

非经特别说明，本募集说明书均以 2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月合并财务报表口径数据为基础。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

二、最近三年及一期财务报表

（一）资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货币资金	264,232.70	51,978.94	72,128.07	43,126.79
交易性金融资产	-	19,046.83	29,106.98	-
衍生金融资产	1,320.21	304.45	-	-
应收票据	13,102.04	11,348.79	12,828.45	4,697.84
应收账款	283,372.52	193,662.93	116,467.01	83,967.87
应收款项融资	54.30	1,186.55	104.78	1,301.17
预付款项	1,929.21	1,296.20	303.87	137.56
其他应收款	2,928.65	552.95	1,212.89	1,282.76
存货	138,362.77	76,444.57	45,855.02	39,691.36
其他流动资产	15,946.51	13,560.17	6,860.74	6,064.77
流动资产合计	**721,248.91**	**369,382.37**	**284,867.81**	**180,270.12**
非流动资产：				
长期股权投资	2,020.31	1,180.35	-	-
固定资产	373,612.67	302,931.58	178,200.70	152,424.77
在建工程	84,467.31	25,459.50	73,957.32	25,509.03
使用权资产	250.34	291.33	39.24	982.40
无形资产	20,475.07	20,459.24	16,293.87	15,701.27
长期待摊费用	1,760.98	1,293.93	785.86	364.64
递延所得税资产	14,908.57	5,494.53	7,565.25	5,110.86
其他非流动资产	72,687.13	27,714.50	6,865.60	880.12
非流动资产合计	**570,182.38**	**384,824.96**	**283,707.84**	**200,973.09**
资产总计	**1,291,431.29**	**754,207.32**	**568,575.65**	**381,243.21**
流动负债：				
短期借款	25,237.09	26,796.21	10,012.18	7,871.22
衍生金融负债	479.60	-	808.78	142.23
应付票据	107,709.72	66,248.66	44,717.98	32,153.89
应付账款	258,520.19	171,750.02	119,942.26	90,015.21
合同负债	1,546.13	605.29	737.89	630.43
应付职工薪酬	11,621.23	12,350.91	10,754.32	8,556.24
应交税费	7,403.92	4,627.29	3,578.45	3,604.27
其他应付款	6,843.05	6,420.33	6,914.87	2,661.81
一年内到期的非流动负债	16,765.23	9,519.39	12,128.41	8,351.50

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
其他流动负债	2,026.44	2,979.98	8,697.07	1,533.26
流动负债合计	**438,152.61**	**301,298.07**	**218,292.20**	**155,520.05**
非流动负债：				
长期借款	39,330.46	31,800.07	19,167.80	22,204.48
租赁负债	193.07	231.44	-	43.32
长期应付款	218.77	225.32	226.83	879.54
递延收益	20,654.20	20,803.02	16,672.51	12,672.10
递延所得税负债	-	2,040.91	6,831.71	6,892.33
非流动负债合计	**60,396.49**	**55,100.76**	**42,898.86**	**42,691.76**
负债合计	**498,549.10**	**356,398.82**	**261,191.06**	**198,211.81**
所有者权益：				
股本	47,256.88	42,566.43	42,526.50	38,000.00
资本公积	436,851.36	140,973.22	132,242.70	64,586.30
减：库存股	3,990.14	4,257.94	5,298.46	-
其他综合收益	-1,469.87	-148.34	416.21	-
盈余公积	21,283.21	21,283.21	16,359.33	9,328.00
未分配利润	292,950.75	197,391.92	121,138.31	71,117.10
归属于母公司所有者权益合计	**792,882.19**	**397,808.50**	**307,384.59**	**183,031.40**
所有者权益合计	**792,882.19**	**397,808.50**	**307,384.59**	**183,031.40**
负债和所有者权益总计	**1,291,431.29**	**754,207.32**	**568,575.65**	**381,243.21**

（二）利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业总收入	**438,826.02**	**548,537.14**	**373,428.46**	**267,827.03**
其中：营业收入	438,826.02	548,537.14	373,428.46	267,827.03
二、营业总成本	**323,863.97**	**427,101.41**	**288,103.35**	**211,136.08**
其中：营业成本	266,486.39	359,667.53	248,782.52	178,642.80
税金及附加	1,889.93	2,519.07	2,407.84	2,078.81
销售费用	10,116.11	12,874.28	10,662.05	8,528.71
管理费用	10,493.08	21,156.09	13,194.52	9,566.22
研发费用	23,010.51	27,979.30	17,919.75	12,058.87

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
财务费用	11,867.96	2,905.14	-4,863.32	260.67
其中：利息费用	915.73	1,657.09	1,586.67	1,392.71
利息收入	1,224.63	2,031.93	1,735.32	447.30
加：其他收益	1,187.95	3,063.86	2,212.17	1,905.92
投资收益（损失以“-”号填列）	28.06	1,085.65	-122.23	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-60.04	-19.65	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,729.04	351.28	-1,073.45	-4,153.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,118.62	-4,325.78	-1,787.01	-1,149.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,140.81	-7,617.45	-7,927.21	-3,405.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	43.08	-139.96	-63.06	-58.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**107,690.75**	**113,853.33**	**76,564.32**	**49,829.51**
加：营业外收入	19.31	48.63	15.28	12.67
减：营业外支出	29.94	212.04	331.50	153.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**107,680.11**	**113,689.92**	**76,248.10**	**49,688.25**
减：所得税费用	12,121.29	12,111.01	8,638.06	8,219.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**95,558.82**	**101,578.90**	**67,610.04**	**41,468.57**
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	95,558.82	101,578.90	67,610.04	41,468.57
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	95,558.82	101,578.90	67,610.04	41,468.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**-1,321.52**	**-564.55**	**416.21**	-
七、综合收益总额	**94,237.30**	**101,014.35**	**68,026.25**	**41,468.57**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	94,237.30	101,014.35	68,026.25	41,468.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

（三）现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量				

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	335,158.49	468,863.02	355,899.07	247,244.75
收到的税费返还	28,437.77	23,293.96	18,476.90	11,654.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,283.07	9,871.99	8,074.62	3,123.53
经营活动现金流入小计	365,879.33	502,028.97	382,450.59	262,023.25
购买商品、接受劳务支付的现金	202,279.88	300,065.90	227,870.10	155,703.22
支付给职工以及为职工支付的现金	47,272.08	69,430.72	48,340.33	37,610.62
支付的各项税费	8,781.86	14,830.26	13,726.20	6,722.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,856.28	14,545.02	12,885.50	9,235.30
经营活动现金流出小计	272,190.09	398,871.91	302,822.12	209,271.93
经营活动产生的现金流量净额	**93,689.24**	**103,157.06**	**79,628.46**	**52,751.32**
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	46,000.00	111,380.00	102,600.00	-
取得投资收益收到的现金	1,600.09	1,071.00	750.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728.07	525.37	13.70	170.90
收到其他与投资活动有关的现金	-	29.98	-	-
投资活动现金流入小计	48,328.16	113,006.35	103,364.10	170.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,552.18	130,943.13	82,751.09	40,406.65
投资支付的现金	27,900.00	102,580.00	131,600.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,793.16	667.48	1,386.51	2,250.60
投资活动现金流出小计	215,245.34	234,190.61	215,737.60	42,657.25
投资活动产生的现金流量净额	**-166,917.18**	**-121,184.26**	**-112,373.50**	**-42,486.35**
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	284,827.87	1,104.27	73,323.96	-
取得借款收到的现金	32,917.15	39,555.85	22,080.09	32,036.94
收到其他与筹资活动有关的现金	-	572.96	498.84	23,447.21
筹资活动现金流入小计	317,745.02	41,233.07	95,902.89	55,484.15
偿还债务支付的现金	32,017.92	22,505.13	16,603.77	24,682.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855.71	22,094.09	11,952.38	1,429.98
支付其他与筹资活动有关的现金	45.78	3,556.15	6,439.79	25,058.55
筹资活动现金流出小计	32,919.41	48,155.37	34,995.93	51,170.95
筹资活动产生的现金流量净额	**284,825.61**	**-6,922.30**	**60,906.95**	**4,313.20**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**-1,391.19**	**2,479.18**	**424.84**	**337.48**

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
五、现金及现金等价物净增加额	**210,206.48**	**-22,470.31**	**28,586.76**	**14,915.65**
加：期初现金及现金等价物余额	41,036.79	63,507.11	34,920.35	20,004.70
六、期末现金及现金等价物余额	**251,243.28**	**41,036.79**	**63,507.11**	**34,920.35**

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）合并报表范围及其变化情况

1、报告期末合并报表范围

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	取得方式
1	黄石广合精密电路有限公司	投资设立
2	DELTON TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED	投资设立
3	东莞广合数控科技有限公司	投资设立
4	Delton Investment Holdings Limited	投资设立
5	Delton Technology (Thailand) Co., Ltd	投资设立
6	Delton Technology Inc.	投资设立

2、合并财务报告范围变化情况

报告期内，公司合并财务报表范围变化情况如下：

子公司名称	变动情况	取得方式	变化期间
Delton Technology Inc.	新增	投资设立	2025 年度
Delton Investment Holdings Limited	新增	投资设立	2023 年度
Delton Technology (Thailand) Co., Ltd	新增	投资设立	

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

指标	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.65	1.23	1.30	1.16
速动比率（倍）	1.33	0.97	1.09	0.90
资产负债率（母公司）	32.90%	37.99%	33.96%	40.78%
资产负债率（合并）	38.60%	47.25%	45.94%	51.99%
应收账款周转率（次/年）	3.50	3.36	3.54	3.53
存货周转率（次/年）	4.61	5.20	5.01	4.05
每股经营活动现金流量（元/股）	1.98	2.42	1.87	1.39
每股净现金流量（元/股）	4.45	-0.53	0.67	0.39

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）

3、资产负债率=总负债/总资产

4、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款余额+期末应收账款余额）/2]，2026 年 1-6 月数据经年化

5、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，2026 年 1-6 月数据经年化

6、每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

7、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末总股本

（二）净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的要求，公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：

项目	期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2026 年 1-6 月	16.05	2.14	2.13
	2025 年	29.24	2.40	2.39
	2024 年	25.87	1.66	1.65
	2023 年	25.60	1.09	1.09

项目	期间	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	2026 年 1-6 月	15.78	2.10	2.10
	2025 年	28.44	2.34	2.32
	2024 年	25.95	1.66	1.66
	2023 年	26.88	1.15	1.15

注：上述指标的计算公式如下：

①基本每股收益=P0/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0-Sk）

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

②稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk+认股权证、股份期权、可转换公司债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

③加权平均净资产收益率=P0/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（三）非经常性损益明细表

发行人报告期内非经常性损益情况参见本节之“七、经营成果分析”之“（六）非经常性损益分析”。

五、会计政策、会计估计及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

1、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起施行该解释，并根据准则解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的 2023 年年初财务报表项目进行了

调整。主要影响如下：

单位：万元

报表	受重要影响的报表项目名称	影响金额
合并资产负债表	递延所得税资产	154.29
合并资产负债表	递延所得税负债	147.36
合并资产负债表	盈余公积	0.69
合并资产负债表	未分配利润	6.24
合并利润表	所得税费用	-6.93
合并利润表	净利润	6.93

2、执行《企业会计准则解释第 17 号》

2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会[2023]21 号，以下简称解释 17 号），自 2024 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

3、保证类质保费用重分类

财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入营业成本，执行该规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

4、执行《企业会计准则解释第 19 号》

2025 年 12 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 19 号》（财会[2025]32 号，以下简称解释 19 号），自 2026 年 1 月 1 日起施行。执行解释 19 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

5、执行《企业会计准则解释第 20 号》

2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 20 号》（财会[2026]7 号，以下简称解释 20 号），自公布之日起施行。执行解释 20 号的相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内，公司无重要会计估计变更。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大的会计差错更正事项。

六、财务状况分析

（一）资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下表所示：

单位：万元

项　目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	264,232.70	20.46%	51,978.94	6.89%	72,128.07	12.69%	43,126.79	11.31%
交易性金融资产	-	-	19,046.83	2.53%	29,106.98	5.12%	-	-
衍生金融资产	1,320.21	0.10%	304.45	0.04%	-	-	-	-
应收票据	13,102.04	1.01%	11,348.79	1.50%	12,828.45	2.26%	4,697.84	1.23%
应收账款	283,372.52	21.94%	193,662.93	25.68%	116,467.01	20.48%	83,967.87	22.02%
应收款项融资	54.30	0.00%	1,186.55	0.16%	104.78	0.02%	1,301.17	0.34%
预付款项	1,929.21	0.15%	1,296.20	0.17%	303.87	0.05%	137.56	0.04%
其他应收款	2,928.65	0.23%	552.95	0.07%	1,212.89	0.21%	1,282.76	0.34%
存货	138,362.77	10.71%	76,444.57	10.14%	45,855.02	8.06%	39,691.36	10.41%
其他流动资产	15,946.51	1.23%	13,560.17	1.80%	6,860.74	1.21%	6,064.77	1.59%
流动资产合计	**721,248.91**	**55.85%**	**369,382.37**	**48.98%**	**284,867.81**	**50.10%**	**180,270.12**	**47.28%**
非流动资产：								
长期股权投资	2,020.31	0.16%	1,180.35	0.16%	-	-	-	-
固定资产	373,612.67	28.93%	302,931.58	40.17%	178,200.70	31.34%	152,424.77	39.98%
在建工程	84,467.31	6.54%	25,459.50	3.38%	73,957.32	13.01%	25,509.03	6.69%
使用权资产	250.34	0.02%	291.33	0.04%	39.24	0.01%	982.40	0.26%
无形资产	20,475.07	1.59%	20,459.24	2.71%	16,293.87	2.87%	15,701.27	4.12%
长期待摊费用	1,760.98	0.14%	1,293.93	0.17%	785.86	0.14%	364.64	0.10%
递延所得税资产	14,908.57	1.15%	5,494.53	0.73%	7,565.25	1.33%	5,110.86	1.34%
其他非流动资产	72,687.13	5.63%	27,714.50	3.67%	6,865.60	1.21%	880.12	0.23%

项　目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
非流动资产合计	570,182.38	44.15%	384,824.96	51.02%	283,707.84	49.90%	200,973.09	52.72%
资产总计	1,291,431.29	100.00%	754,207.32	100.00%	568,575.65	100.00%	381,243.21	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为 381,243.21 万元、568,575.65 万元、754,207.32 万元及 1,291,431.29 万元，整体呈现上升趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 180,270.12 万元、284,867.81 万元、369,382.37 万元及 721,248.91 万元，占资产总额的比例分别为 47.28%、50.10%、48.98%及 55.85%。公司流动资产以应收账款、存货和货币资金为主。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 200,973.09 万元、283,707.84 万元、384,824.96 万元及 570,182.38 万元，占资产总额的比例分别为 52.72%、49.90%、51.02%及 44.15%。公司非流动资产以固定资产、在建工程和其他非流动资产为主。

1、主要流动资产分析

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
库存现金	17.74	0.01%	18.98	0.04%	0.10	0.00%	0.34	0.00%
银行存款	251,225.54	95.08%	41,017.81	78.91%	63,534.94	88.09%	34,947.86	81.04%
其他货币资金	12,989.43	4.92%	10,942.14	21.05%	8,593.04	11.91%	8,178.60	18.96%
合计	264,232.70	100.00%	51,978.94	100.00%	72,128.07	100.00%	43,126.79	100.00%

报告期各期末，公司货币资金分别为 43,126.79 万元、72,128.07 万元、51,978.94 万元及 264,232.70 万元，占流动资产的比例分别为 23.92%、25.32%、14.07%及 36.64%，主要是银行存款。

2024 年末货币资金较 2023 年末增加 67.25%，主要系公司完成首发并上市收到了募集资金、以及本期经营业绩较好形成经营现金净流入金额较大所致。2025 年末，货币资金减少主要系募集资金支出较多所致。2026 年 6 月末，公司货币资金较 2025 年末显著上升，主要系公司完成 H 股全球发售并收到募集资金。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产分别为 0.00 万元、29,106.98 万元、19,046.83 万元及 0.00 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、10.22%、5.16%及 0.00%。2024 年末余额较高，主要系公司收到募集资金后使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款所致；此后随着募集资金逐步使用，余额逐步减少。

（3）应收票据

报告期各期末，公司应收票据构成情况如下：

单位：万元

种类	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	2,272.77	3,003.28	10,576.46	3,719.20
商业承兑汇票	11,399.23	8,784.75	2,370.52	1,030.14
小计	**13,672.00**	**11,788.03**	**12,946.98**	**4,749.34**
减：坏账准备	569.96	439.24	118.53	51.51
合计	**13,102.04**	**11,348.79**	**12,828.45**	**4,697.84**

报告期各期末，公司应收票据金额分别为 4,697.84 万元、12,828.45 万元、11,348.79 万元和 13,102.04 万元，主要包括银行承兑票据、商业承兑票据，报告期各期末规模较小。报告期各期末，公司应收商业承兑汇票金额逐步增加，主要原因系使用商业承兑汇票的客户金额增加所致。

（4）应收账款

1）应收账款变动分析

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款余额	298,286.86	203,854.53	122,605.22	88,387.92
减：坏账准备	14,914.34	10,191.61	6,138.21	4,420.05
应收账款账面价值	283,372.52	193,662.93	116,467.01	83,967.87

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 83,967.87 万元、116,467.01 万元、193,662.93 万元和 283,372.52 万元，占流动资产的比例分别为 46.58%、40.88%、52.43%和 39.29%，计提的坏账准备金额分别为 4,420.05 万元、6,138.21 万元、10,191.61 万元

和 14,914.34 万元。

报告期内，随着公司经营规模的增长，应收账款账面余额相应增加。

2）应收账款账龄分析

报告期各期末，公司应收账款的账龄情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	298,286.86	203,854.53	122,552.22	88,384.92
1 至 2 年	-	-	53.01	3.00
合计	**298,286.86**	**203,854.53**	**122,605.22**	**88,387.92**

报告期各期末，公司应收账款账龄集中在 1 年以内，1 年以内占比分别为 99.99%、99.96%、100.00%和 100.00%，应收账款总体质量良好，期后回款情况良好。

3）应收账款计提坏账准备分析

报告期各期末，公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款，不同账龄坏账准备计提情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
1 年以内	14,914.34	10,191.61	6,127.61	4,419.25
1 至 2 年	-	-	10.60	0.80
合计	**14,914.34**	**10,191.61**	**6,138.21**	**4,420.05**

报告期内，公司所采用的坏账计提政策与其客户结构、业务模式、实际经营情况相符，能够合理覆盖应收账款的坏账风险，公司应收账款坏账准备计提充分。

4）报告期各期末按欠款方归集的前五名的应收账款情况

报告期内，期末按欠款方归集的前五名的应收账款期末余额合计分别为 41,503.25 万元、53,942.05 万元、100,383.26 万元和 163,518.92 万元，占当期应收账款期末余额合计数的比例为 46.96%、44.00%、49.25%和 54.82%。公司主要应收账款方与主要客户相匹配。报告期内，公司主要客户信用期无重大变化，符合行业惯例，不存在放宽信用政策突击确认收入的情形。

单位：万元

2026 年 6 月 30 日			
单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备期末金额
客户 A	68,578.08	22.99	3,428.90
客户 B	28,385.21	9.52	1,419.26
客户 C	24,163.01	8.10	1,208.15
客户 D	21,708.62	7.28	1,085.43
客户 E	20,684.01	6.93	1,034.20
合计	**163,518.92**	**54.82**	**8,175.95**
2025 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备期末金额
客户 A	43,718.49	21.45	2,185.92
客户 E	17,362.30	8.52	868.12
客户 B	16,989.16	8.33	849.46
客户 C	13,142.45	6.45	657.12
客户 D	9,170.85	4.50	458.54
合计	**100,383.26**	**49.25**	**5,019.16**
2024 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备期末金额
客户 A	25,815.99	21.06	1,290.80
客户 D	8,366.88	6.82	418.34
客户 C	7,364.53	6.01	368.23
客户 F	6,297.09	5.14	314.85
客户 E	6,097.55	4.97	304.88
合计	**53,942.05**	**44.00**	**2,697.10**
2023 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	应收账款坏账准备期末金额
客户 A	17,019.51	19.26	850.98
客户 D	8,762.74	9.91	438.14
客户 B	5,942.39	6.72	297.12
客户 F	5,474.86	6.19	273.74
客户 G	4,303.75	4.88	215.19
合计	**41,503.25**	**46.96**	**2,075.16**

（5）应收款项融资

报告期各期末，公司应收款项融资金额分别为 1,301.17 万元、104.78 万元、1,186.55 万元和 54.30 万元，占流动资产的比例分别为 0.72%、0.04%、0.32%和 0.01%，整体金额及占比较低。

（6）预付款项

报告期各期末，公司预付款项分别为 137.56 万元、303.87 万元、1,296.20 万元和 1,929.21 万元，占流动资产比例分别为 0.08%、0.11%、0.35%和 0.27%。

报告期内，公司预付账款的账龄构成情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	1,890.18	97.98%	1,243.21	95.91%	303.87	100.00%	137.56	100.00%
1 至 2 年	9.53	0.49%	52.99	4.09%	-	-	-	-
2 至 3 年	29.50	1.53%	-	-	-	-	-	-
合计	**1,929.21**	**100.00%**	**1,296.20**	**100.00%**	**303.87**	**100.00%**	**137.56**	**100.00%**

从预付款项的账龄来看，报告期内公司预付账款账龄主要为 1 年以内。截至 2026 年 6 月末，公司 1 年以内的预付账款余额为 1,890.18 万元，占比为 97.98%。预付款项中不存在已发生成本费用但未及时结转的情况。

（7）存货

1）存货构成情况分析

报告期各期末，公司存货构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	43,353.99	29.56%	19,830.54	23.39%	7,415.76	13.85%	4,743.92	10.37%
在产品	46,854.01	31.95%	26,111.95	30.79%	13,465.32	25.15%	8,024.20	17.55%
库存商品	36,520.71	24.90%	21,233.34	25.04%	20,689.35	38.64%	19,397.18	42.42%
发出商品	19,844.54	13.53%	17,529.04	20.67%	11,891.37	22.21%	13,462.33	29.44%
合同履约	84.56	0.06%	94.47	0.11%	84.56	0.16%	102.42	0.22%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
成本								
账面余额合计	**146,657.81**	**100.00%**	**84,799.33**	**100.00%**	**53,546.37**	**100.00%**	**45,730.06**	**100.00%**
存货跌价准备	8,295.04	-	8,354.76	-	7,691.35	-	6,038.70	-
账面价值	**138,362.77**	**-**	**76,444.57**	**-**	**45,855.02**	**-**	**39,691.36**	**-**

公司存货由原材料、在产品、库存商品、发出商品和合同履约成本构成。其中，原材料、在产品、库存商品和发出商品为存货的主要构成部分，报告期各期末合计余额 45,627.64 万元、53,461.81 万元、84,704.86 万元和 146,573.25 万元，合计余额占存货账面余额的比重分别为 99.78%、99.84%、99.89%和 99.94%。

报告期各期末，公司存货库龄主要在一年以内，不存在大量的残次冷备品或滞销的情况。

报告期各期末，公司存货余额逐年增加，主要是由于公司营业收入规模增加，对应生产规模扩大，国内生产工厂库存增加以及泰国筹建期于 2025 年结束，开始量产后存货增加所致。

① 原材料

报告期各期末公司原材料账面余额分别为 4,743.92 万元、7,415.76 万元、19,830.54 万元和 43,353.99 万元，报告期内公司原材料呈上升趋势，主要系市场需求增强，公司采购增加，叠加原材料价格上升因素影响所致。

② 在产品

公司在产品主要为处于生产过程中的 PCB 产品。报告期各期末公司在产品账面余额分别为 8,024.20 万元、13,465.32 万元、26,111.95 万元和 46,854.01 万元，金额及占比不断升高，主要系随着期内收入增长、订单量增加，公司相应扩大生产规模所致。

③ 库存商品

报告期各期末，公司库存商品账面余额分别为 19,397.18 万元、20,689.35 万元、21,233.34 万元和 36,520.71 万元。报告期内公司库存商品呈上升趋势，主要系市场规模扩大，及随着 2025 年泰国工厂由筹备阶段过渡至量产阶段，国内生产设施与泰国工厂

的库存商品均有所增加所致。

④ 发出商品

报告期各期末，公司发出商品账面余额分别为 13,462.33 万元、11,891.37 万元、17,529.04 万元和 19,844.54 万元，整体呈上升趋势，与公司收入规模增长趋势保持一致。

⑤ 合同履约成本

报告期各期末，公司合同履约成本账面余额分别为 102.42 万元、84.56 万元、94.47 万元和 84.56 万元。报告期内公司合同履约成本占比较小。

2）存货跌价准备分析

报告期各期末，公司存货跌价准备情况如下：

单位：万元

2026 年 6 月 30 日				
项目	**账面余额**	**存货跌价准备**	**账面价值**	**账面价值占比**
原材料	43,353.99	1,317.27	42,036.72	30.38%
在产品	46,854.01	1,258.72	45,595.30	32.95%
库存商品	36,520.71	4,473.99	32,046.72	23.16%
发出商品	19,844.54	1,245.07	18,599.48	13.44%
合同履约成本	84.56	-	84.56	0.06%
合计	**146,657.81**	**8,295.04**	**138,362.77**	**100.00%**
2025 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**存货跌价准备**	**账面价值**	**账面价值占比**
原材料	19,830.54	773.43	19,057.11	24.93%
在产品	26,111.95	1,137.08	24,974.87	32.67%
库存商品	21,233.34	4,632.62	16,600.71	21.72%
发出商品	17,529.04	1,811.63	15,717.41	20.56%
合同履约成本	94.47	-	94.47	0.12%
合计	**84,799.33**	**8,354.76**	**76,444.57**	**100.00%**
2024 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**存货跌价准备**	**账面价值**	**账面价值占比**
原材料	7,415.76	308.39	7,107.38	15.50%
在产品	13,465.32	1,815.39	11,649.94	25.41%
库存商品	20,689.35	5,021.36	15,667.99	34.17%

发出商品	11,891.37	546.21	11,345.16	24.74%
合同履约成本	84.56	-	84.56	0.18%
合计	**53,546.37**	**7,691.35**	**45,855.02**	**100.00%**
2023 年 12 月 31 日				
项目	**账面余额**	**存货跌价准备**	**账面价值**	**账面价值占比**
原材料	4,743.92	323.16	4,420.76	11.14%
在产品	8,024.20	598.24	7,425.96	18.71%
库存商品	19,397.18	3,323.97	16,073.21	40.50%
发出商品	13,462.33	1,793.32	11,669.01	29.40%
合同履约成本	102.42	-	102.42	0.26%
合计	**45,730.06**	**6,038.70**	**39,691.36**	**100.00%**

报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 6,038.70 万元、7,691.35 万元、8,354.76 万元和 8,295.04 万元。报告期内存货跌价准备计提比例为 13.21%、14.36%、9.85%和 5.66%，整体呈现先上升后下降趋势，2024 年存货跌价准备计提比例上升，主要原因系黄石基地产能持续爬坡，部分在产品、半成品单位生产成本偏高；2025 年及 2026 年上半年存货跌价准备计提比例下降，主要原因系下游算力服务器需求爆发，订单覆盖率高所致。整体来看，公司存货质量良好，减值准备计提充分，公司存货规模及结构变动与行业需求趋势、自身业务扩张节奏及经营策略高度契合，不存在异常情形，具备充分的商业合理性。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
增值税留抵税额	15,846.78	11,962.90	6,807.54	5,549.68
预缴所得税	99.73	-	53.20	-
预付发行费	-	1,597.27	-	515.09
合计	**15,946.51**	**13,560.17**	**6,860.74**	**6,064.77**

报告期各期末，公司其他流动资产金额分别为 6,064.77 万元、6,860.74 万元、13,560.17 万元和 15,946.51 万元，占流动资产的比例分别为 3.36%、2.41%、3.67%和 2.21%，主要包括增值税留抵税额。

2、主要非流动资产分析

（1）长期股权投资

报告期内，公司长期股权投资金额分别为 0.00 万元、0.00 万元、1,180.35 万元和 2,020.31 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.31%和 0.35%，长期股权投资为对联营企业九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）的投资。

（2）固定资产

报告期各期末，公司固定资产账面价值情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
固定资产	373,463.50	99.96%	302,887.93	99.99%	178,177.45	99.99%	152,424.77	100.00%
固定资产清理	149.18	0.04%	43.65	0.01%	23.25	0.01%	-	-
合计	**373,612.67**	**100.00%**	**302,931.58**	**100.00%**	**178,200.70**	**100.00%**	**152,424.77**	**100.00%**

报告期各期末，公司固定资产（不含固定资产清理）构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	188,372.29	38.88	150,227.10	37.51	88,681.99	34.49	74,022.92	34.07
机器设备	283,594.16	58.54	239,203.62	59.73	161,497.65	62.81	137,629.65	63.35
工具器具	5,770.31	1.19	4,918.29	1.23	3,123.90	1.21	2,685.65	1.24
办公设备及其他	6,706.36	1.38	6,119.85	1.53	3,812.49	1.48	2,917.76	1.34
账面原值	**484,443.12**	**100.00**	**400,468.86**	**100.00**	**257,116.03**	**100.00**	**217,255.99**	**100.00**
累计折旧	108,685.64	-	95,766.58	-	77,087.09	-	63,539.38	-
减值准备	2,293.98	-	1,814.35	-	1,851.49	-	1,291.84	-
账面价值	**373,463.50**	**-**	**302,887.93**	**-**	**178,177.45**	**-**	**152,424.77**	**-**

报告期各期末，公司固定资产（不含固定资产清理）分别为 152,424.77 万元、178,177.45 万元、302,887.93 万元和 373,463.50 万元，占非流动资产的比例分别为 75.84%、62.80%、78.71%和 65.50%。

公司固定资产主要是房屋及建筑物和机器设备，报告期各期末合计账面余额占固定资产的比例分别为 97.42%、97.30%、97.24%和 97.42%。报告期内，随着产能逐步扩大，

公司固定资产逐年增加。

公司采用年限平均法计提固定资产折旧，主要固定资产的折旧年限与同行业可比公司的比较情况如下：

资产类别	发行人	胜宏科技	沪电股份	深南电路	生益电子
房屋及建筑物	5-30 年	20-50 年	10 年、20-35 年	35 年	25 年
机器设备	5-12 年	3-20 年	6-12 年	10 年	12 年
运输设备	5-10 年	4-5 年	5 年	5 年	6 年
办公设备、工具器具及其他设备	办公设备 3-10 年；工具器具 5-10 年；其他设备 5 年	电子设备及其他 3-30 年	办公设备 5-6 年	电子设备 5 年；其他设备 3 年、5 年	其他设备 6 年

注 1：同行业可比公司数据来源于其 2025 年年度报告或审计报告。
注 2：因各公司固定资产分类口径存在差异，上表按照性质相近的资产类别进行比较。沪电股份房屋及建筑物包括折旧年限为 20-35 年的房屋及建筑物和折旧年限为 10 年的公共设施。

由上表可知，公司各类固定资产的折旧年限在同行业可比上市公司固定资产折旧年限区间范围内。

报告期各期末，公司的固定资产减值准备余额为 1,291.84 万元、1,851.49 万元、1,814.35 万元和 2,293.98 万元，公司对于部分技术落后、闲置的固定资产计提减值准备。公司针对存在减值迹象的资产，已充分计提了减值准备。

（3）在建工程

报告期各期末，公司在建工程构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
在建工程	84,467.31	100.00%	25,459.50	100.00%	73,957.25	100.00%	25,509.03	100.00%
工程物资	-	-	-	-	0.08	0.00%	-	-
合计	**84,467.31**	**100.00%**	**25,459.50**	**100.00%**	**73,957.32**	**100.00%**	**25,509.03**	**100.00%**

报告期各期末，公司在建工程（不含工程物资）构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
工程	37,973.37	44.96	8,113.79	31.87	51,009.44	68.97	20,848.08	81.73
设备	46,493.95	55.04	17,345.72	68.13	22,947.81	31.03	4,660.95	18.27

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
账面余额	**84,467.31**	**100.00**	**25,459.50**	**100.00**	**73,957.25**	**100.00**	**25,509.03**	**100.00**
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值	**84,467.31**	**-**	**25,459.50**	**-**	**73,957.25**	**-**	**25,509.03**	**-**

报告期各期末，公司在建工程（不含工程物资）分别为 25,509.03 万元、73,957.25 万元、25,459.50 万元和 84,467.31 万元，占非流动资产的比例分别为 12.69%、26.07%、6.62%和 14.81%。

2024 年末，在建工程较期初增加了 189.93%，系由于公司的泰国工厂处于在建设期，泰国工厂投资规模较大，使得在建工程期末余额大幅度增加；2025 年末，在建工程较期初减少了 65.58%，主要是由于公司 2025 年度泰国工厂相关设备及工程结转固定资产所致。2026 年 6 月末在建工程较期初增加了 231.77%，主要是由于公司本期泰国工程及广州云擎厂房等项目建设所致。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司重要在建工程构成如下：

单位：万元

项目名称	预算数	2025 年 12 月 31 日	本期增加金额	本期转入固定资产金额	汇率变动	2026 年 6 月 30 日
东莞智能自动化数控加工厂及电子制造服务工程	45,321.57	2,031.24	6,409.94	7,814.82	-	626.37
泰国工程	163,750.00	963.46	34,283.92	14,222.18	-206.21	20,818.99
云擎智造基地项目	255,868.00	5,376.40	20,052.46	-	-	25,428.86
广州及黄石厂区产线需要安装调试的设备	56,791.61	14,698.92	42,092.69	26,197.84	-	30,593.77
泰国生活区工程	10,000.00	1,422.93	15.08	16.67	-59.50	1,361.83
摩天工坊宿舍工程	30,469.67	-	30,469.67	30,469.67	-	-
合计	**562,200.85**	**24,492.95**	**133,323.75**	**78,721.18**	**-265.71**	**78,829.82**

（4）无形资产

报告期各期末，公司无形资产账面净值分别为 15,701.27 万元、16,293.87 万元、20,459.24 万元和 20,475.07 万元，占非流动资产的比例分别为 7.81%、5.74%、5.32%和 3.59%。

报告期内公司无形资产的构成情况如下：

单位：万元；%

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	期末余额	比例	期末余额	比例	期末余额	比例	期末余额	比例
土地使用权	19,880.47	71.39	19,880.47	73.99	15,678.33	74.98	14,768.24	77.62
软件	7,969.02	28.61	6,987.87	26.01	5,231.40	25.02	4,257.51	22.38
小计	**27,849.50**	**100.00**	**26,868.34**	**100.00**	**20,909.74**	**100.00**	**19,025.75**	**100.00**
累计摊销	7,374.43	-	6,409.10	-	4,615.87	-	3,324.48	-
减值准备	-	-	-	-	-	-	-	-
账面价值	**20,475.07**	**-**	**20,459.24**	**-**	**16,293.87**	**-**	**15,701.27**	**-**

报告期各期末，公司无形资产主要为土地使用权和软件。报告期内公司无形资产占非流动资产比重下降。

资产类别	发行人	胜宏科技	沪电股份	深南电路	生益电子
土地使用权	40-50 年	50-99 年	40-50 年	30 年、50 年	50 年
泰国土地使用权	使用寿命不确定，不予摊销	-	-	使用寿命不确定，不予摊销	-
软件	3-5 年	3-10 年	按预计使用年限摊销	10 年	6 年

注：同行业可比公司数据来源于其 2025 年年度报告或审计报告。

公司境内土地使用权按照土地使用权证载明的受益期限在 40-50 年内摊销，摊销年限处于同行业可比公司范围内。根据泰国当地法律，公司持有的泰国土地使用权可以无期限拥有，因无法合理预计其为公司带来经济利益的期限，将其作为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销，与同行业公司的会计处理一致。公司软件按照预计受益期限在 3-5 年内摊销，处于同行业可比公司软件摊销年限范围内。因此，公司无形资产摊销政策与同行业可比公司不存在重大差异，摊销年限具有合理性。

公司于资产负债表日检查无形资产是否存在减值迹象，并对使用寿命不确定的泰国土地使用权每年进行减值测试。报告期各期末，公司土地使用权及软件使用状况良好，相关减值测试结果未表明无形资产的可收回金额低于账面价值，不存在需要计提减值准备的情形。

报告期各期末，公司主要无形资产状况良好，不存在减值迹象。

（5）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
预付投资款	8,520.88	11.72%	-	-	-	-	-	-
预付设备工程款	64,166.26	88.28%	17,675.38	63.78%	6,865.60	100.00%	880.12	100.00%
预付房款	-	-	10,039.12	36.22%	-	-	-	-
合计	**72,687.13**	**100.00%**	**27,714.50**	**100.00%**	**6,865.60**	**100.00%**	**880.12**	**100.00%**

报告期各期末，公司其他非流动资产分别为 880.12 万元、6,865.60 万元、27,714.50 万元和 72,687.13 万元，占非流动资产的比例分别为 0.44%、2.42%、7.20%和 12.75%，2026 年 6 月 30 日，其他非流动资产较期初增加了 162.27%，增加内容主要为预付投资、预付设备工程款。预付设备工程款的增加主要是由于公司云擎智造基地项目处于建设期、投资规模较大，已支付款项但暂未交付的设备余额较大。

（二）负债结构分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项　目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	25,237.09	5.06%	26,796.21	7.52%	10,012.18	3.83%	7,871.22	3.97%
衍生金融负债	479.60	0.10%	-	-	808.78	0.31%	142.23	0.07%
应付票据	107,709.72	21.60%	66,248.66	18.59%	44,717.98	17.12%	32,153.89	16.22%
应付账款	258,520.19	51.85%	171,750.02	48.19%	119,942.26	45.92%	90,015.21	45.41%
合同负债	1,546.13	0.31%	605.29	0.17%	737.89	0.28%	630.43	0.32%
应付职工薪酬	11,621.23	2.33%	12,350.91	3.47%	10,754.32	4.12%	8,556.24	4.32%
应交税费	7,403.92	1.49%	4,627.29	1.30%	3,578.45	1.37%	3,604.27	1.82%
其他应付款	6,843.05	1.37%	6,420.33	1.80%	6,914.87	2.65%	2,661.81	1.34%
一年内到期的非流动负债	16,765.23	3.36%	9,519.39	2.67%	12,128.41	4.64%	8,351.50	4.21%
其他流动负债	2,026.44	0.41%	2,979.98	0.84%	8,697.07	3.33%	1,533.26	0.77%
流动负债合计	**438,152.61**	**87.89%**	**301,298.07**	**84.54%**	**218,292.20**	**83.58%**	**155,520.05**	**78.46%**
非流动负债：								
长期借款	39,330.46	7.89%	31,800.07	8.92%	19,167.80	7.34%	22,204.48	11.20%

项　目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	193.07	0.04%	231.44	0.06%	-	-	43.32	0.02%
长期应付款	218.77	0.04%	225.32	0.06%	226.83	0.09%	879.54	0.44%
递延收益	20,654.20	4.14%	20,803.02	5.84%	16,672.51	6.38%	12,672.10	6.39%
递延所得税负债	-	-	2,040.91	0.57%	6,831.71	2.62%	6,892.33	3.48%
非流动负债合计	**60,396.49**	**12.11%**	**55,100.76**	**15.46%**	**42,898.86**	**16.42%**	**42,691.76**	**21.54%**
负债合计	**498,549.10**	**100.00%**	**356,398.82**	**100.00%**	**261,191.06**	**100.00%**	**198,211.81**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 198,211.81 万元、261,191.06 万元、356,398.82 万元及 498,549.10 万元。公司负债以流动负债为主，主要为应付票据和应付账款等，流动负债占负债总额的比例分别为 78.46%、83.58%、84.54%及 87.89%。报告期各期，公司非流动负债占负债总额的比例分别为 21.54%、16.42%、15.46%及 12.11%，主要为长期借款、递延收益等。

1、主要流动负债分析

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	-	-	4,413.92	3,000.00
抵押+保证借款	-	-	2,000.00	1,300.00
票据贴现	-	-	1,598.26	2,171.22
信用借款	25,237.09	26,796.21	-	-
质押+保证借款	-	-	2,000.00	1,400.00
合计	**25,237.09**	**26,796.21**	**10,012.18**	**7,871.22**

报告期各期末，公司短期借款余额分别为 7,871.22 万元、10,012.18 万元、26,796.21 万元和 25,237.09 万元。2025 年末，短期借款较 2024 年增加了 167.64%，主要是公司经营规模增长，2025 年度新增较多信用借款所致。

（2）应付票据

报告期各期末，公司应付票据余额分别为 32,153.89 万元、44,717.98 万元、66,248.66 万元及 107,709.72 万元。2024 年末，应付票据较 2023 年末增加 39.07%，主要是由于本

期营业成本规模增长了 39.26%，应付票据余额随营业成本的增加而增加。2025 年末、2026 年 6 月末应付票据分别较上期增加了 48.15%和 62.58%，主要是由于经营规模增长，采购规模增加，导致期末尚未到期的应付票据余额增加。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料采购	170,466.44	65.94%	109,716.72	63.88%	58,508.85	48.78%	47,398.71	52.66%
设备、工程采购	70,346.97	27.21%	51,364.39	29.91%	48,178.67	40.17%	28,880.31	32.08%
加工费	10,304.95	3.99%	5,083.87	2.96%	3,038.80	2.53%	658.59	0.73%
电费	2,203.50	0.85%	1,631.16	0.95%	7,084.89	5.91%	9,768.70	10.85%
其他	5,198.33	2.01%	3,953.88	2.30%	3,131.04	2.61%	3,308.90	3.68%
合计	**258,520.19**	**100.00%**	**171,750.02**	**100.00%**	**119,942.26**	**100.00%**	**90,015.21**	**100.00%**

报告期内，公司应付账款主要系材料采购和设备、工程采购。报告期各期末，公司应付账款余额分别为 90,015.21 万元、119,942.26 万元、171,750.02 万元和 258,520.19 万元，占流动负债的比例分别为 57.88%、54.95%、57.00%和 59.00%。随着报告期内公司业务规模扩大，公司应付账款逐渐增加。

（4）合同负债

报告期各期末，公司合同负债分别为 630.43 万元、737.89 万元、605.29 万元和 1,546.13 万元，占流动负债的比例分别为 0.41%、0.34%、0.20%和 0.35%。公司合同负债为预收商品款。

（5）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一年内到期的长期借款	16,701.82	9,455.12	11,204.40	4,779.02
一年内到期的长期应付款	1.55	1.51	880.69	2,587.19
一年内到期的租赁负债	61.86	62.75	43.32	985.30

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
合计	**16,765.23**	**9,519.39**	**12,128.41**	**8,351.50**

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债分别为 8,351.50 万元、12,128.41 万元、9,519.39 万元和 16,765.23 万元，占流动负债的比例分别为 5.37%、5.56%、3.16%和 3.83%。

2、主要非流动负债分析

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款分别为 22,204.48 万元、19,167.80 万元、31,800.07 万元和 39,330.46 万元，占非流动负债的比例分别为 52.01%、44.68%、57.71%和 65.12%。

报告期各期末，公司长期借款情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
保证借款	8,721.72	10,388.12	10,296.13	8,511.58
抵押+保证借款	11,614.69	22,882.79	20,076.08	18,471.92
信用借款	35,695.88	7,984.28	-	-
小计	**56,032.28**	**41,255.19**	**30,372.21**	**26,983.49**
减：一年内到期的长期借款	16,701.82	9,455.12	11,204.40	4,779.02
合计	**39,330.46**	**31,800.07**	**19,167.80**	**22,204.48**

2025 年末，长期借款较 2024 年末增加了 65.90%，主要是由于公司经营规模增长，2025 年度新增一年以上借款所致。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期借款具体明细情况如下：

单位：万元

借款方式	放款单位	借款余额	担保方	抵押物
信用借款	国家开发银行广东省分行	14,103.51	/	/
信用借款	中国进出口银行广东省分行	21,592.37	/	/
抵押+保证借款	平安银行股份有限公司广州分行	11,614.69	广州广合科技股份有限公司	抵押物：鄂（2022）黄石市不动产权第 0034499 号
保证借款	星展银行（中国）有限公司广州分行	8,721.72	广州广合科技股份有限公司、广合科技（国际）有限公司	/

借款方式	放款单位	借款余额	担保方	抵押物
合计	-	56,032.28	-	-

（2）长期应付款

报告期各期末，公司长期应付款分别为 879.54 万元、226.83 万元、225.32 万元和 218.77 万元，占非流动负债的比例分别为 2.06%、0.53%、0.41%和 0.36%。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益分别为 12,672.10 万元、16,672.51 万元、20,803.02 万元和 20,654.20 万元，占非流动负债的比例分别为 29.68%、38.86%、37.75%和 34.20%，报告期内，公司递延收益为政府补助。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司的主要偿债指标如下表所示：

财务指标	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	1.65	1.23	1.30	1.16
速动比率（倍）	1.33	0.97	1.09	0.90
资产负债率	38.60%	47.25%	45.94%	51.99%

注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算方法如下：
1、流动比率=流动资产/流动负债
2、速动比率=速动资产/流动负债（速动资产=流动资产-存货）
3、资产负债率=总负债/总资产

报告期各期末，公司资产负债率分别为 51.99%、45.94%、47.25%和 38.60%，整体处于较低水平，偿债能力较强。流动比率分别为 1.16、1.30、1.23 及 1.65，速动比率分别为 0.90、1.09、0.97 及 1.33，公司经营情况持续向好。

（四）资产周转能力分析

报告期内，公司的主要资产运营能力指标如下表所示：

财务指标	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次/年）	3.50	3.36	3.54	3.53
存货周转率（次/年）	4.61	5.20	5.01	4.05

注：上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算方法如下：
1、应收账款周转率=营业收入/[（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）/2]，2026 年 1-6 月数据经年化
2、存货周转率=营业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]，2026 年 1-6 月数据经年化

报告期各期，公司应收账款周转率分别为 3.53 次/年、3.54 次/年、3.36 次/年和 3.50 次/年，基本保持稳定。

报告期各期，公司存货周转率分别为 4.05 次/年、5.01 次/年、5.20 次/年和 4.61 次/年，基本保持稳定。

报告期内，公司与同行业可比公司的应收账款周转率如下：

公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
深南电路	4.61	4.94	4.92	4.39
沪电股份	4.01	3.91	3.92	3.57
胜宏科技	3.58	3.91	2.99	2.69
生益电子	3.52	4.14	3.34	3.18
平均值	**3.93**	**4.22**	**3.79**	**3.46**
公司	**3.50**	**3.36**	**3.54**	**3.53**

2023 年公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平；2024 年、2025 年和 2026 年 1-6 月公司应收账款周转率与同行业可比公司水平接近。

报告期内，公司与同行业可比公司的存货周转率如下：

公司简称	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
深南电路	3.13	3.78	4.18	3.86
沪电股份	3.12	3.43	3.90	3.29
胜宏科技	3.35	4.63	4.60	4.79
生益电子	3.76	4.48	3.58	3.77
平均值	**3.34**	**4.08**	**4.06**	**3.93**
公司	**4.61**	**5.20**	**5.01**	**4.05**

报告期内，公司存货周转率高于同行业可比公司平均水平，系公司客户的产品需求计划明确且稳定，客户对公司产品的需求较为旺盛，存货周转相对较快。

（五）财务性投资情况

1、财务性投资的认定依据

（1）《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定

《上市公司证券发行注册管理办法》第九条规定，“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”；《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第

60 号——上市公司向不特定对象发行证券募集说明书》第四十七条规定，“发行人应披露其截至最近一期末，持有财务性投资余额的具体明细、持有原因及未来处置计划，不存在金额较大的财务性投资的基本情况”。

（2）《证券期货法律适用意见第 18 号》相关规定

《证券期货法律适用意见第 18 号》关于财务性投资提出如下适用意见：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，以收购或整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。（七）发行人应当结合前述情况，准确披露截至最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。”

2、最近一期末是否存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可能涉及财务性投资的会计科目如下：

单位：万元

科目	主要内容	金额	财务性投资金额
货币资金	银行存款、库存现金、其他货币资金	264,232.70	-
其他应收款	押金和保证金、员工借款备用金及其他	3,254.06	-
其他流动资产	增值税留抵税额、预缴所得税	15,946.51	-
长期股权投资	对九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）的股权投资	2,020.31	-
其他非流动资产	预付设备工程款、预付投资款	72,687.13	-

科目	主要内容	金额	财务性投资金额
衍生金融资产	远期外汇合约	1,320.21	-
衍生金融负债	远期外汇合约	479.60	-
交易性金融资产	/	-	-
其他权益工具投资	/	-	-
一年内到期的非流动资产	/	-	-
长期应收款	/	-	-
其他非流动金融资产	/	-	-
财务性投资金额合计			-

（1）货币资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金期末余额 264,232.70 万元，主要为银行存款、库存现金、其他货币资金，用于日常经营结算和募集资金管理，不涉及财务性投资。

（2）其他应收款/其他流动资产/其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款、其他流动资产、其他非流动资产，均为与经营相关的押金和保证金、员工借款备用金及其他、增值税留抵税额、预缴所得税、预付设备工程款等，与财务性投资无关。

（3）长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资中，对九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）（以下简称“九派宏涛基金”）投资的 2,020.31 万元认定为非财务性投资，具体依据如下：

被投资主体	金额（万元）	是否涉及财务性投资	投资性质认定依据
九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）	2,020.31	否	根据公司于 2025 年 7 月 23 日披露的《广州广合科技股份有限公司关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告》，该基金设立目的为“布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，有助于进一步挖掘产业链上下游及横向优质企业，提升公司核心竞争力，完善公司整体战略布局”，与公司主营的算力 PCB 业务之间存在直接且紧密的产业链上下游关联，属于围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一款第（二）项的相关规定。

截至 2026 年 6 月 30 日，九派宏涛基金已完成的对外投资情况如下：

被投资企业	主营业务	投资轮次/时间	基金持股比例	与公司主营业务的产业关联性
深圳奥维领芯科技有限公司	高性能 RISC-V 通用处理器芯片的设计、开发与销售，自研基于 RISC-V 指令集的高性能 CPU 内核及可编程加速引擎，产品应用于边缘计算、人工智能计算、工业互联网计算、通信及网络安全等领域	Pre-A 轮／2026 年 1 月	1.22%	处理器芯片系算力硬件的核心元器件，公司算力 PCB 产品即为其运行的承载载体，二者在封装形态、引脚密度、信号传输速率、材料选型及信号完整性设计等方面存在直接技术耦合。公司通过该项投资可前瞻获取国产算力芯片的技术演进路径及其对应的 PCB 技术规格要求，属于围绕产业链上下游以获取技术为目的的产业投资
光轮智能（北京）科技股份有限公司	物理 AI（Physical AI）数据与评测基础设施，为具身智能、人形机器人及世界模型提供仿真合成数据、模型评测与部署服务	B 轮／2026 年 5 月	1.22%	契合九派宏涛基金设立时约定的“AI 应用、人形机器人”投资方向。具身智能产业的规模化落地将直接带动 AI 算力基础设施及机器人控制类电路板的需求增长，公司通过该项投资提前布局下游应用场景资源，属于围绕产业链下游以拓展客户、渠道为目的的产业投资

上述投资均系围绕公司主营业务所处的算力硬件产业链进行的前瞻性布局，投向与九派宏涛基金设立时公告披露的投资领域一致；九派宏涛基金对各被投资企业的持股比例均较低，为参股型少数股权投资，公司亦不参与被投资企业的日常经营决策，投资目的并非获取短期财务回报。

因此，公司通过九派宏涛基金开展的上述投资不属于《证券期货法律适用意见第 18 号》第一款第（一）项所列举的财务性投资情形，符合第一款第（二）项关于“围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资”相关规定，不认定为财务性投资。

（4）衍生金融资产/衍生金融负债

截至 2026 年 6 月 30 日，公司衍生金融资产、衍生金融负债，均为远期外汇合约，期末衍生金融资产均为公司购买的远期外汇合约产生的浮动盈利，期末衍生金融负债较期初增加，主要是由于公司购买的远期外汇合约产生的浮动亏损增加所致，与财务性投资无关。

综上所述，公司最近一期末不存在持有金额较大的财务性投资（包括类金融业务）的情形。

七、经营成果分析

报告期内，随着公司经营规模扩大，盈利表现逐年强化，净利润分别为 41,468.57 万元、67,610.04 万元、101,578.90 万元和 95,558.82 万元，不存在对税收优惠的重大依赖，亦不主要来源于非经常性损益，具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业总收入	438,826.02	548,537.14	373,428.46	267,827.03
营业总成本	323,863.97	427,101.41	288,103.35	211,136.08
营业利润（亏损以“-”号填列）	107,690.75	113,853.33	76,564.32	49,829.51
利润总额（亏损总额以“-”号填列）	107,680.11	113,689.92	76,248.10	49,688.25
净利润（净亏损以“-”号填列）	95,558.82	101,578.90	67,610.04	41,468.57

（一）营业收入结构及趋势分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	408,693.93	93.13%	510,188.98	93.01%	347,937.96	93.17%	253,713.59	94.73%
其他业务收入	30,132.09	6.87%	38,348.16	6.99%	25,490.51	6.83%	14,113.43	5.27%
合计	**438,826.02**	**100.00%**	**548,537.14**	**100.00%**	**373,428.46**	**100.00%**	**267,827.03**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务收入分别为 253,713.59 万元、347,937.96 万元、510,188.98 万元和 408,693.93 万元，占营业收入的比例分别为 94.73%、93.17%、93.01%和 93.13%。公司主营业务收入均来源于印制电路板销售，主营业务突出。

报告期内，公司主营业务收入整体呈快速增长趋势，主要受算力场景 PCB 需求增长、产品结构优化和产能释放等因素影响，产品销售增长。

2、主营业务收入产品构成及分析

报告期内，公司主营业务收入按产品构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
印制电路板	408,693.93	100.00%	510,188.98	100.00%	347,937.96	100.00%	253,713.59	100.00%
合计	**408,693.93**	**100.00%**	**510,188.98**	**100.00%**	**347,937.96**	**100.00%**	**253,713.59**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入均来自印制电路板销售，印制电路板销售收入分别为 253,713.59 万元、347,937.96 万元、510,188.98 万元和 408,693.93 万元，占主营业务收入的比例均为 100.00%。

3、主营业务收入按应用领域分析

报告期内，公司主营业务收入按应用领域分类的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
算力场景 PCB	366,891.92	89.77%	412,334.08	80.82%	270,555.63	77.76%	185,818.88	73.24%
工业场景 PCB	19,650.70	4.81%	37,837.02	7.42%	28,076.84	8.07%	26,078.52	10.28%
消费场景 PCB	22,151.31	5.42%	60,017.89	11.76%	49,305.49	14.17%	41,816.19	16.48%
合计	**408,693.93**	**100.00%**	**510,188.98**	**100.00%**	**347,937.96**	**100.00%**	**253,713.59**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务收入以算力场景 PCB 为主，算力场景 PCB 收入占主营业务收入的比例分别为 73.24%、77.76%、80.82%和 89.77%。报告期内算力场景 PCB 收入增长较快，主要受服务器及 AI 算力相关客户需求增长带动。

4、主营业务收入区域构成及分析

报告期内，公司主营业务收入分地区构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内销售	91,618.23	22.42%	144,634.50	28.35%	79,662.61	22.90%	47,745.94	18.82%
境外销售	317,075.70	77.58%	365,554.48	71.65%	268,275.34	77.10%	205,967.65	81.18%
合计	**408,693.93**	**100.00%**	**510,188.98**	**100.00%**	**347,937.96**	**100.00%**	**253,713.59**	**100.00%**

报告期内，公司境外销售收入占比较高，占主营业务收入的比例分别为 81.18%、77.10%、71.65%和 77.58%。

5、营业收入按销售模式分类

报告期内，公司营业收入按销售模式分类情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直销	432,880.08	98.65%	535,454.37	97.61%	362,133.67	96.98%	251,684.36	93.97%
非直销	5,945.94	1.35%	13,082.77	2.39%	11,294.79	3.02%	16,142.67	6.03%
合计	**438,826.02**	**100.00%**	**548,537.14**	**100.00%**	**373,428.46**	**100.00%**	**267,827.03**	**100.00%**

报告期内，公司以直销为主、非直销为辅，直销收入占营业收入的比例分别为93.97%、96.98%、97.61%和 98.65%。直销模式有利于公司及时了解客户定制化需求并持续开展产品协同开发；非直销主要用于拓展市场覆盖并服务部分规模较小或特定区域客户。

6、营业收入季节性分析

报告期内，公司营业收入按季度分类情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	191,397.28	43.62%	111,698.47	20.36%	78,435.75	21.00%	52,453.39	19.58%
第二季度	247,428.75	56.38%	130,776.88	23.84%	92,122.60	24.67%	64,767.85	24.18%
第三季度	-	-	141,037.56	25.71%	97,507.63	26.11%	78,893.45	29.46%
第四季度	-	-	165,024.23	30.08%	105,362.48	28.21%	71,712.33	26.78%
合计	**438,826.02**	**100.00%**	**548,537.14**	**100.00%**	**373,428.46**	**100.00%**	**267,827.03**	**100.00%**

报告期内，公司营业收入不存在明显的季节性特征。受春节假期、下游客户需求及订单交付节奏等因素影响，公司第一季度收入占比相对较低，第四季度收入占比相对较高。总体来看，公司各季度营业收入分布较为均衡，不存在对单一季度收入的重大依赖。

（二）营业成本构成及趋势分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	264,164.76	99.13%	357,739.82	99.46%	247,326.28	99.41%	177,343.40	99.27%
其他业务成本	2,321.62	0.87%	1,927.71	0.54%	1,456.24	0.59%	1,299.41	0.73%
合计	**266,486.39**	**100%**	**359,667.53**	**100.00%**	**248,782.52**	**100.00%**	**178,642.80**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务成本均为印制电路板销售对应成本。2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-6 月，主营业务成本分别为 177,343.40 万元、247,326.28 万元、357,739.82 万元和 264,164.76 万元。

报告期内发行人主营业务成本主要为直接材料，具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	186,481.92	70.59%	241,866.25	67.61%	162,754.60	65.81%	111,093.71	62.64%
直接人工	20,400.59	7.72%	33,061.18	9.24%	23,176.79	9.37%	17,719.96	9.99%
制造费用	54,599.64	20.67%	78,507.44	21.94%	59,818.30	24.19%	46,445.15	26.19%
其他	2,682.61	1.02%	4,304.95	1.21%	1,576.58	0.64%	2,084.58	1.18%
合计	**264,164.76**	**100.00%**	**357,739.82**	**100.00%**	**247,326.28**	**100.00%**	**177,343.40**	**100.00%**

报告期内发行人直接材料金额分别为 111,093.71 万元、162,754.60 万元、241,866.25 万元和 186,481.92 万元，占主营业务成本比重分别为 62.64%、65.81%、67.61%和 70.59%，直接材料金额占主营业务成本比例有所上升，主要系上游原材料成本上升所致。

2、主营业务成本按应用场景分析

报告期内，发行人主营业务成本按应用场景分类情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
算力场景 PCB	223,689.87	84.68%	266,579.09	74.52%	170,457.11	68.92%	115,244.36	64.98%
工业场景 PCB	18,867.50	7.14%	34,993.21	9.78%	28,371.55	11.47%	23,834.61	13.44%
消费场景 PCB	21,607.39	8.18%	56,167.52	15.70%	48,497.62	19.61%	38,264.43	21.58%
合计	**264,164.76**	**100.00%**	**357,739.82**	**100.00%**	**247,326.28**	**100.00%**	**177,343.40**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务成本分别为 177,343.40 万元、247,326.28 万元、357,739.82

万元和 264,164.76 万元。其中，公司主营业务成本以算力场景 PCB 为主，占比分别为 64.98%、68.92%、74.52%和 84.68%。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及变动分析

报告期内，公司毛利整体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务毛利	144,529.16	83.86%	152,449.16	80.72%	100,611.68	80.72%	76,370.20	85.63%
其他业务毛利	27,810.47	16.14%	36,420.45	19.28%	24,034.27	19.28%	12,814.02	14.37%
合计	**172,339.64**	**100.00%**	**188,869.61**	**100.00%**	**124,645.94**	**100.00%**	**89,184.22**	**100.00%**

报告期各期，公司主营业务毛利分别为 76,370.20 万元、100,611.68 万元、152,449.16 万元和 144,529.16 万元，占营业毛利的比例分别为 85.63%、80.72%、80.72%和 83.86%，为公司毛利的主要来源。

2、主营业务毛利及毛利率按应用场景构成分析

报告期内，发行人主营业务毛利及毛利率按应用场景分类情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
算力场景 PCB	143,202.04	39.03%	145,754.99	35.35%	100,098.51	37.00%	70,574.52	37.98%
工业场景 PCB	783.20	3.99%	2,843.81	7.52%	-294.70	-1.05%	2,243.92	8.60%
消费场景 PCB	543.91	2.46%	3,850.36	6.42%	807.87	1.64%	3,551.76	8.49%
合计	**144,529.16**	**35.36%**	**152,449.16**	**29.88%**	**100,611.68**	**28.92%**	**76,370.20**	**30.10%**

报告期内，公司主营业务毛利主要来源于算力场景 PCB，毛利率分别为 37.98%、37.00%、35.35%和 39.03%，基本保持稳定。2024 年度，工业场景 PCB 毛利及毛利率为负，主要系部分通信相关产品产生亏损所致。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	10,116.11	2.31%	12,874.28	2.35%	10,662.05	2.86%	8,528.71	3.18%
管理费用	10,493.08	2.39%	21,156.09	3.86%	13,194.52	3.53%	9,566.22	3.57%
研发费用	23,010.51	5.24%	27,979.30	5.10%	17,919.75	4.80%	12,058.87	4.50%
财务费用	11,867.96	2.70%	2,905.14	0.53%	-4,863.32	-1.30%	260.67	0.10%
合计	**55,487.66**	**12.64%**	**64,914.80**	**11.83%**	**36,912.99**	**9.88%**	**30,414.47**	**11.36%**

报告期各期，公司期间费用合计分别为 30,414.47 万元、36,912.99 万元、64,914.80 万元和 55,487.66 万元，占营业收入的比例分别为 11.36%、9.88%、11.83%和 12.64%。报告期内，公司期间费用结构稳定，研发费用占比较高。报告期内，公司期间费用率呈总体增加趋势，主要系公司根据市场和产品的判断不断加大研发投入。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
佣金	5,500.89	54.38%	6,168.13	47.91%	5,517.40	51.75%	3,963.20	46.47%
职工薪酬	3,103.76	30.68%	4,626.45	35.94%	3,473.02	32.57%	2,973.39	34.86%
业务招待费	599.88	5.93%	1,048.06	8.14%	896.12	8.40%	740.89	8.69%
保险费	228.01	2.25%	214.22	1.66%	183.32	1.72%	174.74	2.05%
差旅费	188.14	1.86%	311.98	2.42%	250.02	2.34%	235.36	2.76%
股份支付	185.80	1.84%	134.55	1.05%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
交通运杂费	48.07	0.48%	94.03	0.73%	95.99	0.90%	106.18	1.24%
报关费	47.52	0.47%	97.66	0.76%	81.42	0.76%	99.62	1.17%
其他	214.05	2.12%	179.20	1.39%	164.76	1.55%	235.34	2.76%
合计	**10,116.11**	**100.00%**	**12,874.28**	**100.00%**	**10,662.05**	**100.00%**	**8,528.71**	**100.00%**

报告期各期，公司销售费用分别为 8,528.71 万元、10,662.05 万元、12,874.28 万元和 10,116.11 万元，占营业收入的比例分别为 3.18%、2.86%、2.35%和 2.31%，主要由佣金、职工薪酬及业务招待费构成。报告期内，随着业务规模扩大，公司销售人员职工薪酬及佣金相应增加，销售费用逐年上升，销售费用率逐年下降。

报告期各期，公司与可比公司销售费用率情况如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
胜宏科技	0.90%	1.33%	1.87%	1.95%
沪电股份	2.63%	2.80%	2.74%	2.96%
深南电路	1.37%	1.61%	1.70%	1.99%
生益电子	3.02%	3.23%	3.41%	2.73%
平均值	**1.98%**	**2.25%**	**2.43%**	**2.41%**
公司	**2.31%**	**2.35%**	**2.86%**	**3.18%**

报告期内，公司销售费用率分别为 3.18%、2.86%、2.35%和 2.31%，可比公司平均值分别为 2.41%、2.43%、2.25%和 1.98%，公司销售费用率整体略高于可比公司平均水平，但随着营业收入规模扩大，公司销售费用率逐年下降，差异逐步缩小。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	5,946.19	56.67%	9,146.63	43.23%	7,732.71	58.61%	5,889.88	61.57%
专业服务费	1,280.14	12.20%	2,360.06	11.16%	1,079.24	8.18%	580.09	6.06%
折旧摊销及租赁费	1,016.32	9.69%	2,072.08	9.79%	1,265.28	9.59%	1,021.59	10.68%
股份支付	863.47	8.23%	5,007.24	23.67%	1,538.59	11.66%	655.40	6.85%
办公费	340.65	3.25%	706.99	3.34%	342.15	2.59%	249.21	2.61%
业务招待费	185.90	1.77%	218.66	1.03%	77.19	0.58%	164.61	1.72%
水电费	66.25	0.63%	97.42	0.46%	126.44	0.96%	159.50	1.67%
差旅费	60.60	0.58%	329.18	1.56%	200.25	1.52%	131.61	1.38%
其他	733.56	6.99%	1,217.83	5.76%	832.67	6.31%	714.33	7.47%
合计	**10,493.08**	**100.00%**	**21,156.09**	**100.00%**	**13,194.52**	**100.00%**	**9,566.22**	**100.00%**

报告期各期，公司管理费用分别为 9,566.22 万元、13,194.52 万元、21,156.09 万元和 10,493.08 万元，占营业收入的比例分别为 3.57%、3.53%、3.86%和 2.39%，主要由职工薪酬、专业服务费、折旧摊销及租赁费和股份支付构成。报告期内，随着经营规模扩大，公司职工薪酬、专业服务费及股份支付等相应增加，管理费用逐年上升。

报告期各期，公司与可比公司管理费用率对比情况如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
胜宏科技	2.51%	2.59%	3.66%	3.38%
沪电股份	1.93%	2.22%	2.42%	2.19%
深南电路	4.65%	4.50%	4.05%	4.44%
生益电子	3.50%	3.44%	4.33%	4.78%
平均值	**3.15%**	**3.19%**	**3.61%**	**3.70%**
公司	**2.39%**	**3.86%**	**3.53%**	**3.57%**

报告期内，公司管理费用率分别为 3.57%、3.53%、3.86%和 2.39%，可比公司平均值分别为 3.70%、3.61%、3.19%和 3.15%，公司管理费用率处于可比公司合理区间，与自身业务规模及管理投入情况相匹配。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
材料及动力费	12,297.59	53.44%	13,703.77	48.98%	8,152.56	45.49%	4,655.68	38.61%
职工薪酬	7,875.02	34.22%	11,212.65	40.07%	7,953.33	44.38%	5,973.54	49.54%
折旧费	1,186.06	5.15%	1,466.36	5.24%	1,105.61	6.17%	735.96	6.10%
股份支付	1,068.56	4.64%	676.33	2.42%	-	0.00%	-	0.00%
检测、服务费	504.03	2.19%	808.89	2.89%	648.38	3.62%	567.89	4.71%
其他	79.25	0.34%	111.30	0.40%	59.87	0.33%	125.80	1.04%
合计	**23,010.51**	**100.00%**	**27,979.30**	**100.00%**	**17,919.75**	**100.00%**	**12,058.87**	**100.00%**

报告期各期，公司研发费用分别为 12,058.87 万元、17,919.75 万元、27,979.30 万元和 23,010.51 万元，占营业收入的比例分别为 4.50%、4.80%、5.10%和 5.24%。报告期内公司研发费用逐年增加，系公司持续加大对高多层板、高阶 HDI、AI 服务器及高速传输相关产品和工艺的研发投入所致。

报告期各期，公司与可比公司研发费用率情况如下：

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
胜宏科技	3.09%	4.03%	4.19%	4.39%
沪电股份	6.31%	6.02%	5.92%	6.03%

公司名称	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
深南电路	5.61%	6.73%	7.10%	7.93%
生益电子	4.98%	5.14%	6.05%	5.89%
平均值	**5.00%**	**5.48%**	**5.82%**	**6.06%**
公司	**5.24%**	**5.10%**	**4.80%**	**4.50%**

报告期内，公司研发费用率分别为 4.50%、4.80%、5.10%和 5.24%，可比公司平均值分别为 6.06%、5.82%、5.48%和 5.00%。报告期内公司研发费用率整体呈上升趋势，处于可比公司合理区间。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	915.73	1,657.09	1,586.67	1,392.71
减：利息收入	1,224.63	2,031.93	1,735.32	447.30
汇兑损益	11,928.44	3,029.86	-4,861.23	-893.60
银行手续费及其他	248.43	250.12	146.56	208.86
合计	**11,867.96**	**2,905.14**	**-4,863.32**	**260.67**

报告期各期，公司财务费用分别为 260.67 万元、-4,863.32 万元、2,905.14 万元和 11,867.96 万元。2024 年度财务费用为负，主要受汇兑收益影响；2025 年度财务费用转正，主要系汇率变动形成汇兑损失。2026 年 1-6 月财务费用同比增加 12,424.68 万元，主要系美元兑人民币汇率下降，公司美元资产产生汇兑净损失。

（五）其他主要项目分析

1、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
政府补助	1,136.07	2,761.22	2,185.89	1,884.10
个税扣缴税款手续费	51.88	37.23	26.28	21.82
进项税加计抵减	-	265.41	-	-
合计	**1,187.95**	**3,063.86**	**2,212.17**	**1,905.92**

报告期各期，公司其他收益分别为 1,905.92 万元、2,212.17 万元、3,063.86 万元和 1,187.95 万元，主要由政府补助构成。

2、投资收益

报告期内，公司投资收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
权益法核算的长期股权投资收益	-60.04	-19.65	-	-
交易性金融资产持有期间的投资收益	88.10	300.17	190.22	-
处置衍生工具取得的投资收益	-	805.14	-312.45	-
合计	**28.06**	**1,085.65**	**-122.23**	**-**

报告期各期，公司投资收益分别为 0 万元、-122.23 万元、1,085.65 万元和 28.06 万元。2025 年公司投资收益较高，主要由于处置衍生工具取得的投资收益较高所致。2026 年 1-6 月投资收益同比下降，主要系结构性存款收益及处置衍生工具取得的投资收益减少。

3、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失情况（损失以“-”号填列）如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,503.68	-7,424.58	-7,177.13	-3,333.08
固定资产减值损失	-637.13	-192.87	-750.08	-72.87
合计	**-5,140.81**	**-7,617.45**	**-7,927.21**	**-3,405.96**

报告期各期，公司资产减值损失金额分别为-3,405.96 万元、-7,927.21 万元、-7,617.45 万元和-5,140.81 万元，主要为存货跌价损失及合同履约成本减值损失。报告期内资产减值损失呈总体增加趋势，主要系存货规模扩大，相应计提的存货跌价损失增加所致。

4、营业外收入

报告期各期，公司营业外收入分别为 12.67 万元、15.28 万元、48.63 万元和 19.31 万元，金额较小，对经营业绩影响有限。

5、营业外支出

报告期各期，公司营业外支出分别为 153.93 万元、331.50 万元、212.04 万元和 29.94

万元，主要包括非流动资产毁损报废损失、对外捐赠及其他支出，金额相对较小。

（六）非经常性损益分析

报告期内，发行人的非经常性损益项目及其金额如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年	2024 年	2023 年
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	39.57	-149.90	-53.95	-196.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	90.23	2,119.43	1,231.67	1,884.10
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,817.14	1,456.59	-1,195.67	-4,153.74
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	-	-	8.93
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7.13	-153.48	-303.96	-2.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	11.37	32.16	-
小计	**1,939.80**	**3,284.02**	**-289.75**	**-2,460.17**
减：所得税影响额	321.19	509.88	-66.10	-397.07
减：少数股东权益影响额（税后）	-	-	-	-
合计	**1,618.62**	**2,774.13**	**-223.65**	**-2,063.10**

报告期各期，公司非经常性损益分别为-2,063.10 万元、-223.65 万元、2,774.13 万元和 1,618.62 万元，对公司经营成果影响较小，主要由金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益、政府补助构成。

八、现金流量分析

报告期内，公司现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
经营活动产生的现金流量净额	93,689.24	103,157.06	79,628.46	52,751.32
投资活动产生的现金流量净额	-166,917.18	-121,184.26	-112,373.50	-42,486.35
筹资活动产生的现金流量净额	284,825.61	-6,922.30	60,906.95	4,313.20
现金及现金等价物净增加额	210,206.48	-22,470.31	28,586.76	14,915.65

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	335,158.49	468,863.02	355,899.07	247,244.75
收到的税费返还	28,437.77	23,293.96	18,476.90	11,654.97
收到其他与经营活动有关的现金	2,283.07	9,871.99	8,074.62	3,123.53
经营活动现金流入小计	**365,879.33**	**502,028.97**	**382,450.59**	**262,023.25**
购买商品、接受劳务支付的现金	202,279.88	300,065.90	227,870.10	155,703.22
支付给职工以及为职工支付的现金	47,272.08	69,430.72	48,340.33	37,610.62
支付的各项税费	8,781.86	14,830.26	13,726.20	6,722.79
支付其他与经营活动有关的现金	13,856.28	14,545.02	12,885.50	9,235.30
经营活动现金流出小计	**272,190.09**	**398,871.91**	**302,822.12**	**209,271.93**
经营活动产生的现金流量净额	**93,689.24**	**103,157.06**	**79,628.46**	**52,751.32**

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 52,751.32 万元、79,628.46 万元、103,157.06 万元和 93,689.24 万元。经营活动现金流入主要为销售商品、提供劳务收到的现金，现金流出主要为购买商品、接受劳务支付的现金。

2024 年度和 2025 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别同比增长 50.95%和 29.55%。2026 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额同比增长 106.77%，主要系经营利润增加、销售回款增加。报告期各期经营活动现金流量净额与公司业务规模及经营情况相匹配。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	46,000.00	111,380.00	102,600.00	-
取得投资收益收到的现金	1,600.09	1,071.00	750.40	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	728.07	525.37	13.70	170.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	29.98	-	-
投资活动现金流入小计	**48,328.16**	**113,006.35**	**103,364.10**	**170.90**

项目	2026年1-6月	2025年度	2024年度	2023年度
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,552.18	130,943.13	82,751.09	40,406.65
投资支付的现金	27,900.00	102,580.00	131,600.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	8,793.16	667.48	1,386.51	2,250.60
投资活动现金流出小计	**215,245.34**	**234,190.61**	**215,737.60**	**42,657.25**
投资活动产生的现金流量净额	**-166,917.18**	**-121,184.26**	**-112,373.50**	**-42,486.35**

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-42,486.35 万元、-112,373.50 万元、-121,184.26 万元和-166,917.18 万元。2024 年度投资现金流出增加主要系购买结构性存款及厂房建设投入；2025 年度投资现金流出主要用于广州新增云擎项目、摩天工坊宿舍楼等长期资产投资及购买结构性存款；2026 年 1-6 月投资活动现金净流出同比增加，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金、支付其他与投资活动有关的现金增加所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	284,827.87	1,104.27	73,323.96	-
取得借款收到的现金	32,917.15	39,555.85	22,080.09	32,036.94
收到其他与筹资活动有关的现金	-	572.96	498.84	23,447.21
筹资活动现金流入小计	**317,745.02**	**41,233.07**	**95,902.89**	**55,484.15**
偿还债务支付的现金	32,017.92	22,505.13	16,603.77	24,682.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	855.71	22,094.09	11,952.38	1,429.98
支付其他与筹资活动有关的现金	45.78	3,556.15	6,439.79	25,058.55
筹资活动现金流出小计	**32,919.41**	**48,155.37**	**34,995.93**	**51,170.95**
筹资活动产生的现金流量净额	**284,825.61**	**-6,922.30**	**60,906.95**	**4,313.20**

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 4,313.20 万元、60,906.95 万元、-6,922.30 万元和 284,825.61 万元。2024 年度筹资活动现金流量净额增加主要系公司 A 股上市收到募集资金；2025 年度转为净流出，主要系 2024 年度上市募集资金流入不再发生，同时偿还债务及分配股利、偿付利息支付的现金增加；2026 年 1-6 月筹资活动现金流量净额大幅增加，主要系公司完成 H 股全球发售并收到募集资金。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为40,406.65 万元、82,751.09 万元、130,943.13 万元和 178,552.18 万元。资本性支出主要用于广州、黄石及泰国生产基地的厂房、设备、工艺升级和产能建设，以满足高多层 PCB 及高阶 HDI 等产品的业务发展需求。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及需要资金量

公司未来可预见的资本性支出项目主要为本次募集资金计划投资的项目，具体内容参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”。除本次募集资金计划投资的项目外，未来可预见的其他重大资本性支出为“广合科技东莞智造总部项目”，项目投资总额为 60 亿元（含土地价款，最终以实际投资金额为准），项目实施主体为公司或公司全资子公司。上述事项已经公司于 2026 年 6 月 18 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、公司的核心技术及研发情况”之“（三）公司核心技术及其先进性”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司正在从事的研发项目及进展情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、公司的核心技术及研发情况”之“（四）公司在研项目情况”。

（三）保持持续技术创新的机制和安排

1、技术创新机制

公司自成立以来，一直重视产品的技术升级与研发创新以提升产品的技术水平。公司坚持“研发方向与市场紧密结合”的原则，增加对研发设备的投入，引进和培养高端人才，加强公司新产品、新工艺和新材料的研发能力。高素质、高能力的研发团队是企业技术创新、产业提升的基本保障和重要基础，公司注重人才的引入与培养，建立了完

善的研发考核、奖励制度，为研发人员的成长营造了良好的发展空间。

公司一直以来非常重视研发团队的建设，一方面，公司通过外聘、产学研合作、内部培养等多途径方式引进公司所需的各类科研人才；另一方面，公司还加强对技术人才的培养，提高公司的研发能力和自主创新能力，对科研人员的培训方式包括鼓励自我学习、公司组织入职前和定期培训、专业辅导课程、产学研交换、外部同业学习等。通过企业内部培养、外部引进等方式公司得以吸引更多优秀人才，培养出一支以理论为基础，技能过硬的研发团队。

公司鼓励员工发明创造的积极性，促进科技成果的推广应用，制定了《知识产权管理制度》、《研发激励制度》等制度，设立了技术发展效益奖、技术成果奖等奖项，用于激励公司内部技术人员开发具有良好经济效益或经专家评估具有重大潜在经济效益的项目，并对相关技术成果采取完善的知识产权保护措施。

2、技术储备及创新安排

公司高度重视产品研发和技术创新，建立了完善的技术创新组织体系和保障机制，根据行业的发展趋势，设立研发目标，制定研发计划。未来几年，公司的技术储备及研发目标为：紧紧围绕公司的主营业务，重点研发与 PCB 有关的新产品、新技术、新工艺；优化产品结构，提升柔性化管理水平，提高产品快速响应和交付能力，满足客户个性化定制生产需求；大力发展技术含量高、产品附加值大、市场前景广阔的高端 PCB 产品，如 AI 服务器加速板、交换板等；强化产学研等创新合作，提升科技成果转化能力；加大自主知识产权的创造、保护和管理投入，激励研发人员的创新积极性，提升公司核心竞争力。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重大期后事项

（一）重大担保事项

截至报告期末，公司不存在重大对外担保事项。

（二）重大仲裁、诉讼事项

截至 2026 年 9 月 30 日，公司不存在尚未了结的或可预见的金额 1,000 万元以上的诉讼、仲裁事项。

（三）其他或有事项

截至报告期末，公司或有事项如下：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保事项	金额（万元）	期限	备注
一、子公司				
黄石广合精密电路有限公司	为银行借款担保	11,614.69	2023/3/29-2028/6/1	非最高额担保+保证担保
Delton Technology (Thailand) Co.,Ltd	为银行借款担保	8,672.67	2024/10/12-2027/10/22	最高额公司担保
东莞广合数控科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行授信	3,157.26	票据开立日起 6 个月	
黄石广合精密电路有限公司	招商银行股份有限公司黄石分行授信	10,882.52	票据开立日起 6 个月	
黄石广合精密电路有限公司	广发银行股份有限公司黄石支行	5,770.02	票据开立日起 6 个月	
黄石广合精密电路有限公司	招商银行股份有限公司黄石分行授信	5,539.00	信用证开立日起 1 年	
广合科技（国际）有限公司	星展银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行授信	479.60	远期锁汇购买日至交割日	
合计		**46,115.77**		

（四）重大期后事项

截至报告期末，公司不存在对财务状况和经营成果有重大影响的期后事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目及补充流动资金。本次募投项目符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，有利于促进公司长期稳定可持续发展。随着本次发行可转债的完成及募集资金投资项目的实施，公司的核心竞争能力及抗风险能力将进一步增强，符合公司长远发展。

本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不涉及对公司现有资产的整合，不存在因本次发行而导致的业务与资产整合计划。

（二）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

本次发行完成后，公司股权结构不会发生变更，债券持有人在转股期内是否转股或者转股数量、节奏尚不确定。因此，本次发行不会直接导致上市公司股权结构发生重大变化。

第六节 合规经营与独立性

一、公司报告期内受到的行政处罚

报告期内，发行人及其子公司不存在与生产经营相关的重大违法违规行为或行政处罚记录。

二、公司及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人报告期内被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况

报告期内，公司及董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在其他被证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况、被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

三、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形，不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

四、同业竞争情况

（一）同业竞争基本情况

截至报告期期末，除广合科技外，公司控股股东臻蕴投资未控制其他企业。

截至报告期期末，除广合科技外，公司实际控制人肖红星、刘锦婵控制的其他企业主营业务情况如下：

序号	公司名称	主营业务
1	广州臻蕴投资有限公司	股权投资，发行人的控股股东
2	深圳广生投资企业（有限合伙）	股权投资，发行人的员工持股平台
3	深圳广财投资企业（有限合伙）	股权投资，发行人的员工持股平台
4	东莞市广华化工有限公司	电子化学品的研发、生产和销售
5	东莞秀博电子材料有限公司	电子化学品的研发、生产和销售
6	东莞市广华环保技术有限公司	蚀刻废液铜回收技术和服务
7	湖北广华化工有限公司	电子化学品的生产和销售

序号	公司名称	主营业务
8	东莞市优尼特化学有限公司	电子化学品的销售
9	湖北优尼科光电技术股份有限公司	液晶面板深加工的技术研发、生产和销售
10	广州臻达投资合伙企业（有限合伙）	股权投资，湖北优尼科光电技术股份有限公司的股东
11	东莞市广弘微电子材料有限公司	电子专用材料的研发、制造和销售
12	东莞市广华实业投资有限公司	实业投资，房地产投资，市场开发投资
13	广华国际有限公司	电子化学品的销售
14	SUPERB ELECTRONIC MATERIALS (THAILAND) CO., LTD.	电子化学品的研发、生产和销售

公司从事 PCB 的研发、生产和销售，控股股东及实际控制人控制的其他企业与公司的主营业务均不相同，与公司不存在同业竞争。

（二）有关避免同业竞争的承诺

为避免与公司可能出现的同业竞争，维护公司全体股东的利益和保证公司的长期稳定发展，控股股东臻蕴投资，实际控制人肖红星、刘锦婵已作出如下承诺：

“本企业/本人声明，本企业/本人已向广合科技准确、全面地披露本企业/本人及本人近亲属直接或间接持有的其他企业和其他经济组织（广合科技控制的企业和其他经济组织除外）的股权或权益情况，本企业/本人及本人近亲属直接或间接控制的其他企业或其他经济组织未以任何方式直接或间接从事与广合科技相竞争的业务。

1、广合科技与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业之间当前不存在从事相同、相似主营业务的情况；广合科技与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业之间不存在同业竞争。

2、广合科技首次公开发行股票募集资金投资项目实施后，与本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业不会产生同业竞争，对广合科技的独立性不会产生不利影响。

3、未来本企业/本人及本企业/本人控制的其他企业将避免与广合科技产生同业竞争，如果未来有在广合科技主营业务范围内的商业机会，本企业/本人将优先介绍给广合科技。

4、若本企业/本人未履行上述承诺，将赔偿广合科技因此而遭受的损失。

5、上述承诺自签署之日起生效，对本企业/本人具有法律约束力，至本企业/本人不再为广合科技控股股东/实际控制人当日失效。”

五、关联方和关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定，截至 2026 年 6 月 30 日，公司的主要关联方及关联关系如下：

1、发行人的控股股东及实际控制人

发行人的控股股东为臻蕴投资，实际控制人为肖红星、刘锦婵夫妇，详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员”之“（一）董事、高级管理人员基本情况”之“1、董事”。

2、直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人

无直接持有发行人 5%以上股份的自然人，间接持有发行人 5%以上股份的自然人如下：

序号	关联方名称	间接持股数额（股）	间接持股比例（%）
1	肖红星	176,738,257	37.39
2	曾红	28,832,444	6.10

持有发行人 5%以上股份的自然人股东关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，以下同）亦为发行人关联自然人。

3、直接持有发行人 5%以上股份的股东

序号	股东名称	持股数额（股）	持股比例（%）
1	臻蕴投资	171,142,853	36.21
2	HKSCC NOMINEES LIMITED	45,999,499	9.73
3	广谐投资	43,249,099	9.15
4	广生投资	28,832,734	6.10
5	广财投资	28,832,734	6.10

注：HKSCC NOMINEES LIMITED 即香港中央结算（代理人）有限公司，为公司 H 股非登记股东所持股份的名义持有人，其持有的 H 股股份为代表多个客户持有。

4、发行人董事及高级管理人员

董事	董事长：肖红星先生 非独立董事：刘锦婵女士、曾红女士、彭镜辉先生（职工代表董事）

	独立董事：陈丽梅女士、施凌先生、张瑾女士
高级管理人员	总经理：曾红女士 副总经理：黎钦源先生、曾杨清先生、王峻先生 董事会秘书：曾杨清先生 财务总监：贺剑青女士

发行人董事和高级管理人员关系密切的家庭成员亦为发行人的关联自然人。

5、发行人的全资和控股子公司

截至 2026 年 6 月 30 日，公司控股子公司情况参见本募集说明书之“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况”之“（二）合并报表范围及其变化情况”之“1、报告期末合并报表范围”。

6、发行人的联营企业

该联营企业具体如下：

名称	九派宏涛新兴产业创业投资基金（苏州）合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91320507MAERWKPU0R
注册地址	江苏省苏州市相城区高铁新城南天成路 24 号傲英大厦 3 楼 E 区-E21 工位（集群登记）
类型	有限合伙企业
注册资本	9,007 万元
执行事务合伙人	深圳市九派资本管理有限公司（委派代表：黄焜）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立日期	2025 年 8 月 11 日
营业期限	2025 年 8 月 11 日 至 2035 年 8 月 10 日
发行人持股比例	33.3074%

7、关联自然人直接或间接控制的、或者担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其子公司以外的法人或其他组织

序号	关联方名称	关联关系
1	湖北优尼科光电技术股份有限公司	实际控制人控制的其他企业
2	东莞市优尼特化学有限公司	实际控制人控制的其他企业
3	湖北广华化工有限公司	实际控制人控制的其他企业
4	东莞秀博电子材料有限公司	实际控制人控制的其他企业

序号	关联方名称	关联关系
5	东莞市广华化工有限公司	实际控制人控制的其他企业
6	东莞市广华环保技术有限公司	实际控制人控制的其他企业
7	广州臻达投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的其他企业
8	东莞市广弘微电子材料有限公司	实际控制人控制的其他企业
9	广华国际有限公司	实际控制人控制的其他企业
10	东莞市广华实业投资有限公司	实际控制人控制的其他企业
11	SUPERB ELECTRONIC MATERIALS (THAILAND) CO., LTD.	实际控制人控制的其他企业
12	易安爱富（武汉）科技有限公司	实际控制人肖红星担任董事的企业
13	深圳市智软通科技有限公司	实际控制人肖红星担任董事的企业
14	优科智辉创业投资（深圳）有限公司	董事兼总经理曾红之配偶赵敏智控制的企业
15	深圳鑫智辉教育服务企业（有限合伙）	董事兼总经理曾红之子赵振辉控制的企业
16	广东保伦电子股份有限公司	独立董事陈丽梅担任独立董事的企业
17	黄埔文化（广州）发展集团有限公司	独立董事陈丽梅担任董事的企业
18	知远创新有限公司	独立董事施凌担任董事的企业
19	宏宇创新有限公司	独立董事施凌担任董事的企业
20	平天创新（池州）科技有限公司	独立董事施凌控制的企业
21	上海广联信息科技有限公司	独立董事张瑾担任董事的企业
22	上海颖展商务服务有限公司	独立董事张瑾担任董事的企业

8、比照关联方披露的企业

报告期内公司与实际控制人参股的企业存在应付账款的情形，基于谨慎性的原则，将该等企业比照关联方进行披露，具体情况如下：

序号	名称	关联关系
1	东莞市龙博自动化设备有限公司	实际控制人肖红星持股 5%的企业

9、报告期内曾经的关联方

序号	关联方名称	关联关系	状态
1	陈炯辉	2025 年 5 月 30 日起不再担任发行人副总经理	已离任
2	管术春	2025 年 8 月 6 日起不再担任发行人副总经理	已离任
3	黄金广	2024 年 5 月 20 日起不再担任发行人监事	已离任
4	薛婧	2025 年 5 月 16 日起不再担任发行人监事	已离任

序号	关联方名称	关联关系	状态
5	周智勇	2025 年 5 月 16 日起不再担任发行人监事	不再担任监事
6	李莹	2026 年 6 月 18 日起不再担任发行人独立董事	已离任
7	深圳市优益创富投资企业（有限合伙）	实际控制人曾控制的企业	已于 2023 年 4 月 11 日注销
8	深圳市优显创富投资企业（有限合伙）		已于 2023 年 4 月 12 日注销
9	信加信（广州）企业投资顾问有限公司	已离职独立董事李莹控制的企业	存续
10	上海纯煜信息科技有限公司	独立董事张瑾曾担任执行董事的企业	已于 2026 年 1 月 19 日注销

（二）报告期内主要关联交易情况

1、重大关联交易判断标准

参照《深圳证券交易所股票上市规则》及《关联交易制度》等相关规定，公司的重大关联交易主要包括：（1）与关联自然人发生的成交金额超过 30 万元的交易；（2）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额超过 300 万元，且占公司最近一年经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。

2、一般关联交易

（1）经常性关联交易

1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司存在向秀博电子、广华环保采购商品、接受劳务的情况。其中，秀博电子系广华化工（业内知名的 PCB 化学药水生产企业）控股子公司，位于广东省东莞市，距离公司较近，运输成本较低，广华环保具有蚀刻废液铜回收技术，具体情况如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月发生额	2025 年度发生额	2024 年度发生额	2023 年度发生额
东莞秀博电子材料有限公司	采购药水	766.25	1,792.08	1,454.81	1,097.45
东莞市广华环保技术有限公司	采购药水、技术服务	959.99	1,291.02	668.57	578.65

2）关键管理人员报酬

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月发生额	2025 年度发生额	2024 年度发生额	2023 年度发生额
关键管理人员报酬	1,185.92	2,298.79	2,232.81	2,083.10

（2）偶发性关联交易

1）关联担保情况

①本公司作为被担保方

2026 年 1-6 月，公司不存在作为被担保方的担保情况。

2025 年，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
肖红星	1,335.59	票据开立日起 6 个月	是	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行授信
肖红星、刘锦婵	9,538.20	2022/9/1-2025/8/1	是	中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行固定资产贷款
肖红星	2,000.00	2024/11/25-2025/7/24	是	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行流动资金借款
肖红星	1,500.00	2024/4/15-2025/4/15	是	花旗银行（中国）有限公司广州分行借款
肖红星	1,500.00	2024/5/15-2025/5/15	是	花旗银行（中国）有限公司广州分行借款
肖红星	1,400.00	2024/9/14-2025/6/27	是	花旗银行（中国）有限公司广州分行借款
肖红星	2,000.00	2025/2/26-2025/7/24	是	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行流动资金借款
肖红星、刘锦婵	7,164.33	2022/11/8-2025/6/4	是	招商银行股份有限公司广州分行固定资产贷款
肖红星、刘锦婵	2,000.00	2024/12/27-2025/5/9	是	汇丰银行（中国）有限公司广州分行借款
肖红星、刘锦婵	82.50	每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月	是	浦银金融租赁股份有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	796.74	每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月	是	招银金融租赁有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	2,237.06	票据开立日起 6 个月	是	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	11,402.39	票据开立日起 6 个月	是	平安银行股份有限公司广州分行授信
肖红星	4,761.73	票据开立日起 6 个月	是	招商银行股份有限公司黄石分行授信
肖红星	834.93	信用证开立日起一年	是	招商银行股份有限公司黄

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
				石分行授信
肖红星、刘锦婵	15,376.99	2023/3/29-2025/6/10	是	平安银行股份有限公司广州分行固定资产贷款

2024 年，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
肖红星	2,000.00	2024/11/25-2025/11/24	否	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行流动资金借款
肖红星	4,400.00	借款提款日起一年	否	花旗银行（中国）有限公司广州分行授信
肖红星	1,780.79	票据开立日起 6 个月	否	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行授信
肖红星	6,312.70	票据开立日起 6 个月	否	招商银行股份有限公司黄石分行授信
肖红星	725.34	信用证开立日起一年	否	招商银行股份有限公司广州分行授信
肖红星	1,407.64	信用证开立日起一年	否	中国民生银行股份有限公司广州分行授信
肖红星	1,668.44	信用证开立日起一年	否	招商银行股份有限公司黄石分行授信
肖红星	10,902.20	票据开立日起 6 个月	是	招商银行股份有限公司黄石分行授信
肖红星	691.00	信用证开立日起一年	是	中国民生银行股份有限公司广州分行授信
肖红星	2,789.27	信用证开立日起一年	是	中信银行股份有限公司广州分行营业部授信
肖红星	4,500.28	信用证开立日起一年	是	招商银行股份有限公司黄石分行授信
肖红星、刘锦婵	7,164.33	2022/11/8-2025/11/29	否	招商银行股份有限公司广州分行固定资产贷款
肖红星、刘锦婵	10,367.60	2022/9/1-2031/3/10	否	中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行固定资产贷款
肖红星、刘锦婵	9,708.48	2023/3/29-2028/6/1	否	平安银行股份有限公司广州分行固定资产贷款
肖红星、刘锦婵	2,000.00	2024/12/27-2025/12/26	否	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	82.50	每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月	否	浦银金融租赁股份有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	796.74	每批租赁物转让价款支付之日起 36 个月	否	招银金融租赁有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	2,237.06	票据开立日起 6 个月	否	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
肖红星、刘锦婵	11,446.99	票据开立日起 6 个月	否	平安银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	2,109.59	信用证开立日起一年	否	招商银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	49,180.56	票据开立日起 6 个月	是	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	38,934.79	票据开立日起 6 个月	是	招商银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	7,325.10	信用证开立日起一年	是	招商银行股份有限公司广州分行授信

2023 年，公司作为被担保方的关联担保情况如下：

单位：万元、万美元

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
肖红星、刘锦婵	28,380.00	2020.9.30 至债务到期日后两年或退款日后两年	是	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	5,500.00 USD269.50	2021.2.4 至债务履行期届满之后两年	否	星展银行（中国）有限公司广州分行授信
	10,000.00 USD70.00	2022.2.25 至债务履行期届满之后三年	否	
	5,500.00 USD275.00	2023.3.23 至主债务履行期限届满之日后三年止	否	
肖红星、刘锦婵	USD750.00	2021.1.22 至债务和本担保函项下的应付金额被不可撤销的全额偿付并且与债务相关的所有协议终止	否	花旗银行（中国）有限公司广州分行授信
	USD750.00	2023.4.21 至最后一个还款日或提前终止应付额付款日之日后三年止	否	
肖红星、刘锦婵	20,000.00	2021.9.28 至 2024.9.27	否	招商银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	7,000.00	2021.11.18 至债务到期日另加三年	否	招商银行股份有限公司黄石分行
肖红星、刘锦婵	根据 10,000.00 的贷款额度发放的贷款、议付款本金及相应利息、罚息、复息、违约金和迟延履行金	2022.11.8 至债务到期之日起另加三年	否	招商银行股份有限公司广州分行固定资产贷款
肖红星、刘锦婵、广州臻蕴投资有限公司	15,000.00	2020.2.21 至 2025.2.21	否	中国建设银行股份有限公司东莞分行授信
肖红星、刘锦婵	13,500.00	2020.2.26 至 2023.2.25	是	中国农业银行股份有限公司东莞道滘支行授信

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
肖红星、刘锦婵	6,250.00	2021.3.12 至债务履行期届满之后两年	否	中国农业银行股份有限公司广州经济技术开发区支行授信
肖红星、刘锦婵	担保的最高债权 7,500.00	2022.3.21 至主债务履行期限届满之日后三年止	否	交通银行股份有限公司广东省分行授信
肖红星、刘锦婵	债权本金 10,000.00 和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和	2022.2.28 至 2023.2.11	是	中信银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	5,000.00	2022.3.10 至主合同项下债务履行期限届满之后两年	否	招银金融租赁有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	8,000.00	2022.12.29 至主合同项下债务履行期限届满之后两个日历年	否	浦银金融租赁股份有限公司融资租赁
肖红星	5,320.00	2022.4.26 至主合同项下债务履行期限届满之后两年	否	平安国际融资租赁有限公司融资租赁
肖红星、刘锦婵	最高担保额度 28,000.00	2022.9.1 至主合同项下借款到期日之次日起三年	否	中国工商银行股份有限公司东莞道滘支行授信
肖红星、刘锦婵	最高债权本金 12,000.00 及主债权的利息及其他应付款项之和	2022.8.19 至主合同债务履行期届满日起三年	否	中国民生银行股份有限公司广州分行授信
肖红星	最高债权本金 15,000.00 及主债权的利息及其他应付款项之和	2023.3.21 至主债务履行期限届满之日后三年止	否	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行授信
肖红星、刘锦婵	债权本金 23,400.00 和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和	2023.3.23 至主债务履行期限届满之日后三年止	否	平安银行股份有限公司广州分行固定资产贷款
肖红星	债权本金 10,000.00 和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行	2023.08.17 至主债务履行期限届满之日后三年止	否	中信银行股份有限公司广州分行授信

担保方	金额	期限	担保是否已经履行完毕	担保事项
	期间的债务利息、延迟履行金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用和其他所有应付的费用之和			
肖红星	5,000.00	2023 年 12 月 19 日至债务到期日起三年	否	汇丰银行（中国）有限公司广州分行授信

②本公司作为担保方

报告期内，公司不存在对全资及控股子公司以外的其他关联方主体提供担保。

2）股权交易

2023 年 6 月 2 日，肖红星与广合控股签订转让协议，肖红星将持有的泰国广合 1%的股权（尚未实缴出资）以 0 元对价转让给广合控股，并依照泰国法律办理了工商变更登记。

（三）关联交易应收应付账款余额

1、关联方应收项目

报告期内，公司与关联方之间不存在应收项目。

2、关联方应付项目

单位：万元

项目名称	关联方	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应付账款	东莞市广华化工有限公司	-	-	-	3.83
	东莞市龙博自动化设备有限公司	-	-	1.14	1.14
	东莞秀博电子材料有限公司	699.60	607.75	583.12	694.15
	东莞市广华环保技术有限公司	-	305.59	-	18.00
其他应付款	东莞市广华环保技术有限公司	308.97	-	141.52	57.79

（四）关联交易的公允性、必要性及对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司各期发生的关联采购交易金额分别占当期营业成本的比例较低，对

公司财务状况和经营成果影响较小。相关交易基于发行人日常生产经营需要而发生，系正常的市场行为，符合发行人的实际经营和发展需要，具有必要性。相关交易定价按照市场价格协商确定，遵循平等互利原则，具有公允性。

（五）独立董事对关联交易的意见

公司已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》中明确了关联交易决策的程序。报告期内，公司发生的关联交易已履行相关关联交易审议程序。

独立董事对公司报告期内发生的关联交易进行了审查，公司董事会在审议该等议案时，关联董事均履行了回避表决程序，表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；报告期内，公司发生的关联交易内容真实，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在通过关联交易操纵公司利润的情况。

（六）关联交易的决策程序

发行人已在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》中，明确规定了董事会与股东会在关联交易事项上的审批权限，并建立了关联董事、关联股东在相关事项审议中的回避表决机制。上述制度保障了关联交易决策程序的合法性，能有效地规范关联交易。

（七）公司为规范和减少关联交易而采取的措施

公司根据相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《关联交易管理制度》。今后，公司将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》中关于关联交易的规定，减少不必要的关联交易。公司控股股东、实际控制人分别以书面形式向公司出具了《减少和规范关联交易的承诺函》。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的募集资金总额不超过 360,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金
1	云擎智造基地项目（二期）	198,359.09	185,000.00
2	高多层印制电路板项目	155,992.17	100,000.00
3	补充流动资金	75,000.00	75,000.00
合计		**429,351.26**	**360,000.00**

在本次发行 A 股可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

项目投资总额高于本次募集资金净额部分由公司以自有资金或自筹方式解决。在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的具体金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司专业从事印制线路板研发、生产和销售，产品以多层板和 HDI 为主，广泛用于 AI 服务器、数据中心、新一代通信技术、工业控制、汽车电子及消费电子等领域，产品获得戴尔、鸿海精密、广达电脑等终端品牌或知名客户的认证。

本次向不特定对象发行的募集资金在扣除发行费用后拟用于云擎智造基地项目（二期）、高多层印制电路板项目以及补充流动资金。募集资金投向围绕公司 PCB 主业，布局高多层板及高阶 HDI 产能，升级装备能力，创新生产技术和工艺，以打造引领行业的创新产品，满足人工智能 AI 服务器及终端、GPU 芯片、高频高速传输等卡脖子领域的高等级要求，有利于提升公司的核心竞争力，不属于开拓新产品、新业务。补充流动资金有利于增强公司资金实力，优化财务结构，提升财务健康度水平。

三、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）云擎智造基地项目（二期）

1、项目概况

本项目拟投资 198,359.09 万元，拟使用本次向不特定对象发行 A 股可转债募集资金 185,000.00 万元。本项目拟购置高端 PCB 生产、检测及配套设备，扩大用于服务器领域的高多层板、高阶 HDI 板等产品的生产能力，满足行业技术升级需求，完善区域产能布局，增强公司综合竞争力。项目建成后，可新增高多层板及高端 HDI 板产能 11.15 万平方米/年。

本项目由广合科技实施。项目建设期为 12 个月，投资构成如下：

单位：万元

序号	科目名称	金额	占比
一	**建设投资**	**191,034.67**	**96.31%**
1.1	设备投入	185,470.55	93.50%
1.2	基本预备费	5,564.12	2.81%
二	**铺底流动资金**	**7,324.42**	**3.69%**
合计		**198,359.09**	**100.00%**

2、项目实施的必要性

（1）满足市场需求，扩大供应能力

当前人工智能与数字经济加速发展，全球算力基础设施建设全面提速，AI 服务器市场迎来高速增长。据 Trend Force 数据，2024 年全球 AI 服务器出货量较 2023 年增长 40%，达 165.5 万台，预计到 2026 年将增长至 241.3 万台，2022-2026 年复合增长率达 28.8%。AI 服务器产业的扩张，将大幅拉动高多层板、高阶 HDI 板等算力类 PCB 产品需求。

公司目前已在服务器领域完成一定的产品布局，如完成了搭载 PCIe 6.0 平台的高速主板产品的转批量能力，在数据中心交换机领域完成了 400G/800G 交换机 PCB 板的量产等。伴随下游头部客户采购需求持续放量，公司亟需加大资本与产能投入，进一步扩充供应能力，以匹配市场需求。本次项目建成后，公司将新增人工智能高阶 HDI、高多层板合计年产 11.15 万平方米的生产能力，可全面匹配行业规模化采购需求，助力公司抢抓算力产业发展红利，进一步提升高端算力 PCB 产品的市场占有率。

（2）满足行业技术升级需求，提升柔性生产能力

作为电子信息产业的核心基础部件，印制电路板深度赋能人工智能、高性能计算、6G 通信、低轨卫星等前沿领域，行业技术迭代持续提速。尤其在 AI 服务器领域，算力与数据交互需求持续攀升，推动 PCB 向高层数、高集成、高速传输方向演进。面向人工智能的高端电路板，在叠层设计、精密加工、原材料选型、长期可靠性等方面的管控标准远高于传统产品，行业技术升级诉求愈发迫切。与此同时，下游终端产品更新迭代速度加快，高多层板的叠层方案、层数配比、布线规格等产品参数呈现快速变化的特征，下游客户会基于产品迭代、硬件升级需求，频繁调整 PCB 设计方案，这对行业厂商的快速换线、产线灵活调配等柔性生产能力提出了更高要求。

公司深耕 PCB 制造领域多年，拥有成熟完备的生产体系与制造经验。但现有部分早期产线基于传统标准化大批量模式设计，设备与制程通用性有限，面对高端高多层板复杂工艺、频繁的规格调整需求时，产线换线效率不足，柔性调配能力存在提升空间，一定程度制约了高端产品拓展与业务规模增长。本次项目拟引进先进工艺设备与精密检测设备，一方面可全面匹配行业高端制造与技术升级要求，夯实高端产品制造能力；另一方面将大幅提升产线快速换线与柔性调配水平，从容应对客户产品规格快速变更的需求，全面强化综合生产竞争力。

（3）完善产能布局，提升竞争能力

公司深耕高端 PCB 领域多年，已形成广州、黄石两大国内生产基地及泰国海外生产基地的全球化产能布局体系，并同步推进云擎智造基地一期建设落地。公司国内两大生产基地既可为海外客户供货，产品远销东南亚、欧洲、美洲等区域，同时也可满足国内市场的生产交付需求，已具备较为稳定的全球化供货与交付保障能力。

近年来，全球算力产业蓬勃发展，促进高端服务器市场持续扩容，高端算力 PCB 产品市场需求空间亦进一步扩大。受现有生产基地布局限制，公司无法充分抢抓广阔的算力 PCB 市场发展机遇，产能布局仍存在不足，市场服务能力有待进一步提升。本项目的实施能够有效优化订单交付效率，补强生产及技术服务能力，增强公司在高端算力 PCB 领域的综合竞争力。

3、项目实施的可行性

（1）市场前景广阔，项目实施具备良好的市场基础

算力、通信等下游产业持续景气，有效拉动全球及国内 PCB 产品需求稳步扩张。从行业整体市场规模来看，据 Prismark 2026 年第一季度报告数据，2025 年全球 PCB 市场规模为 858.36 亿美元，中国大陆 PCB 市场规模同步攀升至 496.52 亿美元，预计 2030 年全球 PCB 市场规模将增至 1,446.10 亿美元，中国大陆 PCB 市场规模有望达到 817.64 亿美元，行业整体增长动能强劲。从下游细分领域来看，算力基础设施建设将促进 PCB 细分市场结构优化，服务器/数据存储类 PCB 产品增长表现突出。据 Prismark 数据，2025 年该类产品全球市场规模为 159.75 亿美元，增速为 46.3%，预计 2029 年市场规模将达 257.29 亿美元，增长动力来自 AI 服务器升级与数据中心设备扩容。在人工智能服务器及高速网络需求带动下，HDI 板及高层数多层板等高端产品占比将持续提升，行业逐步向高层数、高频高速及高可靠性方向发展。综上，行业及下游应用广阔的市场前景，为本项目顺利实施奠定市场基础。

（2）项目实施具备坚实的技术支撑

公司为国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心、广东省高频高速印制线路板等多个省级研发平台，下设专业研究院，搭建材料应用与研究实验室、产品研发组、创新工艺研究组等研发单元。依托强大研发实力，公司已成功打造适配 GPU 主板、阶梯 HDI 服务器加速卡、OAM 板的高多层板、HDI 板等一系列核心产品，形成完整技术体系，其中“服务器主板用印制电路板”获评国家级制造业单项冠军产品、“用于高性能计算（HPC）的大 BGA 服务器主板”获广东省高新技术协会科技进步奖二等奖、“AI 服务器超高阶高多层复合基板项目”获得中国电子学会科技进步奖三等奖等。公司围绕各类型服务器印制电路板研发积淀多项核心技术，构建起自有知识产权体系，同时配套形成高精度量产制程能力，现阶段已成熟掌握背钻精度管控、超高厚径比电镀、精密阻抗匹配控制等关键工艺技术。综上，公司已具备较为坚实的技术积累，为本项目的顺利实施提供了技术基础。

（3）良好的口碑及优质的客户资源保障本项目产能消化

公司凭借过硬的产品品质、同步研发能力与高效服务体系，已与全球头部服务器品牌及 EMS 厂商建立长久稳固的合作关系，合作范围覆盖全球前十大服务器制造商中的

八家。凭借稳定的供货能力、及时的技术响应以及深度协同的新品开发服务，公司先后斩获“年度优秀供应商”“最佳供应商”“完美质量奖”等多项荣誉，在 PCB 领域树立了良好的品牌口碑。同时公司持续拓宽客户边界，积极布局消费电子、工业控制、安防电子、通信、汽车电子等领域，客户群体多元化发展，合作关系较为稳定。综上，在行业内较好的客户口碑和优质的客户资源，为本项目产能消化奠定客户基础。

4、项目的实施准备和进展情况

本项目拟在广合科技已有场地实施，不涉及新增土地。截至本募集说明书签署日，本项目已完成投资项目备案（备案号：2608-440116-07-02-188799 号），并已取得广州开发区行政审批局关于项目环境影响报告表的批复，批复文号为穗开审批环评〔2025〕189 号。

5、预计实施时间及整体进度安排

本项目预计建设期为 12 个月，项目的工程建设周期计划分 5 个阶段实施完成，包括：可行性研究、初步规划与设计、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。项目建设进度安排，具体如下：

阶段/时间（月）	T+12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可行性研究												
初步规划、设计												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运营												

本次发行拟募集 185,000.00 万元用于云擎智造基地项目（二期），由于募集资金低于项目投资金额，因此，募集资金到账后，公司将结合项目建设进度以及资金情况合理统筹安排募集资金的投入。

本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，也不存在置换董事会前已投入资金的情形。

6、项目经济效益及主要计算过程

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率为 18.22%（所得税后），预计静态投

资回收期（所得税后）为 6.08 年（含建设期 1 年）。

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场及募投项目本身产品情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，经营期年均预计销售收入为 241,950.59 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目主营业务成本根据公司报告期内现有同类产品毛利率情况，同时结合募投项目具体产品类型情况综合预估，达产年毛利率为 26.18%。销售费用、管理费用及研发费用参考公司历史费用率水平测算。

（3）税金及附加

本项目硬件产品增值税税率 13%；城建税及教育费附加（含地方教育费附加）各按实交流转税的 7%和 5%征收；实施主体所得税率 15%。

（二）高多层印制电路板项目

1、项目概况

本项目拟投资 155,992.17 万元，拟使用本次向不特定对象发行 A 股可转债募集资金 100,000.00 万元。本项目主要拟引进适配高多层板产品的高精度、高自动化新型设备及配套装置。本项目完成后，将显著提升公司整体制造能力、产品品质与产品附加值，充分满足下游客户高端产品订单需求。项目建成后，可新增高多层板产能 12.00 万平方米/年。

本项目由广合科技实施。本项目建设期 1 年，投资构成如下：

单位：万元

序号	科目名称	金额	占比
一	**项目投资**	**153,358.90**	**98.31%**
1.1	场地投入	12,919.85	8.28%
1.2	设备投入	135,972.29	87.17%
1.3	基本预备费	4,466.76	2.86%
二	**铺底流动资金**	**2,633.27**	**1.69%**
合计		**155,992.17**	**100.00%**

2、项目实施的必要性

（1）顺应行业发展趋势，提升产品技术含量与附加值

当前国家大力培育和发展新质生产力，人工智能、6G 通信、云计算、大数据、智能网联汽车等新兴产业高速发展，为国内印制电路板行业带来重大发展机遇。AI 服务器作为算力核心整机设备，在 PCIe 6.0、NVLink、112G/224Gbps 等高速传输协议的迭代升级下，技术架构与配套组件持续演进，GPU 主板、AI 加速卡等关键硬件标准同步升级。对应搭载的高多层板各项技术指标日趋严苛，超细线路、深微孔、高精度阻抗控制等核心制造环节技术壁垒显著加深，同时对 PCB 板的层数、层间对位精度、多层压合工艺、层间导通稳定性等多高层板核心生产技术提出了极高要求，先进工艺与多高层板量产制造能力已成为行业竞争的核心要素。

公司现有部分产线工艺偏传统，不仅在超细线路、深微孔、高精度阻抗控制等前沿制造环节存在明显短板，同时核心产能及工艺集中于中低层 PCB 板生产，多高层板生产能力存在不足，难以适配 AI 算力、高端通信领域高多层 PCB 板的量产及品质要求。因此，公司将配套引进先进生产制程及专用工艺设备，改善生产条件、提升工艺水平，实现 PCB 产品加工精度、运行稳定性与综合性能的优化。本项目实施后，公司可全面适配行业技术发展要求，提高高多层板等高端 PCB 产品占比，提升产品附加值和单价，扩大高多层板的生产能力。

（2）淘汰老旧设备，提升产品品质

公司部分生产线投产运行年限较长，该等设备存在加工精度不足、运行稳定性弱化等问题，无法严格保障产品批次生产的一致性，直接造成了产品良率不稳定、生产损耗偏高。当前，下游服务器、高速通信、数据中心等高端领域头部客户，对 PCB 产品的加工精度、运行稳定性、批次统一性及全流程质量追溯能力制定了严苛的准入标准，高品质管控已成为企业进入核心供应链、维系长期战略合作的核心门槛。

本项目将批量引入适配高多层板等高端产品生产的智能化、高精度生产及检测设备。本项目实施后，可大幅提升核心生产工序的加工精度与标准化水平，有效提升产品生产良率、降低质量隐患与客诉风险，提升企业市场口碑与供应链竞争力。

（3）强化核心客户配套能力，增强合作粘性

下游 AI 服务器、数据中心、高速通信等领域核心客户业务规模持续扩张、产品持

续迭代，对上游 PCB 供应商的高端产能配套、稳定供货、品质保障及全周期服务能力要求持续提升。公司已与行业头部客户建立长期战略合作关系，但现有高端产能不足、配套体系有待完善，难以持续匹配核心客户的规模化、迭代化配套需求，不利于存量客户合作的稳定性与深度绑定。此外，当前高端 PCB 行业客户准入标准日趋严格，下游潜在优质客户在供应商筛选过程中，会重点考核企业高端产线配置、柔性生产能力、高端量产规模及技改升级潜力等因素，现有产线短板一定程度上制约了公司拓展优质客户。

本项目实施后，一方面可进一步匹配现有核心客户的产品升级、产能扩容需求，具备持续、稳定、迭代式的高端供货配套能力；另一方面可有效满足新增优质客户的供应商准入考核标准，提升公司整体硬件实力与配套资质，为后续开拓高端新客户、拓展新的市场资源、优化客户结构奠定坚实基础。

3、项目实施的可行性

（1）产业政策利好，项目建设契合国家产业导向

近年来，国家持续推动电子信息产业高端化、自主化转型升级，多部委先后出台多项扶持政策，为本次项目建设创造了良好的政策环境。

2023 年 12 月，“高密度互连印制电路板、特种印制电路板、柔性多层印制电路板”被列入国家统计局发布的《工业战略性新兴产业分类目录（2023）》；2025 年 9 月，工业和信息化部、国家市场监督管理总局联合发布《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》，提出加快人工智能服务器、高效存储等先进计算系统建设，同步强化整机与软硬件协同技术攻关；2026 年 1 月，工业和信息化部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。此外，《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》《印制电路板行业规范条件（2025 年本）》《电子信息制造业数字化转型实施方案》《数字中国建设整体布局规划》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《算力互联互通行动计划》及《产业结构调整指导目录（2024 年本）》等多项配套政策从多个维度支撑本行业健康稳定的发展。

（2）管理体系完善，项目具备较好的管理基础

公司高度重视生产经营过程中的精细化管理与成本管控工作，长期深耕 PCB 制造领域，已建立成熟完善的生产经营管理体系。公司持续推行精益生产与降本增效管理模

式，搭建了综合成本独立核算及评价体系，并配套建立系统化的数据收集、分析及考核激励机制，具备较强的成本控制与精细化运营能力。

公司建立了覆盖全业务链条的质量管理体系，严格按照体系要求制定供应商认证、物料检验、生产过程管控、订单管理及客户服务等全流程管控规范，并通过常态化内部审查与稽核机制，实现质量管理体系的有效落地与持续优化。同时，依托 ERP 数字化管理系统，公司可对物料采购、生产制造、检验入库、产品发货等各环节进行全程数据记录与动态追溯，为生产管控、质量分析与工艺优化提供可靠的数据支撑。

（3）优秀的团队为本项目提供人才支撑

公司组建了一支优秀精干的核心管理、生产与技术团队，核心成员均深耕 PCB 行业多年，在市场研判、技术研发、生产管控、品质管理等领域积淀深厚，精准把握行业发展规律与市场动态，可结合客户需求高效推动新技术、新产品落地应用。

公司研发人才队伍持续扩容、梯队结构不断优化。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员规模达 699 人，占员工总人数比例为 11.24%。同时公司建立了完善的人才培养、绩效考核与激励约束体系，具备灵活的人员调配能力，可从现有成熟生产基地抽调业务骨干指导本项目的建设和运营。

4、项目的实施准备和进展情况

本项目拟通过租赁全资子公司场地实施，不涉及新增土地。截至本募集说明书签署日，本项目已完成投资项目备案（项目代码：2607-440112-04-01-845920 号），并已取得广州开发区行政审批局关于项目环境影响报告表的批复，批复文号为穗开审批环评〔2026〕106 号。

5、预计实施时间及整体进度安排

本项目预计建设期为 12 个月，项目的工程建设周期计划分 6 个阶段实施完成，包括：可行性研究、初步规划与设计、场地租赁及装修、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营。项目建设进度安排，具体如下：

阶段/时间（月）	T+12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
可行性研究												
初步规划、设计												

阶段/时间（月）	T+12											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
场地租赁及装修												
设备采购及安装												
人员招聘及培训												
试运营												

本次发行拟募集 100,000.00 万元用于高多层印制电路板项目，由于募集资金低于项目投资金额，因此，募集资金到账后，公司将结合项目建设进度以及资金情况合理统筹安排募集资金的投入。

本次募集资金不包含董事会前投入的资金，未来募集资金到位后，也不存在置换董事会前已投入资金的情形。

6、项目经济效益及主要计算过程

根据测算，本项目建成后，项目内部收益率为 14.74%（所得税后），预计静态投资回收期（所得税后）为 6.76 年（含建设期 1 年）。

（1）营业收入预计

本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场及募投项目本身产品情况，并根据各年预计销量情况测算得出。项目建成后，经营期年均预计销售收入为 161,000.00 万元。

（2）营业成本及费用测算

本项目主营业务成本根据公司报告期内现有同类产品毛利率情况，同时结合募投项目具体产品类型情况综合预估，达产年毛利率为 26.01%。销售费用、管理费用及研发费用参考公司历史费用率水平测算。

（3）税金及附加

本项目硬件产品增值税税率 13%；城建税及教育费附加（含地方教育费附加）各按实交流转税的 7%和 5%征收；实施主体所得税率 15%。

（三）补充流动资金

1、项目概况

公司综合考虑了发展现状、经营战略、财务状况以及市场融资环境等自身和外部条件，拟将本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金中的 75,000.00 万元用于补充流动资金（占公司本次发行募集资金总额的 20.83%），以满足公司业务不断发展对营运资金的需求，进而促进公司主营业务健康良性发展，实现战略发展目标。

2、项目实施的必要性

本次募集资金投资项目顺利建成并投产运营后，公司产能规模将得到有效扩充，整体生产运营能力实现提质升级。随着产能释放与业务规模持续扩张，公司日常生产经营、原材料采购、订单交付等环节的营运资金占用将持续增加。同时，为稳固并进一步提升公司核心竞争力，持续跟进行业前沿技术迭代趋势，公司需持续加大新产品、新技术、新工艺的研发投入，不断完善产品体系、优化产品性能，持续巩固行业市场地位。

基于公司未来业务扩张、技术创新及市场拓展的整体发展规划，公司整体资金储备及资金实力面临更高的匹配要求。本次通过补充流动资金，能够精准覆盖公司关键环节的资金缺口，有效缓解业务发展过程中的资金压力，持续提升公司产品核心竞争力与综合经营实力，夯实公司规模化、高质量发展的业务基础，为公司中长期稳健经营、持续扩张筑牢资金保障，本次项目实施具备充分的必要性与合理性。

3、项目实施的可行性

本次公司发行证券募集资金用于补充流动资金，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等境内监管法律法规及行业规范性文件的相关要求，募集资金用途合规、程序合法，项目实施具备充分的政策可行性。

公司自成立以来，持续完善现代化企业经营管理体系，已构建规范健全的法人治理结构、完善的内部控制制度及标准化的经营管理机制，形成了权责清晰、管控到位、运行高效的公司治理格局与内控环境，能够为本次募集资金的规范使用提供完善的制度支撑与管理保障。

针对募集资金管理工作，公司已严格参照监管规则制定专项募集资金管理制度，对募集资金专户存储、使用审批、投向管理、监督核查等关键事项作出了全面、细化的制

度化规定。本次募集资金足额到位后，公司将严格遵守国家相关法律法规、监管规范性文件及内部管理制度要求，对募集资金实行专户管理、专款专用，规范履行资金使用审批流程，全程强化募集资金使用管控与监督，切实保障全体投资者的合法权益，确保募集资金合规、高效、合理使用，助力公司持续稳健发展，本次项目实施具备充分的可行性。

4、补充流动资金规模合理性分析

流动资金占用金额主要受公司经营性流动资产和经营性流动负债的影响，公司以经审计的 2025 年度营业收入及相关经营性流动资产和经营性流动负债占营业收入的比例为基础，按照销售百分比法，对构成公司日常生产经营所需流动资金的主要经营性流动资产（应收票据+应收账款+应收款项融资+预付款项+存货）和主要经营性流动负债（应付票据+应付账款+合同负债）分别进行估算，进而预测公司未来三年（2026 年-2028 年）生产经营对流动资金的需求量。

2023 年、2024 年及 2025 年，公司分别实现营业收入 267,827.03 万元、373,428.46 万元和 548,537.14 万元，2023 年至 2025 年的营业收入复合增长率为 43.11%。预测公司 2026 年-2028 年营业收入增长率为 43.11%。

营运资金需求=经营性流动资产-经营性流动负债；未来三年流动资金缺口=2028 年营运资金需求-2025 年营运资金需求。

经测算，公司未来三年流动资金缺口为 87,545.57 万元。上述假设及测算不代表公司对 2026 年-2028 年经营情况及趋势的判断，亦不构成对公司的盈利预测。

综上，公司未来三年流动资金缺口为 87,545.57 万元。本次发行拟使用募集资金中 75,000.00 万元用于补充流动资金具有合理性。

5、本次发行补充流动资金规模符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定

根据中国证监会发布的《证券期货法律适用意见第 18 号》之规定：“通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。”除“补充流动资金”外，本次募投项目拟使用募集资金投入的内容均为资本性支出，不存在非资本性支出的情况。本次募集资金中拟用于补充流动资金合计为 75,000.00 万元，占募集资金总额的比例为

20.83%，未超过募集资金总额的 30%，符合《证券期货法律适用意见第 18 号》的规定。

（四）本次发行符合国家产业政策

发行人所属行业为“398 电子元件及电子专用材料制造”之“3982 电子电路制造”，主营业务为印制电路板的研发、生产与销售，本次募集资金投向云擎智造基地项目（二期）和高多层印制电路板项目。根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本次募投项目涉及的高阶 HDI 板属于鼓励类所列“高密度互连积层板”，高多层板不属于限制类或淘汰类产业。本次募投项目未投向落后产能或产能过剩行业，亦不属于《市场准入负面清单（2025 年版）》规定的禁止准入类事项，符合国家产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的情形。

四、发行人的实施能力及资金缺口的解决方式

公司多年来专注于印制电路板产品的研发、生产和销售，积累了大量的技术与经验，具备较强的技术研发创新能力和生产管理能力，为项目的顺利实施提供保障。

在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

五、本次募集资金用于扩大既有业务的相关说明

（一）既有业务的发展情况

公司本次募集资金投资项目均围绕主营业务开展，是基于未来发展战略及行业市场机遇而实施，本次募投项目与公司既有业务密切相关。公司主要从事研发、生产及销售应用于算力服务器及其他算力场景的定制化 PCB。广合科技主要产品包括多层板和 HDI 板等，产品规格丰富，能满足不同客户群体的多样化需求。公司产品应用领域广泛，以算力场景为核心，并积极拓展工业场景及消费场景，不断扩大产品的市场覆盖范围。公司本次募投项目产品为已有产品，是在公司现有印制电路板业务基础上发展而来，在原有的应用领域基础上，更加聚焦 AI 服务器及算力等技术含量更高的新兴领域。

本次募投项目是对公司现有 PCB 业务的延伸和拓展，本次募投项目的产品、生产工艺及技术与发行人现有业务不存在重大差异。

（二）扩大业务规模的必要性

具体情况详见本节“三、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）云擎智造基地项目（二期）”之“2、项目实施的必要性”和“（二）高多层印制电路板项目”之“2、项目实施的必要性”。

（三）新增产能规模的合理性

优质的客户资源是公司持续快速发展的重要保障，经过多年的客户开拓和品牌打造，公司凭借先进的研发技术实力、优异的产品性能、稳定的产品交付质量和专业的客户服务，已积累了丰富的行业头部客户资源并获得客户的认可，与国内外众多知名厂商建立了长期稳定的合作关系。目前，公司已积累了包括戴尔、鸿海精密、广达电脑、英业达及浪潮集团等在内的全球行业头部优质客户资源。此外，公司持续加大力度开拓新型应用领域客户及海外市场客户，深度挖掘 AI 服务器、交换机等高端赛道应用场景，不断优化客户结构。

通过与行业头部客户紧密合作，公司能持续紧贴行业前沿技术趋势及市场最新动态，持续推动产品和技术的迭代创新，塑造了强大的品牌影响力，进一步巩固公司的市场地位。未来，公司将通过持续优化产品结构、提升服务质量，积极开拓新客户，不断壮大客户群体。

综上，凭借多年行业深耕，公司拥有优质的头部客户资源和强大的品牌影响力，为本项目新增产能的市场消化提供了有力支撑。

六、本次发行对公司的影响分析

（一）对公司经营管理的影响

公司本次发行募集资金投资项目主要围绕公司发展战略布局展开，与公司主营业务高度相关。项目实施完成后，公司在算力服务器领域的核心竞争力进一步增强，国际地位和业务规模持续提升，有利于提高公司主营业务盈利能力，促进公司的长期可持续发展，助推公司实现“打造智能互联领域的全球领导者”的目标。

（二）对公司财务状况的影响

本次发行将进一步扩大公司的资产规模，如本次发行的可转债逐步转股，公司的资产负债率将逐步降低，净资产提高，财务结构进一步优化，抗风险能力将得到提升。

新建项目产生效益需要一定的过程和时间，若本次发行的可转债转股较快，募投项目效益尚未完全实现，则可能出现每股收益等财务指标在短期内小幅下滑的情况。但是，随着本次募集资金投资项目的有序开展，公司的发展战略将得以有效实施，公司未来的盈利能力、经营业绩将会得到提升。

（三）新增大量固定资产或无形资产对发行人经营业绩的影响

本次募集资金投资项目建成后，公司的固定资产较本次发行前有较大规模的增加，由此带来每年固定资产折旧的增长。同时，由于本次募集资金投资项目建成后存在产能爬坡，市场逐步开拓的周期，虽然项目预计效益可以覆盖折旧摊销的影响，但募投项目建成后折旧与摊销费用的增加仍可能在短期内影响发行人的经营业绩。

第八节 历次募集资金运用

一、前次募集资金的数额和资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广合科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于广州广合科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2024〕239 号）同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,230.00 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.43 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 737,289,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 83,830,482.69 元后，实际募集资金净额为人民币 653,458,517.31 元。

上述募集资金到账时间为 2024 年 3 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 3 月 28 日出具了致同验字（2024）第 441C000092 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次 A 股 IPO 募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次 A 股 IPO 募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金总额：		65,345.85	已累计使用募集资金总额：		57,101.64
变更用途的募集资金总额：		-	2026 年 1-6 月使用募集资金总额：		13,037.95
变更用途的募集资金总额比例：		-			

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	66,810.52	47,552.18	39,307.97	66,810.52	47,552.18	39,307.97	-8,244.21	2027/4/1（注）
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	25,000.00	17,793.67	17,793.67	25,000.00	17,793.67	17,793.67	-	/
合计			**91,810.52**	**65,345.85**	**57,101.64**	**91,810.52**	**65,345.85**	**57,101.64**	**-8,244.21**	**/**

注：经公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议审议，将“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”项目达到预定可使用状态的日期延后至 2027 年 4 月 1 日。

（二）前次 A 股 IPO 募集资金实际投资项目变更情况

公司不存在前次 A 股 IPO 募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次 A 股 IPO 募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

前次A股IPO募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异如下：

单位：万元

序号	募集资金项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	原因说明
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	47,552.18	39,307.97	-8,244.21	项目建设中，资金尚未使用完毕
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	17,793.67	17,793.67	0.00	不适用

（四）前次 A 股 IPO 募集资金投资项目对外转让或置换情况

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了鉴证，并出具了致同专字（2024）第441A009832 号《关于广州广合科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。

此次募集资金到账前，公司已以自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至 2024 年 4 月 22 日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为 3,175.55 万元，公司以募集资金人民币 3,175.55 万元置换前述预先投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

项目名称	自筹资金预先投入金额	用募集资金置换投入
黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	3,175.55	3,175.55

（五）闲置募集资金情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，董事会同意公司使用不超过人

民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2024 年 5 月 20 日召开了股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，股东会同意公司使用不超过人民币 38,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，到期后归还至募集资金专用账户。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

公司于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第二十三次会议，公司及子公司拟使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品均为银行保本型产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得现金管理收益 1,060.78 万元，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，无尚未到期余额，并按照相关规定履行了信息披露义务。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次 A 股 IPO 募集资金投资项目实现效益情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次 A 股 IPO 募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（年税前利润）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
1	黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程	不适用	11,033.14	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（年税前利润）	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年		
2	广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

（二）前次 A 股 IPO 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次 A 股 IPO 募集资金投资项目中的“广州广合科技股份有限公司补充流动资金及偿还银行贷款”为公司生产经营提供支撑，无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2026 年 6 月 30 日，“黄石广合精密电路有限公司广合电路多高层精密线路板项目一期第二阶段工程”尚未达到预计可使用状态，不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况

公司前次发行不存在以资产认购股份的情形。

五、会计师对于前次募集资金运用所出具的报告结论

关于公司前次 A 股 IPO 募集资金运用，公司编制了前次募集资金使用情况的专项报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]519Z0036 号），认为：广合科技《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了广合科技截至 2026 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

肖红星	曾 红	刘锦婵
陈丽梅	张 瑾	施 凌
彭镜辉		

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

第九节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

肖红星	曾 红	刘锦婵
陈丽梅	张 瑾	施 凌
彭镜辉		

广州广合科技股份有限公司

2016 年 11 月 30 日

第九节 声明

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

肖红星	曾 红	刘锦婵
陈丽梅	张 瑾	施 凌
彭镜辉		

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

一、发行人及全体董事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体非董事高级管理人员签名

王 峻　　黎钦源　　曾杨清

贺剑青

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 10 日

一、发行人及全体董事会审计委员会成员声明

本公司及全体董事会审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事会审计委员会成员签名：

陈丽梅	刘锦婵	张瑾

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

一、发行人及全体董事会审计委员会成员声明

本公司及全体董事会审计委员会成员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事会审计委员会成员签名：

陈丽梅	刘锦婵	张瑾

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

二、实际控制人声明

本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

实控人签名：

肖红星　　刘锦婵

2026 年 11 月 20 日

二、控股股东声明

本公司承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东（盖章）：广州臻缊投资有限公司

法定代表人(签字)：

肖红星

广州广合科技股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

三、保荐机构（主承销商）声明

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

保荐代表人：

潘绍明 梁家健

项目协办人：

杨颖欣

法定代表人：

张佑君

中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

保荐机构总经理声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

总经理：

邹迎光

中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

保荐机构董事长声明

本人已认真阅读募集说明书的全部内容，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

董事长：

邹迎光

中信证券股份有限公司

2026 年 11 月 20 日

四、律师事务所声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：

蒋鹏

杨蓉

祖岳灏

律师事务所负责人：

沈国权

上海市锦天城律师事务所

2026 年 11 月 20 日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、内部控制审计报告、前次募集资金使用情况鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表等无矛盾之处。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

杨敢林 林庆涛

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2026 年 11 月 20 日

六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字评级人员：游云星 焦玉如

资信评级机构负责人/授权代理人：张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2026 年 1 月 20 日

七、发行人董事会关于本次发行的声明及承诺

（一）关于除本次发行可转换公司债券外未来十二个月内其他股权融资计划，发行人董事会作出如下声明

自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。

（二）发行人董事会按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺

为使公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事承诺如下：

“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺出具日后至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”

（三）发行人按照国务院和中国证监会相关规定，对公司填补回报的具体措施作出如下声明

本次发行可能导致投资者的即期回报有所摊薄，为了保护投资者利益，公司拟采取多种措施提升公司竞争力以填补股东回报，具体的措施包括：

1、加强募集资金管理，推进募投项目建设

公司董事会已对本次向不特定对象发行可转债的可行性进行了充分论证，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家有关产业政策和行业发展趋势，符合公司以技术创新为核心驱动力的发展理念，募投项目具有较好的市场前景和预期效益。

本次发行募集资金到位后，公司将根据相关法规和公司募集资金管理制度的要求，严格规范募集资金的存放和使用，以保证募集资金得到合理规范使用。公司亦将按期推进募投项目的建设，争取早日实施并实现预期效益。

2、加强经营管理和内部控制建设，提高经营效率

公司将不断完善治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益。公司将持续提高经营和管理水平，加强内部控制，发挥企业管控效能；加强成本管理，强化预算执行监督，在严控各项费用的基础上，提升经营和管理效率、控制经营和管理风险，提升整体经营效率和盈利能力。

3、进一步完善并严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制

为进一步完善公司利润分配政策，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关文件的要求，结合公司制定的《广州广合科技股份有限公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》，本次向不特定对象发行可转债完成后，公司将继续严格执行公司分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极给予投资者合理回报，确保公司股东特别是中小股东的利益得到切实保障。

本次可转债发行完成后，公司将持续完善法人治理结构，合理规范使用募集资金，提高资金使用效率，加快募投项目实施进度，尽快实现项目预期效益。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

（以下无正文）

（此页无正文，为本募集说明书《发行人董事会关于本次发行的声明及承诺》之盖章页）

广州广合科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 20 日

第十节 备查文件

一、备查文件内容

（一）发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

（三）法律意见书和律师工作报告；

（四）董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

（五）资信评级报告；

（六）其他与本次发行有关的重要文件。

二、备查文件查询时间及地点

投资者可在发行期间每周一至周五上午九点至十一点、下午三点至五点，于下列地点查阅上述文件：

（一）发行人：广州广合科技股份有限公司

办公地址：广东省广州市保税区保盈南路 22 号

联系人：曾杨清

电话：020-82211188-2885

传真：020-82210929

（二）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

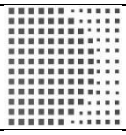
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号

联系人：潘绍明、梁家健

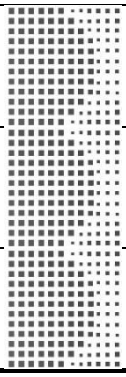
电话：010-60836030

投资者亦可在公司的指定信息披露网站（https://www.szse.cn）查阅本募集说明书全文。

附件一：广合科技及其控股子公司持有的主要注册商标

序号	权利人	商标名称	类别	注册号	有效期	取得方式	他项权利
1	广合科技	广合	第 7 类	25282369	2018/07/07-2028/07/06	原始取得	无
2	广合科技	广合科技	第 7 类	25284591	2018/07/07-2028/07/06	原始取得	无
3	广合科技	Delton	第 7 类	25296248	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
4	广合科技	广合科技	第 35 类	25288403	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
5	广合科技	广合	第 38 类	25278626	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
6	广合科技	广合科技	第 9 类	25286073	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
7	广合科技	广合	第 9 类	25282381	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
8	广合科技	广合	第 42 类	25281625	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
9	广合科技	广合科技	第 42 类	25280890	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
10	广合科技	广合科技	第 38 类	25280201	2018/09/21-2028/09/20	原始取得	无
11	广合科技	guanghe	第 7 类	25292396	2018/10/14-2028/10/13	原始取得	无
12	广合科技	guanghe	第 9 类	25290829	2018/10/14-2028/10/13	原始取得	无
13	广合科技	guanghe	第 42 类	25289255	2018/10/14-2028/10/13	原始取得	无
14	广合科技	Delton	第 7 类	25288997	2018/10/14-2028/10/13	原始取得	无
15	广合科技	DTIDelton	第 9 类	32748765	2019/04/14-2029/04/13	原始取得	无
16	广合科技	DTIDELTON	第 9 类	32730724	2019/04/14-2029/04/13	原始取得	无
17	广合科技	BTIDelton	第 9 类	32739178	2019/04/14-2029/04/13	原始取得	无
18	广合科技	BTIDELTON	第 9 类	32737627	2019/04/14-2029/04/13	原始取得	无
19	广合科技		第 7 类、第 9 类	47852386	2021/02/21-2031/02/20	原始取得	无
20	广合科技	DELTON	第 7 类	49141480	2021/06/21-2031/06/20	原始取得	无
21	广合科技	DELTON	第 9 类	49121407	2021/08/21-2031/08/20	原始取得	无

序号	权利人	商标名称	类别	注册号	有效期	取得方式	他项权利
22	广合科技	广合	第 1 类	78171170	2024/10/14-2034/10/13	原始取得	无
23	广合科技	广合	第 40 类	78181138	2024/10/28-2034/10/27	原始取得	无
24	广合科技	广合科技	第 42 类	78155418A	2024/11/14-2034/11/13	原始取得	无
25	广合科技	广合	第 42 类	78166620A	2024/11/14-2034/11/13	原始取得	无
26	广合科技	广合科技	第 1 类	78169665	2024/10/07-2034/10/06	原始取得	无
27	广合科技	广合科技	第 40 类	78155336	2024/10/07-2034/10/06	原始取得	无
28	广合科技		第 1 类	78180825	2024/12/28-2034/12/27	原始取得	无
29	广合科技	DELTON	第 40 类	78161326	2025/01/07-2035/01/06	原始取得	无
30	广合科技	DELTON	第 1 类	78167999	2025/02/28-2035/02/27	原始取得	无
31	广合科技	DELTON	第 9 类	54231625	2021/10/21-2031/10/20	原始取得	无
32	广合科技	广合科技	第 42 类	78155418	2025/10/14-2035/10/13	原始取得	无
33	广合科技	广合	第 42 类	78166620	2025/10/14-2035/10/13	原始取得	无
34	广合科技	DELTON	第 42 类	78174643	2025/11/28-2035/11/27	原始取得	无
35	广合科技	BTI	第 7 类、第 9 类、第 42 类（泰国）	251111205	2024/7/17-2034/7/16	原始取得	无
36	广合科技	BTI	第 7 类、第 9 类、第 42 类（泰国）	251111253	2024/7/17-2034/7/16	原始取得	无
37	广合科技		第 7 类、第 9 类、第 42 类（中国香港）	306877081	2025/4/22-2035/4/21	原始取得	无
38	广合科技	DELTON	第 7 类、第 9 类、第 42 类（中国香港）	306877261	2025/4/22-2035/4/21	原始取得	无
39	广合科技	广合科技	第 7 类、第 9 类、第 42 类（中国香港）	306877270	2025/4/22-2035/4/21	原始取得	无
40	广合科技	DELTON	第 9 类（中国台湾）	02457488	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
41	广合科技	DELTON	第 42 类（中国台湾）	02459556	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无

序号	权利人	商标名称	类别	注册号	有效期	取得方式	他项权利
42	广合科技	广合科技	第 7 类（中国台湾）	02457310	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
43	广合科技	广合科技	第 9 类（中国台湾）	02457489	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
44	广合科技	广合科技	第 42 类（中国台湾）	02459557	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
45	广合科技		第 7 类（中国台湾）	02457311	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
46	广合科技		第 9 类（中国台湾）	02457490	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无
47	广合科技		第 42 类（中国台湾）	02459558	2025/6/1-2035/5/31	原始取得	无

附件二：广合科技及其控股子公司持有的主要注册专利

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
1	广合科技	发明	一种低酸型酸性蚀刻再生剂及其酸性蚀刻母液	ZL201210126971.1	2012.04.27	2013.11.13	20 年	维持	无	否	受让取得
2	广合科技	发明	一种 PCB 防断板铣镀槽及其应用方法	ZL201610291976.8	2016.05.05	2018.08.17	20 年	维持	无	否	原始取得
3	广合科技	发明	一种防铣镀槽毛刺及降低铣刀磨损加工方法	ZL201610292252.5	2016.05.05	2018.10.30	20 年	维持	无	否	原始取得
4	广合科技	发明	一种 PCB 线路板预防真空蚀刻线线路狗牙加工方法	ZL201610292251.0	2016.05.05	2019.03.29	20 年	维持	无	否	原始取得
5	广合科技	发明	一种 PCB 上 BGA 位置的背钻孔制作方法	ZL201610291974.9	2016.05.05	2019.04.30	20 年	维持	无	否	原始取得
6	东莞广合	发明	一种 PCB 板钻孔高效防呆的加工方法	ZL201710849211.6	2017.09.20	2019.09.17	20 年	维持	无	否	继受取得
7	广合科技	发明	一种基于二维码的菲林追溯管理系统及方法	ZL201710849230.9	2017.09.20	2020.09.25	20 年	维持	无	否	原始取得
8	广合科技	发明	一种挠性电路板精细线路的制作方法	ZL201811004147.2	2018.08.30	2020.11.13	20 年	维持	无	否	原始取得
9	广合科技	发明	一种高速 PCB 板内外层损耗控制工艺	ZL201910510412.2	2019.06.13	2020.12.18	20 年	维持	质押	否	原始取得
10	广合科技	发明	一种智能家居感应器用线路板及其制备方法	ZL201910174439.9	2019.03.08	2020.12.18	20 年	维持	无	否	原始取得
11	广合科技	发明	一种改善半固化片品质的加热裁切方法	ZL201811290568.6	2018.10.31	2020.12.18	20 年	维持	无	否	原始取得
12	广合科技	发明	一种 PCB 成品板涨缩的处理方法	ZL201910799216.1	2019.08.28	2020.12.29	20 年	维持	无	否	原始取得
13	广合科技	发明	一种微切片的孔径的确定方法	ZL201811002562.4	2018.08.30	2021.02.09	20 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
14	广合科技	发明	一种改善多层印制电路大拼板内套板局部形变的方法	ZL201811406218.1	2018.11.23	2021.03.19	20 年	维持	无	否	原始取得
15	广合科技	发明	高效钻孔工具的生成方法	ZL201810379794.5	2018.04.25	2021.07.13	20 年	维持	无	否	原始取得
16	广合科技	发明	一种基于PCB的L型槽孔加工方法	ZL201911248317.6	2019.12.09	2021.09.21	20 年	维持	无	否	原始取得
17	广合科技	发明	一种基于阶梯镀金插头式PCB 电路板的分段制板方法	ZL201911132185.0	2019.11.19	2021.09.21	20 年	维持	无	否	原始取得
18	广合科技	发明	一种 PCB 的背钻不良板的处理方法	ZL201911417957.5	2019.12.31	2021.10.08	20 年	维持	无	否	原始取得
19	广合科技	发明	一种验证不同材料耐热能力的PCB 结构	ZL202010462595.8	2020.05.27	2021.10.12	20 年	维持	无	否	原始取得
20	广合科技	发明	一种 PCB 板的控深铣设计工艺方法	ZL201911128682.3	2019.11.18	2021.10.12	20 年	维持	无	否	原始取得
21	广合科技	发明	一种节能控制系统及方法	ZL201910799160.X	2019.08.28	2022.02.15	20 年	维持	无	否	原始取得
22	广合科技	发明	一种金手指三面镀金的方法	ZL202110539242.8	2021.05.18	2022.03.04	20 年	维持	质押	否	原始取得
23	广合科技	发明	印制电路板的背钻钻深的确定方法	ZL202110138759.6	2021.02.01	2022.05.13	20 年	维持	无	否	原始取得
24	广合科技	发明	喷印机效率提升方法、电子设备及存储介质	ZL202110141171.6	2021.02.01	2022.05.17	20 年	维持	无	否	原始取得
25	广合科技	发明	一种提高 PCB 背钻钻深精度的方法	ZL202011453503.6	2020.12.11	2022.05.17	20 年	维持	无	否	原始取得
26	广合科技	发明	一种提升阻抗精度的控制方法	ZL202011427896.3	2020.12.09	2022.05.17	20 年	维持	质押	否	原始取得
27	广合科技	发明	一种内层 AOI 工艺智能化控制方法及控制系统	ZL202011330152.X	2020.11.24	2022.05.17	20 年	维持	质押	否	原始取得
28	广合科技	发明	一种 PCB 负片工艺中蚀刻不净的处理方法	ZL202011262443.X	2020.11.12	2022.05.17	20 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
29	广合科技	发明	一种 PCB 超高纵横比机械钻孔加工方法	ZL202011245876.4	2020.11.10	2022.05.17	20 年	维持	质押	否	原始取得
30	广合科技	发明	一种 PCB 板阻抗信息自动采集及分析方法	ZL201910510416.0	2019.06.13	2022.05.17	20 年	维持	无	否	原始取得
31	广合科技	发明	一种多层板及其制造方法	ZL202110168559.5	2021.02.07	2022.07.19	20 年	维持	质押	否	原始取得
32	广合科技	发明	一种通过电容测量与控制层偏的方法、系统、终端及介质	ZL202011585450.3	2020.12.28	2022.07.19	20 年	维持	质押	否	原始取得
33	广合科技	发明	一种 PCB 板的标识方法和 PCB 板	ZL202110688457.6	2021.06.21	2022.07.22	20 年	维持	无	否	原始取得
34	广合科技	发明	电路板生产厚度管控的方法	ZL202110657100.1	2021.06.11	2022.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
35	广合科技	发明	一种金手指引线的加工方法和电路板	ZL202110603216.7	2021.05.31	2022.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
36	广合科技	发明	内嵌立体金属基的印制电路板及其加工方法	ZL202011581570.6	2020.12.28	2022.10.28	20 年	维持	质押	否	原始取得
37	广合科技	发明	一种 AVI 外观检查机的资料的自动化输出方法	ZL202011427902.5	2020.12.09	2022.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
38	东莞广合	发明	一种葫芦状异形孔的加工方法	ZL202110383099.8	2021.04.09	2022.12.23	20 年	维持	无	否	继受取得
39	广合科技	发明	一种提高开孔对准度的方法和多层 PCB 板	ZL202110384921.2	2021.04.09	2023.03.24	20 年	维持	无	否	原始取得
40	广合科技	发明	一种线路板制备方法及线路板	ZL202111135688.0	2021.09.27	2023.03.28	20 年	维持	无	否	原始取得
41	广合科技	发明	自动计算背钻深度的方法、电子设备及存储介质	ZL202110225469.5	2021.03.01	2023.05.26	20 年	维持	质押	否	原始取得
42	广合科技	发明	基于 ERP 系统实现 PCB 药水分析及调节方法、电子设备及存储介质	ZL202110279623.7	2021.03.16	2023.06.02	20 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
43	广合科技	发明	一种金手指卡板插槽的加工方法	ZL202110996229.5	2021.08.27	2023.07.18	20 年	维持	无	否	原始取得
44	广合科技	发明	一种用于 mini LED 的 PCB 直显板的制备方法	ZL202210912371.1	2022.07.29	2024.02.02	20 年	维持	无	否	原始取得
45	广合科技	发明	一种 PCB 板背钻孔质量无损检测与缺陷判定方法	ZL202311549514.8	2023.11.21	2024.04.19	20 年	维持	质押	否	原始取得
46	广合科技	发明	自动制作阻抗测试文件的方法、电子设备及存储介质	ZL202110224783.1	2021.03.01	2024.05.28	20 年	维持	无	否	原始取得
47	广合科技	发明	一种 PCB 激光钻孔精度测试装置及方法	ZL201910731791.8	2019.08.08	2024.06.04	20 年	维持	无	否	原始取得
48	广合科技	发明	一种激光预导和机械钻孔加工方法	ZL202410353636.8	2024.03.27	2024.06.04	20 年	维持	质押	否	原始取得
49	广合科技	发明	一种金手指板的制作方法	ZL202111291995.8	2021.11.02	2024.07.26	20 年	维持	质押	否	原始取得
50	广合科技	发明	一种激光加工系统和孔壁金属镀层激光加工方法	ZL202410530235.5	2024.04.29	2024.08.13	20 年	维持	质押	否	原始取得
51	广合科技	发明	一种贴膜单元及形成的贴膜机和贴膜方法	ZL202210439436.5	2022.04.25	2024.08.27	20 年	维持	无	否	原始取得
52	广合科技	发明	一种 PCB 板 CAF 测试模块设计方法	ZL202110001210.2	2021.01.04	2024.09.03	20 年	维持	无	否	原始取得
53	广合科技	发明	一种 PCB 的翘曲控制方法	ZL202111679654.8	2021.12.31	2024.09.03	20 年	维持	质押	否	原始取得
54	广合科技	发明	一种 AOI 快速检测方法及快速检测系统	ZL202011529747.8	2020.12.22	2024.09.06	20 年	维持	无	否	原始取得
55	广合科技	发明	一种电路板全喷墨制造方法	ZL201910731799.4	2019.08.08	2024.10.25	20 年	维持	质押	否	原始取得
56	东莞广合	发明	一种 PCB 板短槽孔钻孔工艺	ZL202210459125.5	2022.04.27	2024.10.25	20 年	维持	无	否	继受取得
57	广合科技	发明	一种 PCB 偏孔检测方法	ZL202411132189.X	2024.08.19	2024.11.12	20 年	维持	质押	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
58	东莞广合	发明	金手指引线加工方法	ZL202211305831.0	2022.10.24	2024.11.15	20 年	维持	无	否	继受取得
59	广合科技	发明	一种 VCP 线制备印制线路板的镀铜方法	ZL202210612913.3	2022.05.31	2024.11.29	20 年	维持	无	否	原始取得
60	广合科技	发明	一种背钻树脂塞孔和非树脂塞孔线路板的制作方法	ZL202411132235.6	2024.08.19	2024.12.17	20 年	维持	质押	否	原始取得
61	广合科技	发明	一种不对称叠构 PCB 板的设计方法及 PCB 板	ZL202210375200.X	2022.04.11	2024.12.20	20 年	维持	质押	否	原始取得
62	广合科技	发明	一种印制电路板内层铜表面的处理方法	ZL202211615035.7	2022.12.14	2024.12.20	20 年	维持	质押	否	原始取得
63	广合科技	发明	PCB 板的防铜皱工艺以及 PCB 板	ZL202211272033.2	2022.10.18	2024.12.27	20 年	维持	无	否	原始取得
64	东莞广合	发明	一种 PTFE 高频电路板中盲槽的制备方法	ZL202211079129.7	2022.09.05	2025.03.25	20 年	维持	无	否	继受取得
65	广合科技	发明	一种 PCB 板干膜不良的返工方法	ZL202210720535.0	2022.06.23	2025.04.11	20 年	维持	无	否	原始取得
66	广合科技	发明	电路板过孔的背钻加工方法、背钻加工装置及电路板	ZL202310008227.X	2023.01.04	2025.04.15	20 年	维持	无	否	原始取得
67	广合科技	发明	一种基于不流动 PP 结构的线路板制板方法	ZL201910731801.8	2019.08.08	2025.07.04	20 年	维持	无	否	原始取得
68	广合科技	发明	一种 PCB 金手指 SLOT 槽的钻孔工艺	ZL202210873147.6	2022.07.21	2025.07.04	20 年	维持	无	否	原始取得
69	广合科技	发明	一种镀金电路板的制作方法	ZL202211275430.5	2022.10.18	2025.07.04	20 年	维持	无	否	原始取得
70	广合科技	发明	一种 UV 激光切割机激光器能量衰退的检测方法	ZL202211467814.7	2022.11.22	2025.07.04	20 年	维持	无	否	原始取得
71	广合科技	发明	一种防止甩线的背钻去镀金引线的方法	ZL202210945240.3	2022.08.08	2025.07.08	20 年	维持	无	否	原始取得
72	广合科技	发明	多阶 HDI 印刷电路板的制作	ZL202310056164.5	2023.01.16	2025.07.25	20 年	维持	质押	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
			工艺以及印刷电路板								
73	广合科技	发明	一种印制电路板树脂塞孔的制作方法及电路板	ZL202510300066.0	2025.03.14	2025.08.05	20 年	维持	质押	否	原始取得
74	广合科技	发明	一种非对称刚挠结合板的制造工艺	ZL202211721813.0	2022.12.30	2025.08.19	20 年	维持	无	否	原始取得
75	广合科技	发明	PCB 板盲孔加工方法、装置、激光钻孔设备和存储介质	ZL202510757376.5	2025.06.09	2025.09.16	20 年	维持	无	否	原始取得
76	广合科技	发明	一种印刷电路板的电镀加工方法	ZL202510926557.6	2025.07.07	2025.09.16	20 年	维持	无	否	原始取得
77	广合科技	发明	一种高精度线路板及其制备方法	ZL202411704617.1	2024.11.26	2025.10.10	20 年	维持	无	否	原始取得
78	广合科技	发明	一种线路板插损测试方法	ZL202511114180.0	2025.08.11	2025.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
79	广合科技	发明	PCB 阻焊喷涂设备及喷涂方法	ZL202510107978.6	2025.01.23	2025.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
80	广合科技	发明	板厚测量装置及板厚测量方法	ZL202411933979.8	2024.12.26	2025.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
81	广合科技	发明	印制电路板及其制作方法	ZL202211160897.5	2022.09.22	2025.10.28	20 年	维持	无	否	原始取得
82	广合科技	发明	一种贴膜机上干膜尾部张力的测量方法、控制方法及测量设备	ZL202411890169.9	2024.12.20	2025.11.21	20 年	维持	无	否	原始取得
83	广合科技	发明	一种智能基板仓自动拆托入库系统及其实现方法	ZL202411916093.2	2024.12.24	2025.11.25	20 年	维持	无	否	原始取得
84	广合科技	发明	一种 UV 激光切割机烧焊盘能力的检测方法	ZL202211466872.8	2022.11.22	2025.11.28	20 年	维持	无	否	原始取得
85	广合科技	发明	一种电路板及其背钻方法	ZL202511232509.3	2025.09.01	2025.12.05	20 年	维持	无	否	原始取得
86	广合科技	发明	一种 PCB 堆叠配套设备及堆叠配套方法	ZL202311429148.2	2023.10.30	2025.12.05	20 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
87	广合科技黄石广合	发明	一种提高背钻mapping效率的方法、计算机存储介质和背钻机	ZL202211731912.7	2022.12.30	2025.06.06	20年	维持	无	否	原始取得
88	广合科技黄石广合	发明	一种线路板焊盘镀金方法及线路板	ZL202511358422.0	2025.09.23	2025.12.26	20年	维持	无	否	原始取得
89	广合科技	发明	一种刚挠结合板的制造工艺	ZL202211708483.1	2022/12/29	2026/2/17	20年	维持	无	否	原始取得
90	广合科技	发明	一种阻抗线宽的测量方法、计算机可读存储介质	ZL202310263278.7	2023/3/17	2026/1/20	20年	维持	无	否	原始取得
91	广合科技	发明	一种印刷电路板及其制备方法	ZL202411935414.3	2024/12/26	2026/3/27	20年	维持	无	否	原始取得
92	广合科技	发明	一种阻抗测试文件的生成方法	ZL202210636372.8	2022/6/7	2026/5/12	20年	维持	无	否	原始取得
93	广合科技	发明	一种PCB板钻孔质量控制方法	ZL202211337581.9	2022/10/28	2026/4/24	20年	维持	无	否	原始取得
94	广合科技	发明	一种刚挠板揭盖工艺加工方法、加工设备和刚挠板	ZL202211492244.7	2022/11/25	2026/6/30	20年	维持	无	否	原始取得
95	广合科技	发明	一种刚挠板的制作方法、制作设备和刚挠板	ZL202211540535.9	2022/12/2	2026/6/12	20年	维持	无	否	原始取得
96	广合科技	发明	一种提高PCB板树脂塞孔生产效率的方法、存储介质和钻机	ZL202310162795.5	2023/2/24	2026/5/19	20年	维持	无	否	原始取得
97	广合科技	发明	一种金手指的镀金方法及金手指电路板	ZL202310181093.1	2023/2/27	2026/6/26	20年	维持	无	否	原始取得
98	广合科技	实用新型	一种防起皱PCB层压融合结构	ZL201621473222.6	2016.12.30	2017.07.18	10年	维持	无	否	原始取得
99	广合科技	实用新型	一种用于镀分段式金手指的线路板	ZL201621473220.7	2016.12.30	2017.07.18	10年	维持	无	否	原始取得
100	广合科技	实用新型	一种PCB钻孔定位治具	ZL201621473219.4	2016.12.30	2018.02.27	10年	维持	无	否	原始取得
101	广合科技	实用新型	基于二维码进行追溯的菲林自主管理系统	ZL201621473682.9	2016.12.30	2018.06.15	10年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
102	广合科技	实用新型	插入损耗低的线路板	ZL201820044419.0	2018.01.11	2018.08.31	10 年	维持	无	否	原始取得
103	广合科技	实用新型	一种新型的 PCB 工艺指示卡防丢失跟踪台车	ZL201820069022.7	2018.01.16	2018.09.21	10 年	维持	无	否	原始取得
104	广合科技	实用新型	一种新型的 PCB 薄板专用存放车	ZL201820068318.7	2018.01.16	2018.09.21	10 年	维持	无	否	原始取得
105	广合科技	实用新型	一种新型的钻孔夹 PIN 放板专用 L 型车架	ZL201820068316.8	2018.01.16	2018.09.21	10 年	维持	无	否	原始取得
106	广合科技	实用新型	预防孔壁分离的 PCB 板	ZL201820044427.5	2018.01.11	2018.11.06	10 年	维持	无	否	原始取得
107	广合科技	实用新型	去除 PTH 半孔孔内毛刺的加工装置	ZL201820044426.0	2018.01.11	2018.11.13	10 年	维持	无	否	原始取得
108	广合科技	实用新型	PCB 压合料温自动控制系统	ZL201820044873.6	2018.01.11	2018.11.16	10 年	维持	无	否	原始取得
109	广合科技	实用新型	新型电镀架	ZL201820600234.3	2018.04.25	2018.12.14	10 年	维持	无	否	原始取得
110	广合科技	实用新型	减少 GGB 探头损耗的 PAD	ZL201820598882.X	2018.04.25	2018.12.14	10 年	维持	无	否	原始取得
111	广合科技	实用新型	PCB 高精度孔位加工装置	ZL201820044871.7	2018.01.11	2018.12.14	10 年	维持	无	否	原始取得
112	广合科技	实用新型	一种搬运覆铜板的工具	ZL201821413223.0	2018.08.30	2019.04.26	10 年	维持	无	否	原始取得
113	广合科技	实用新型	一种 PCB 耐压测试治具	ZL201821412504.4	2018.08.30	2019.06.14	10 年	维持	无	否	原始取得
114	广合科技	实用新型	震荡装置及使用该震荡装置的装置	ZL201920852276.0	2019.06.06	2020.04.24	10 年	维持	无	否	原始取得
115	广合科技	实用新型	一种电控柜移动台面	ZL201921559258.X	2019.09.18	2020.06.26	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
116	广合科技	实用新型	一种用于 PCB 板试印 Mylar 膜的丝印机	ZL201920887074.X	2019.06.13	2020.06.26	10 年	维持	无	否	原始取得
117	广合科技	实用新型	一种埋铜块棕化夹具	ZL201921428143.7	2019.08.30	2020.07.07	10 年	维持	无	否	原始取得
118	广合科技	实用新型	一种新型铆钉机下模座	ZL201921406108.5	2019.08.28	2020.07.10	10 年	维持	无	否	原始取得
119	广合科技	实用新型	一种高散热、低损耗的 PCB 板	ZL201921997542.5	2019.11.19	2020.08.07	10 年	维持	无	否	原始取得
120	广合科技	实用新型	一种用于线路板加工的二次干膜系统	ZL201921689331.5	2019.10.10	2020.08.07	10 年	维持	无	否	原始取得
121	广合科技	实用新型	一种气动震动器	ZL201921670346.7	2019.10.08	2020.08.07	10 年	维持	无	否	原始取得
122	广合科技	实用新型	一种用于正凹蚀印制电路板的感温线组件	ZL201921671216.5	2019.10.08	2020.08.07	10 年	维持	无	否	原始取得
123	广合科技	实用新型	一种喷涂喷针	ZL201921998029.8	2019.11.19	2020.10.13	10 年	维持	无	否	原始取得
124	广合科技	实用新型	一种 PCB 可靠性综合测试模块	ZL202020587730.7	2020.04.20	2021.03.19	10 年	维持	无	否	原始取得
125	广合科技	实用新型	一种改良型 TDR 探头接地片及 TDR 探头	ZL201921996356.X	2019.11.19	2021.03.19	10 年	维持	无	否	原始取得
126	广合科技	实用新型	一种提高除胶片等离子除胶效率的夹具装置	ZL202021486208.6	2020.07.24	2021.06.18	10 年	维持	无	否	原始取得
127	广合科技	实用新型	一种改良型喷压接头	ZL202022100597.0	2020.09.23	2021.07.06	10 年	维持	无	否	原始取得
128	广合科技	实用新型	一种改良型过滤筒锁扣	ZL202120026104.5	2021.01.06	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
129	广合科技	实用新型	一种防夹具磨损的止挡	ZL202120025108.1	2021.01.06	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
130	广合科技	实用新型	一种防止 HDI 板翘曲结构	ZL202120025756.7	2021.01.06	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
131	广合科技	实用新型	一种改善钻孔拉铜丝的线路板	ZL202022930994.0	2020.12.09	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
132	广合科技	实用新型	一种 PCB 板水破试验装置	ZL202022718357.7	2020.11.23	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
133	广合科技	实用新型	一种耐腐蚀捞板夹	ZL202022717334.4	2020.11.23	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
134	广合科技	实用新型	新型 V 形座装置	ZL202022613674.2	2020.11.12	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
135	广合科技	实用新型	便捷式飞靶和铜条的固定装置	ZL202022575959.1	2020.11.10	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
136	广合科技	实用新型	一种小圆刀包围式吸尘盒	ZL202022310247.7	2020.10.16	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
137	广合科技	实用新型	一种易于控制背钻深度的线路板	ZL202120810614.1	2021.04.20	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
138	广合科技	实用新型	一种线路板回流线的下料架	ZL202120618849.0	2021.03.26	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
139	广合科技	实用新型	一种改善镀金金厚均匀性的装置	ZL202120558019.3	2021.03.18	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
140	广合科技	实用新型	一种快速涂刷工具	ZL202120359206.9	2021.02.07	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
141	广合科技	实用新型	一种涂刷工具	ZL202120347270.5	2021.02.07	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
142	广合科技	实用新型	一种便捷式 DES 线风刀固定调整器组件	ZL202120358761.X	2021.02.07	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
143	广合科技	实用新型	一种提升半自动曝光机放板精度的装置	ZL202120025107.7	2021.01.06	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
144	广合科技	实用新型	一种丝锥和钻头的管理工具	ZL202121146525.8	2021.05.26	2021.11.26	10 年	维持	无	否	原始取得
145	广合科技	实用新型	一种 PCB 拼板及微切片预装模块	ZL202120870128.9	2021.04.26	2021.11.26	10 年	维持	无	否	原始取得
146	广合科技	实用新型	一种喷涂废气预处理装置	ZL202120439877.6	2021.03.01	2021.11.26	10 年	维持	无	否	原始取得
147	广合科技	实用新型	一种喷涂固定座	ZL202121307135.4	2021.06.11	2021.11.30	10 年	维持	无	否	原始取得
148	广合科技	实用新型	一种吸尘管控制组件	ZL202121885457.7	2021.08.12	2022.01.07	10 年	维持	无	否	原始取得
149	广合科技	实用新型	一种电路板	ZL202121873683.3	2021.08.11	2022.01.11	10 年	维持	无	否	原始取得
150	广合科技	实用新型	一种电镀缸过滤系统及电镀设备	ZL202122185786.7	2021.09.10	2022.01.14	10 年	维持	无	否	原始取得
151	广合科技	实用新型	一种内层涂布线的翻板台结构	ZL202121259553.0	2021.06.07	2022.01.14	10 年	维持	无	否	原始取得
152	广合科技	实用新型	一种吸尘罩	ZL202121162166.5	2021.05.27	2022.02.11	10 年	维持	无	否	原始取得
153	广合科技	实用新型	一种轴套	ZL202120962318.3	2021.05.07	2022.02.11	10 年	维持	无	否	原始取得
154	广合科技	实用新型	一种电路板金手指镀金结构	ZL202122901261.9	2021.11.24	2022.04.19	10 年	维持	无	否	原始取得
155	广合科技	实用新型	一种 PCB 产线节水流量调节装置	ZL202123381102.7	2021.12.29	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得
156	广合科技	实用新型	一种用于 PCB 板的 AOI 检测工具车	ZL202122766159.2	2021.11.10	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得
157	广合科技	实用新型	辅助接合装置	ZL202122628500.8	2021.10.29	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
158	广合科技	实用新型	一种夹持装置	ZL202122262379.1	2021.09.17	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得
159	广合科技	实用新型	一种吸盘装置	ZL202122123882.9	2021.09.03	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得
160	广合科技	实用新型	PIN 针的拆卸装置	ZL202122109612.2	2021.09.02	2022.05.13	10 年	维持	无	否	原始取得
161	广合科技	实用新型	一种图形镀锡智能补水装置及改善图电溶锡的电镀系统	ZL202123444025.5	2021.12.30	2022.05.27	10 年	维持	无	否	原始取得
162	广合科技	实用新型	一种用于 PCB 板转运的横梁装置	ZL202220717242.2	2022.03.30	2022.07.19	10 年	维持	无	否	原始取得
163	广合科技	实用新型	一种方钢校正夹具	ZL202123452474.4	2021.12.31	2022.07.19	10 年	维持	无	否	原始取得
164	广合科技	实用新型	一种收板机调宽装置	ZL202123452149.8	2021.12.31	2022.07.19	10 年	维持	无	否	原始取得
165	广合科技	实用新型	一种自动烘干装置	ZL202220980640.3	2022.04.26	2022.08.23	10 年	维持	无	否	原始取得
166	广合科技	实用新型	导气垫板组件	ZL202220766533.0	2022.03.31	2022.09.06	10 年	维持	无	否	原始取得
167	广合科技	实用新型	一种 PCB 背钻孔残桩的测量装置	ZL202220238922.6	2022.01.28	2022.10.21	10 年	维持	无	否	原始取得
168	广合科技	实用新型	一种攻牙辅助工具	ZL202221244959.6	2022.05.23	2022.10.28	10 年	维持	无	否	原始取得
169	广合科技	实用新型	一种打靶机吸板模块及打靶机	ZL202221206842.9	2022.05.18	2022.10.28	10 年	维持	无	否	原始取得
170	广合科技	实用新型	一种印制电路板测试装置及印制电路板系统	ZL202221972575.6	2022.07.28	2022.11.25	10 年	维持	无	否	原始取得
171	广合科技	实用新型	一种磨刷刷毛更换专用车	ZL202221396723.4	2022.06.06	2022.12.09	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
172	广合科技	实用新型	一种用于测试 PCB 层间耐电压的测试结构	ZL202220532554.6	2022.03.11	2022.12.09	10 年	维持	无	否	原始取得
173	广合科技	实用新型	一种化金线金槽过滤装置	ZL202122363797.X	2021.09.28	2022.12.20	10 年	维持	无	否	原始取得
174	广合科技	实用新型	一种用于弯翘板除尘的传输装置及粘尘机	ZL202221522011.2	2022.06.17	2022.12.23	10 年	维持	无	否	原始取得
175	广合科技	实用新型	一种内层冲孔机防摩擦板及内层冲孔机	ZL202221963842.3	2022.07.27	2022.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
176	广合科技	实用新型	一种新型摇摆连杆及显影机	ZL202221849653.3	2022.07.18	2022.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
177	广合科技	实用新型	一种 PCB 发射极组件	ZL202221344097.4	2022.05.31	2022.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
178	广合科技	实用新型	一种镀金工件清洗液的回收装置	ZL202221296187.0	2022.05.27	2022.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
179	广合科技	实用新型	浮架机构	ZL202222713523.3	2022.10.14	2023.02.10	10 年	维持	无	否	原始取得
180	广合科技	实用新型	一种内层冲孔机皮带固定座及内层冲孔机	ZL202221849617.7	2022.07.18	2023.02.28	10 年	维持	无	否	原始取得
181	广合科技	实用新型	旋转开夹结构	ZL202222320847.0	2022.09.01	2023.02.28	10 年	维持	无	否	原始取得
182	广合科技	实用新型	一种开盖工具	ZL202222334848.0	2022.09.02	2023.02.28	10 年	维持	无	否	原始取得
183	广合科技	实用新型	一种 PCB 芯板中的热熔辅助结构	ZL202221825234.6	2022.07.15	2023.03.03	10 年	维持	无	否	原始取得
184	广合科技	实用新型	一种电镀飞巴的防腐装置	ZL202222474888.5	2022.09.19	2023.04.28	10 年	维持	无	否	原始取得
185	广合科技	实用新型	一种自动调整压力的导向装置及其形成的起重机	ZL202222537545.9	2022.09.23	2023.05.05	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
186	广合科技	实用新型	高压水泵油封安装用具	ZL202223000751.2	2022.11.10	2023.05.12	10 年	维持	无	否	原始取得
187	东莞广合	实用新型	一种用于钻床控深的信号传输装置及其形成的钻床	ZL202221825232.7	2022.07.15	2023.06.02	10 年	维持	无	否	继受取得
188	广合科技	实用新型	一种用于内层蚀刻生产线的传输装置及内层蚀刻生产线	ZL202222494072.9	2022.09.19	2023.06.02	10 年	维持	无	否	原始取得
189	广合科技	实用新型	PCB 防擦花烘干机构	ZL202320731827.4	2023.04.06	2023.06.23	10 年	维持	无	否	原始取得
190	广合科技	实用新型	PCB 生产线用喷管安装结构及喷淋设备	ZL202223325066.7	2022.12.12	2023.08.29	10 年	维持	无	否	原始取得
191	广合科技	实用新型	一种 PCB 基板结构	ZL202320286235.6	2023.02.22	2023.09.08	10 年	维持	无	否	原始取得
192	广合科技	实用新型	一种废气塔喷淋泵吸入口过滤装置及喷淋泵	ZL202320319590.9	2023.02.23	2023.09.08	10 年	维持	无	否	原始取得
193	广合科技	实用新型	用于 PCB 板的电镀挂板夹钳及电镀飞靶夹具	ZL202321155877.9	2023.05.15	2023.09.08	10 年	维持	无	否	原始取得
194	广合科技	实用新型	一种包含 OCP 连接器的 PCB 产品	ZL202321205226.6	2023.05.18	2023.09.08	10 年	维持	无	否	原始取得
195	广合科技	实用新型	用于 PCB 板雕刻加工的固定装置及雕刻机	ZL202321254014.7	2023.05.23	2023.09.08	10 年	维持	无	否	原始取得
196	广合科技	实用新型	热熔模块	ZL202320691340.8	2023.03.31	2023.09.15	10 年	维持	无	否	原始取得
197	广合科技	实用新型	一种多层印刷电路板	ZL202321142529.8	2023.05.11	2023.09.29	10 年	维持	无	否	原始取得
198	东莞广合	实用新型	分体式防呆销钉	ZL202320961961.3	2023.04.25	2023.10.17	10 年	维持	无	否	继受取得
199	广合科技	实用新型	PCB 阻抗通用探头及阻抗测试装置	ZL202320392987.0	2023.03.06	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
200	广合科技	实用新型	一种防止薄板翘曲的搬运放置组件	ZL202320686972.5	2023.03.31	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得
201	东莞广合	实用新型	一种钻孔机压力脚及钻孔机	ZL202320999276.X	2023.04.27	2023.11.21	10 年	维持	无	否	继受取得
202	广合科技	实用新型	OSP 水平护铜线的节水装置及 OSP 水平护铜线	ZL202321254844.X	2023.05.23	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得
203	广合科技	实用新型	一种 PCB 产品的放置模具及其形成的清洗装置	ZL202321560650.2	2023.06.19	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得
204	广合科技	实用新型	防拖尾膜皱吸膜导向结构及贴膜机	ZL202321563549.2	2023.06.19	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得
205	广合科技	实用新型	一种用于芯板的散热结构及其形成的芯板	ZL202321629151.4	2023.06.26	2023.11.21	10 年	维持	无	否	原始取得
206	广合科技	实用新型	一种热压机的控制组件及其形成的热压机	ZL202321561598.2	2023.06.19	2023.11.28	10 年	维持	无	否	原始取得
207	广合科技	实用新型	丝印机感应器改进安装结构	ZL202321564070.0	2023.06.19	2023.11.28	10 年	维持	无	否	原始取得
208	广合科技	实用新型	一种 OSP 处理生产线	ZL202321000413.0	2023.04.27	2023.12.08	10 年	维持	无	否	原始取得
209	广合科技	实用新型	基于阶梯电价时段的提示装置	ZL202320326300.3	2023.02.27	2024.02.02	10 年	维持	无	否	原始取得
210	广合科技	实用新型	一种 OSP 护铜线中的节水清洗装置及 OSP 护铜线	ZL202320801950.9	2023.04.12	2024.02.02	10 年	维持	无	否	原始取得
211	广合科技	实用新型	改善熔合位起泡的板边结构	ZL202321964003.8	2023.07.25	2024.02.02	10 年	维持	无	否	原始取得
212	广合科技	实用新型	线路板化学沉铜生产线气顶结构	ZL202322029294.8	2023.07.31	2024.02.02	10 年	维持	无	否	原始取得
213	广合科技	实用新型	一种用于火山灰设备的吸铁冷却装置	ZL202322031856.2	2023.07.31	2024.04.12	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
214	广合科技	实用新型	用于管控 VCP 镀金线金缸铜离子含量的对喷式水洗结构	ZL202322270435.5	2023.08.23	2024.05.10	10 年	维持	无	否	原始取得
215	广合科技	实用新型	一种 PCB 板翻转机构	ZL202322619933.6	2023.09.26	2024.05.31	10 年	维持	无	否	原始取得
216	广合科技	实用新型	一种便于首板取件的收板装置	ZL202322880884.1	2023.10.26	2024.06.04	10 年	维持	无	否	原始取得
217	东莞广合	实用新型	斜边机自动换刀装置	ZL202323172486.0	2023.11.23	2024.06.18	10 年	维持	无	否	继受取得
218	广合科技	实用新型	一种刚挠板	ZL202323133063.8	2023.11.20	2024.08.20	10 年	维持	无	否	原始取得
219	广合科技	实用新型	阻焊塞孔垫板	ZL202420351476.9	2024.02.26	2024.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
220	广合科技	实用新型	一种运转载具	ZL202323509879.6	2023.12.22	2024.11.12	10 年	维持	无	否	原始取得
221	广合科技	实用新型	龙门线电镀浮架	ZL202420717673.8	2024.04.09	2024.12.17	10 年	维持	无	否	原始取得
222	广合科技	实用新型	一种电路板	ZL202420797783.X	2024.04.17	2024.12.20	10 年	维持	无	否	原始取得
223	广合科技	实用新型	悬浮式送样防溅装置	ZL202420190314.1	2024.01.26	2024.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
224	广合科技	实用新型	用于线路板垂直喷锡的辅助装置	ZL202420615108.0	2024.03.28	2024.12.27	10 年	维持	无	否	原始取得
225	广合科技	实用新型	一种低压喷涂机烤箱用感应定位机构及喷涂机烤箱	ZL202323665086.3	2023.12.29	2025.01.10	10 年	维持	无	否	原始取得
226	广合科技	实用新型	涂刷头及涂刷工具	ZL202420190269.X	2024.01.26	2025.01.10	10 年	维持	无	否	原始取得
227	广合科技	实用新型	一种水平沉铜线的传输装置及其形成的水平沉铜线	ZL202420847708.X	2024.04.23	2025.04.11	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
228	广合科技	实用新型	一种用于对芯板进行清理的粘尘装置	ZL202420627843.3	2024.03.29	2025.04.11	10 年	维持	无	否	原始取得
229	广合科技	实用新型	一种便于测量涨缩量的多层板结构	ZL202421210294.6	2024.05.30	2025.04.11	10 年	维持	无	否	原始取得
230	广合科技	实用新型	一种导电阳极丝的测试模块	ZL202421758009.4	2024.07.23	2025.06.20	10 年	维持	无	否	原始取得
231	广合科技	实用新型	一种电路板和电子设备	ZL202421801649.9	2024.07.29	2025.05.16	10 年	维持	无	否	原始取得
232	广合科技	实用新型	一种水刀及其形成的水平沉铜产线	ZL202421231309.7	2024.05.31	2025.07.04	10 年	维持	无	否	原始取得
233	广合科技	实用新型	一种多层 PCB 板	ZL202421807311.4	2024.07.29	2025.07.08	10 年	维持	无	否	原始取得
234	广合科技	实用新型	一种 PCB 盲槽焊盘修理刀具	ZL202421807327.5	2024.07.29	2025.07.08	10 年	维持	无	否	原始取得
235	广合科技	实用新型	一种印刷电路板及其背钻可靠性测试模块	ZL202422103911.9	2024.08.28	2025.07.25	10 年	维持	无	否	原始取得
236	广合科技	实用新型	一种防止压合铜皱的芯板结构	ZL202421707079.7	2024.07.18	2025.09.09	10 年	维持	无	否	原始取得
237	广合科技	实用新型	一种门锁组件及铜粉回收机	ZL202422134411.1	2024.08.30	2025.09.12	10 年	维持	无	否	原始取得
238	广合科技	实用新型	一种电路板	ZL202422380060.2	2024.09.27	2025.09.16	10 年	维持	无	否	原始取得
239	广合科技	实用新型	一种用于水平线的 PCB 板防翘结构	ZL202422427871.3	2024.10.08	2025.09.23	10 年	维持	无	否	原始取得
240	广合科技	实用新型	一种 AGV 的货架探测装置	ZL202422575568.8	2024.10.24	2025.09.23	10 年	维持	无	否	原始取得
241	广合科技	实用新型	拉脱测试夹具及连接线	ZL202422861572.0	2024.11.22	2025.10.28	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
242	广合科技	实用新型	PCB 板存放结构及放板机	ZL202423011695.1	2024.12.06	2025.11.18	10 年	维持	无	否	原始取得
243	广合科技	实用新型	一种输送导轮组件	ZL202423082397.1	2024.12.13	2025.11.25	10 年	维持	无	否	原始取得
244	广合科技	实用新型	一种可升降登高工具车	ZL202422889469.7	2024.11.26	2025.11.25	10 年	维持	无	否	原始取得
245	广合科技	实用新型	一种 PCB 板的清洗夹具和清洗系统	ZL202422801439.6	2024.11.18	2025.11.25	10 年	维持	无	否	原始取得
246	广合科技	实用新型	一种 PCB 板搬运载具和自动导向车	ZL202520021082.1	2025.01.06	2025.11.28	10 年	维持	无	否	原始取得
247	广合科技	实用新型	一种线路板结构及多层电路板	ZL202423141065.6	2024.12.19	2025.12.05	10 年	维持	无	否	原始取得
248	广合科技	实用新型	一种温度及插损测试 PCB 结构和系统	ZL202422885188.4	2024.11.25	2025.12.05	10 年	维持	无	否	原始取得
249	广合科技	实用新型	一种厚度均匀的 PCB	ZL202422868162.9	2024.11.22	2025.12.05	10 年	维持	无	否	原始取得
250	广合科技	实用新型	一种开料机夹爪校正挡块	ZL202520120203.8	2025/1/17	2026/1/20	10 年	维持	无	否	原始取得
251	广合科技	实用新型	一种体视显微镜升降治具	ZL202520173415.2	2025/1/26	2026/1/23	10 年	维持	无	否	原始取得
252	广合科技	实用新型	一种铜离子浓度监测装置及 VCP 电镀线	ZL202520242810.1	2025/2/14	2026/2/27	10 年	维持	无	否	原始取得
253	广合科技、黄石广合	实用新型	PCB 低压喷涂多级过滤系统	ZL202520525334.4	2025/3/24	2026/4/24	10 年	维持	无	否	原始取得
254	广合科技	实用新型	一种用于改善树脂研磨铜面压伤的装置	ZL202520785897.7	2025/4/24	2026/5/12	10 年	维持	无	否	原始取得
255	广合科技	实用新型	一种传送连接组件及冲孔机	ZL202520839454.1	2025/4/29	2026/5/19	10 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
256	广合科技	实用新型	一种线路板压合结构	ZL202521055132.4	2025/5/26	2026/5/5	10 年	维持	无	否	原始取得
257	广合科技	实用新型	一种电路板	ZL202521069129.8	2025/5/28	2026/5/5	10 年	维持	无	否	原始取得
258	广合科技	实用新型	防翘曲刚性压合板	ZL202521087900.4	2025/5/29	2026/5/26	10 年	维持	无	否	原始取得
259	广合科技	实用新型	恒温箱	ZL202521566149.6	2025/7/25	2026/6/26	10 年	维持	无	否	原始取得
260	广合科技、黄石广合	实用新型	快拆耐磨连轴件	ZL202223577093.3	2022.12.30	2023.06.02	10 年	维持	无	否	原始取得
261	广合科技、黄石广合	实用新型	一种用于汽车材料的 PCB 测试板	ZL202223577116.0	2022.12.30	2023.08.25	10 年	维持	无	否	原始取得
262	广合科技、黄石广合	实用新型	一种防止芯板卡板的传输装置	ZL202322457682.6	2023.09.11	2024.09.03	10 年	维持	无	否	原始取得
263	广合科技、黄石广合	实用新型	一种显示屏	ZL202422550614.9	2024.10.21	2025.09.09	10 年	维持	无	否	原始取得
264	广合科技、东莞广合	实用新型	一种电路板及其背钻测试模块	ZL202422638224.7	2024.10.30	2025.09.26	10 年	维持	无	否	原始取得
265	黄石广合	发明	一种 PCB 板的子母板压合对位设计工艺方法	ZL202010293818.2	2020.04.15	2021.05.25	20 年	维持	无	否	原始取得
266	黄石广合	发明	一种 PCB 板内层生产工艺	ZL202011245860.3	2020.11.10	2022.06.21	20 年	维持	无	否	原始取得
267	黄石广合	发明	一种在线修理 PCB 板的检修设备及其检修方法	ZL202010327171.0	2020.04.23	2023.07.21	20 年	维持	无	否	原始取得

序号	专利权人	专利类型	专利名称	专利号	申请日期	授权公告日	专用权期限	状态	他项权利	目前是否许可他人使用	取得方式（原始取得、继受取得）
268	黄石广合	发明	一种 HDI 板对位孔智能防呆方法及 HDI 板	ZL202111646406.3	2021.12.29	2023.12.08	20 年	维持	无	否	原始取得
269	黄石广合	发明	工程图纸管理系统、管理方法、计算机设备、介质及终端	ZL202011318618.4	2020.11.23	2024.12.20	20 年	维持	无	否	原始取得
270	黄石广合	发明	一种可升降式暂存冷却机	ZL202011467454.1	2020.12.14	2025.07.08	20 年	维持	无	否	原始取得
271	黄石广合	实用新型	一种取消承载盘的自动导引运输装置	ZL201922251576.6	2019.12.16	2020.12.11	10 年	维持	无	否	原始取得
272	黄石广合	实用新型	一种螺栓固定结构及使用其的 PCB 固定框架	ZL202020416727.9	2020.03.27	2020.12.18	10 年	维持	无	否	原始取得
273	黄石广合	实用新型	一种通用式导气板	ZL202022187324.4	2020.09.29	2021.05.25	10 年	维持	无	否	原始取得
274	黄石广合	实用新型	一种可升降式暂存冷却机	ZL202022998153.3	2020.12.14	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
275	黄石广合	实用新型	一种 PCB 板塞孔网板和丝印机	ZL202022568523.X	2020.11.09	2021.10.08	10 年	维持	无	否	原始取得
276	黄石广合	实用新型	一种用于延长 PCB 厂酸洗槽使用寿命的再生装置	ZL202120524111.8	2021.03.12	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
277	黄石广合	实用新型	一种 PCB 板收放板机	ZL202022998152.9	2020.12.14	2021.11.05	10 年	维持	无	否	原始取得
278	黄石广合	实用新型	一种收放板机的存放结构	ZL202121077987.9	2021.05.19	2022.02.11	10 年	维持	无	否	原始取得
279	黄石广合	实用新型	一种显示屏	ZL202421331440.0	2024.06.12	2025.04.11	10 年	维持	无	否	原始取得

附件三：广合科技及其控股子公司持有的主要软件著作权

序号	著作权人	著作权名称	证书编号	登记号	著作权类型类别	证书日期	取得方式	他项权利
1	广合科技	包装管理系统 V5.0	软著登字第 8310094 号	2021SR1587468	计算机软件	2021.10.28	原始取得	无
2	广合科技	广合设备资产管理系统 V1.0	软著登字第 8310035 号	2021SR1587409	计算机软件	2021.10.28	原始取得	无
3	广合科技	工序过数系统 V1.0	软著登字第 8478327 号	2021SR1755701	计算机软件	2021.11.16	原始取得	无
4	广合科技	固废管理系统 V1.0	软著登字第 9021930 号	2022SR0067731	计算机软件	2022.01.11	原始取得	无
5	广合科技	SPEC 管理系统 V1.0	软著登字第 9022351 号	2022SR0068152	计算机软件	2022.01.11	原始取得	无
6	广合科技	半固化片直投管理系统 V1.0	软著登字第 9022352 号	2022SR0068153	计算机软件	2022.01.11	原始取得	无
7	广合科技	菲林工具管理系统 V1.0	软著登字第 9519399 号	2022SR0565200	计算机软件	2022.05.06	原始取得	无
8	广合科技	Delton 网房工具管理系统 V1.0	软著登字第 9900926 号	2022SR0946727	计算机软件	2022.07.19	原始取得	无
9	广合科技	合同评审平台 V1.0	软著登字第 10235325 号	2022SR1281126	计算机软件	2022.08.25	原始取得	无
10	广合科技	Delton 智能制造管理系统 V1.0	软著登字第 10291195 号	2022SR1336996	计算机软件	2022.08.31	原始取得	无
11	广合科技	ECN 及生产订单变更平台 V1.0	软著登字第 10632817 号	2023SR0045646	计算机软件	2023.01.09	原始取得	无
12	广合科技	生产备料平台 V1.0	软著登字第 10632818 号	2023SR0045647	计算机软件	2023.01.09	原始取得	无
13	广合科技	采购对账平台 V1.0	软著登字第 11009965 号	2023SR0422794	计算机软件	2023.03.31	原始取得	无

序号	著作权人	著作权名称	证书编号	登记号	著作权类型类别	证书日期	取得方式	他项权利
14	广合科技	销售订单变更平台 V1.0	软著登字第 11076912 号	2023SR0489741	计算机软件	2023.04.20	原始取得	无
15	广合科技	风险警告管理系统 V1.0	软著登字第 11128167 号	2023SR0540996	计算机软件	2023.05.15	原始取得	无
16	广合科技	销售对账平台 V1.0	软著登字第 11167928 号	2023SR0580757	计算机软件	2023.06.05	原始取得	无
17	广合科技	纠正措施管理系统[简称：CAS]V1.0	软著登字第 11229483 号	2023SR0642312	计算机软件	2023.06.13	原始取得	无
18	广合科技	生产订单数量变更平台 V1.0	软著登字第 11229482 号	2023SR0642311	计算机软件	2023.06.13	原始取得	无
19	广合科技	佣金计提平台[简称：佣金计提]V1.0	软著登字第 11407092 号	2023SR0819921	计算机软件	2023.07.06	原始取得	无
20	广合科技	数据可视化看板系统 V1.0	软著登字第 11648163 号	2023SR1060990	计算机软件	2023.09.14	原始取得	无
21	广合科技	寄售供应商对账平台[简称：寄售对账] V1.0	软著登字第 11779455 号	2023SR1192282	计算机软件	2023.10.08	原始取得	无
22	广合科技	广合工程 CAM 技能测评系统 V1.0	软著登字第 12007279 号	2023SR1420106	计算机软件	2023.11.10	原始取得	无
23	广合科技	生产订单版本升级平台 V1.0	软著登字第 12009323 号	2023SR1422150	计算机软件	2023.11.13	原始取得	无
24	广合科技	不合格品综合管理系统[简称：U单综合管理系统] V1.0	软著登字第 12932718 号	2024SR0528845	计算机软件	2024.04.19	原始取得	无
25	广合科技	特殊物料采购平台 V1.0	软著登字第 12972722 号	2024SR0568849	计算机软件	2024.04.26	原始取得	无
26	广合科技	公司间外协结算平台 V1.0	软著登字第 13956607 号	2024SR1552734	计算机软件	2024.10.17	原始取得	无
27	广合科技	委外加工管理系统 V1.0	软著登字第 14054106 号	2024SR1650233	计算机软件	2024.10.30	原始取得	无
28	广合科技	Delton 主设备配方管理系统 V1.0	软著登字第 14129848 号	2024SR1725975	计算机软件	2024.11.07	原始取得	无

序号	著作权人	著作权名称	证书编号	登记号	著作权类型类别	证书日期	取得方式	他项权利
29	广合科技	Delton 报价管理系统 V1.0	软著登字第 15552829 号	2025SR0896631	计算机软件	2025.05.29	原始取得	无
30	广合科技	工程订单排程系统[简称：排程系统]V6.0.1	软著登字第 16043733 号	2025SR1387535	计算机软件	2025.07.29	原始取得	无
31	广合科技	Delton 标准作业程序 SOP 系统[简称：SOP 系统]V1.0	软著登字第 16295936 号	2025SR1639738	计算机软件	2025.08.28	原始取得	无
32	广合科技	生产订单日期变更平台 V1.0	软著登字第 16295807 号	2025SR1639609	计算机软件	2025.08.28	原始取得	无
33	广合科技	VNA 网分仪阻抗资料自动建档程序[简称：阻抗测试自动建档]V1.8	软著登字第 16509845 号	2025SR1853647	计算机软件	2025.09.24	原始取得	无
34	广合科技	产生薪资相关会计凭证平台 V1.0	软著登字第 16580864 号	2025SR1924666	计算机软件	2025-10-09	原始取得	无
35	广合科技	生产物流 AGV 系统 V1.0	软著登字第 17131681 号	2025SR2475483	计算机软件	2025-12-24	原始取得	无
36	广合科技	Delton 统计过程控制 SPC 系统 V1.0	软著登字第 17131683 号	2025SR2475485	计算机软件	2025-12-24	原始取得	无
37	广合科技	广合物料线边仓管理系统 V1.0	软著登字第 17156928 号	2025SR2500730	计算机软件	2025-12-26	原始取得	无
38	广合科技	成品仓返工管理系统 V1.0	软著登字第 17177871 号	2025SR2521673	计算机软件	2025-12-29	原始取得	无
39	黄石广合	黄石广合 WMS 综合管理系统 V1.0	软著登字第 9645941 号	2022SR0691742	计算机软件	2022.06.02	原始取得	无
40	广合科技	广合标识	No. 01182323	国作登字-2020-F-01182323	美术作品	2020.12.01	原始取得	无